

SEN

Inhalt

VORSTAND

- 1 Brief an die Aktionäre
- 6 Vorstandsmitglieder

UNSER UNTERNEHMEN

- 10 Unser Profil
- 12 Unsere Aktie
- 16 2006 im Blick

CORPORATE GOVERNANCE

- 20 Corporate Governance Bericht
- 25 Entsprechenserklärung
- 26 Unsere Verantwortung

KONZERNLAGEBERICHT

- 30 Geschäft und Rahmenbedingungen
- 40 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- 49 Risikobericht
- 53 Nachtragsbericht
- 53 Prognosebericht

KONZERNABSCHLUSS

- 58 Jahresabschluss
- 68 Konzernanhang
- 95 Bestätigungsvermerk

AUFSICHTSRAT

- 98 Bericht des Aufsichtsrats
- 103 Organe des Aufsichtsrats

MEHRJAHRESÜBERBLICK (vorne im Umschlag)

GLOSSAR (hinten im Umschlag)

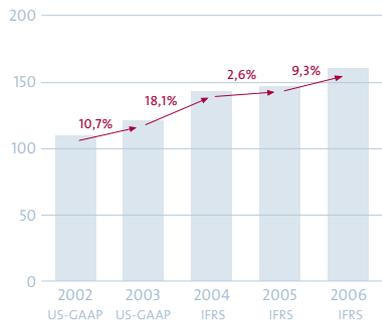
INFORMATIONSMATERIAL, KONTAKT, IMPRESSUM

(hinten im Umschlag)

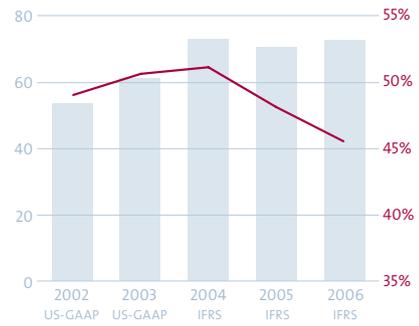
Finanzkalender 2007

Bilanzpressekonferenz ELMOS Dortmund	14. März 2007
Analystenkonferenz DVFA, Frankfurt am Main	14. März 2007
Zwischenbericht Januar bis März 2007	8. Mai 2007
Hauptversammlung Casino Hohensyburg, Dortmund	10. Mai 2007
Zwischenbericht Januar bis Juni 2007	1. August 2007
Zwischenbericht Januar bis September 2007	31. Oktober 2007

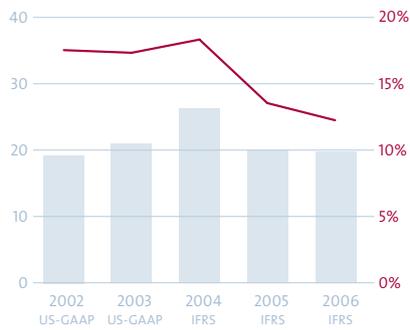
Umsatz in Mio Euro
und Wachstum



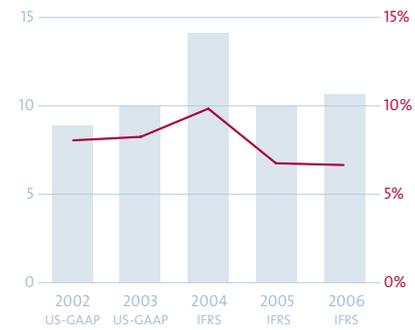
Bruttoergebnis in Mio Euro
und Marge



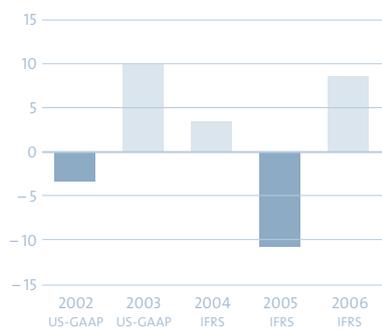
EBIT in Mio Euro
und Marge



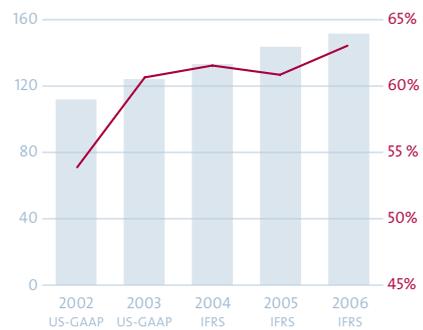
Jahresüberschuss in Mio Euro
und Nettogewinnmarge



Free Cash Flow
in Mio Euro



Eigenkapital und
Eigenkapitalquote



	2002	2003	2004	2005	2006
in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	US-GAAP	US-GAAP	IFRS	IFRS	IFRS
Umsatz	109,7	121,4	143,3	147,0	160,7
Umsatzwachstum	2,5%	10,7%	18,1%	2,6%	9,3%
Bruttoergebnis	53,8	61,4	73,2	70,6	73,0
Bruttomarge	49,0%	50,6%	51,1%	48,1%	45,5%
Forschungs- & Entwicklungskosten	17,5	20,4	24,7	28,1	29,6
Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz	16,0%	16,8%	17,2%	19,1%	18,4%
EBIT	19,3	21,1	26,4	20,0	19,8
EBIT in % des Umsatzes	17,6%	17,4%	18,4%	13,6%	12,3%
Ergebnis vor Steuern	15,7	17,3	22,9	16,4	17,3
Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes	14,3%	14,2%	16,0%	11,2%	10,8%
Jahresüberschuss	8,9	10,0	14,2	10,0	10,7
Nettogewinnmarge	8,1%	8,3%	9,9%	6,8%	6,7%
Ergebnis je Aktie in Euro	0,46	0,52	0,74	0,52	0,55
Bilanzsumme	208,5	205,3	217,3	237,0	241,9
Eigenkapital	112,4	124,7	133,8	144,3	152,9
Eigenkapitalquote	53,9%	60,7%	61,6%	60,9%	63,2%
Finanzverbindlichkeiten	62,2	60,6	57,6	67,9	65,0
Zahlungsmittel und -äquivalente sowie Wertpapiere	11,1	25,9	18,9	16,8	16,6
Nettoverschuldung	51,2	34,7	38,7	51,2	48,4
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,0	6,5	34,7	19,7	28,5
Investitionen in das Anlagevermögen	- 34,1	- 25,3	- 33,5	- 29,6	- 26,4
Investitionen in % vom Umsatz	31,1%	20,9%	23,4%	20,1%	16,4%
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 29,3	3,4	- 31,2	- 30,4	- 19,9
Free Cash Flow*	- 3,3	10,0	3,5	- 10,7	8,6
Dividende je Aktie in Euro	0,00	0,13	0,21	0,00	0,00**
Mitarbeiter im Jahresmittel	830	874	928	1.028	1.102

* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2007

3 Phasen des Wachstums

Wafer (engl. für Scheibe) sind das Ausgangsmaterial unserer Produkte. In mehreren hundert Einzelschritten stellen wir darauf unsere Halbleiter-Schaltkreise her. Größerer Wafer-Durchmesser bedeutet: mehr Schaltkreise, mehr Produkte.

Unser Ausgangspunkt waren Wafer mit einem Durchmesser von 4 Zoll. Heute produzieren wir auf 6- und 8-Zoll-Wafern. Die 6-Zoll-Wafer sind das Fundament, die 8-Zoll-Wafer die Zukunftsbausteine unseres Wachstums.

Wir wachsen weiter.

Kernkompetenz und Motor unseres Wachstums

Kundenspezifische Halbleiter für
den Einsatz im Automobil

WEITER WACHSEN

durch

- ▶ Einsatz von 8-Zoll-Wafern
- ▶ Vertrieb von Applikations-Standards
- ▶ Start von Mikrosystemprojekten
- ▶ Einstieg in andere Märkte
- ▶ Strategische Kooperationen

Unsere Produkte sind das Zentrum unseres Wachstums. Sie helfen Ihnen jeden Tag und machen Ihren Alltag sicherer. Im Auto messen, steuern und regeln sie die Klimaanlage, die Fahrzeugstabilität und die Airbags. Im Haushalt steigern sie die Umweltfreundlichkeit. Sie sorgen beispielsweise für den effektiven Umgang mit Wasser in Ihrer Waschmaschine.

Unser Wachstum ist der Beweis für gute Arbeit.



Sehr geehrte Aktionäre,

im abgelaufenen Jahr 2006 haben wir bedeutende Fortschritte im operativen Geschäft und in der strategischen Ausrichtung gemacht. Dies ist uns trotz einer schwierigen Ausgangslage gelungen. Um die im letzten Jahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen im Unternehmen teils erhebliche Änderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung vorgenommen. Damit haben wir dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet.

Kundenspezifische Halbleiterlösungen, so genannte ASICs, für den Einsatz in automobilen Applikationen sind zwar nach wie vor unser Kerngeschäft, wir haben aber begonnen, diese intakte Wachstumssäule durch den Aufbau weiterer Geschäftsfelder zu ergänzen. Diese nutzen unsere Kernkompetenzen und werden dazu beitragen, sie weiter auszubauen. Wir sind überzeugt davon, dass diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeiträge liefern werden. Insgesamt richten wir den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Deswegen haben wir uns in unserem Geschäftsbericht diesem Thema gewidmet: weiter wachsen.

Unsere finanziellen Ziele für das vergangene Jahr waren angesichts der Ausgangslage ambitioniert. Die Herausforderung war, nach dem enttäuschenden Jahr 2005 mit einem Umsatzwachstum von nur 2,6 Prozent wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Damals hatten wir aus verschiedenen Gründen Aufträge verloren und umsatzstarke Projekte waren ausgelaufen. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass wir unser Ziel von rund zehn Prozent Wachstum in 2006 erreichen konnten.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Höhe von 19,8 Millionen Euro wurde durch erhebliche Vorleistungen bei Mikrosystemprojekten und den Anlauf der 8-Zoll-Fertigung belastet, trotzdem haben wir das zuletzt avisierte EBIT-Ziel von 12 Prozent vom Umsatz erreicht. Das war möglich, weil das operative Kerngeschäft in seiner Ertragsstärke die Belastungen aus Vorleistungen zum großen Teil kompensierte. Der Jahresüberschuss 2006 beträgt 10,7 Millionen Euro oder 6,7 Prozent vom Umsatz und liegt damit auch im Rahmen unserer Prognose. Den freien Cash Flow konnten wir erfreulich positiv gestalten, mit 8,6 Millionen Euro haben wir auch hier die gesetzten Ziele erreicht.

Lassen Sie mich nun einige wichtige Punkte nennen, die das bisher Erreichte und unsere Zielsetzung für 2007 charakterisieren:

- ▶ Die neue 8-Zoll-Fertigung in Duisburg hat Mitte 2006 erste Produkte an Kunden geliefert. Zum Ende des Jahres 2006 haben wir bis zu 50 Wafer pro Tag in die Fertigungslinie eingesteuert. Auch 2007 werden wir die Fertigung weiterhin mit hohem Engagement erweitern. Auf der Kundenseite werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um ein schnelleres Einfließen unserer auf 8-Zoll-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien zu erreichen.
- ▶ Parallel zum Start der neuen Fertigung in Duisburg haben wir den neuen Testbereich in Dortmund plangemäß in Betrieb genommen. Hier haben wir die Kapazitäten geschaffen, die für unser Wachstum nötig sind.
- ▶ Wir haben mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament für ein Wachstum in den Märkten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Märkte von derzeit rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.
- ▶ Wir haben den Startschuss für sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gegeben. Durch den vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstützung durch ELMOS Industries können wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste Projekte in Serie gehen.

- ▶ Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg großes Interesse bei den Kunden. Wir werden 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden große Vorteile bei ihren Applikationen bringt. Der erfolgreiche Start weiterer Projekte ist ein wichtiges Thema 2007.
- ▶ Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor für System-in-Package-Solutions eröffnet neue Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und Herstellung intelligenter Lösungen für die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. 2007 werden erste Produkte vorgestellt.
- ▶ Für unsere Vertriebsaktivitäten in Fernost haben wir einen kompetenten Partner in Südkorea gewonnen. Gemeinsam werden wir unsere Produkte in diesem Markt stärker forcieren.
- ▶ Mitte 2006 haben wir mit der Verlagerung des Standardgehäuse-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Mehr als 40 Prozent der in 2006 bei ELMOS Advanced Packaging erreichten Wertschöpfung war bereits höherwertigen Spezialgehäusen zuzurechnen. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehäuse im Jahr 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren.
- ▶ Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in Fertigungseinrichtungen tätigen zu müssen.
- ▶ Mit unserer nachhaltigen Initiative zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte haben wir Erfolg und erfahren positive Rückmeldung seitens unserer Kunden.

Sie sehen, wir haben das vergangene Jahr aktiv genutzt, um unsere Strategie in wesentlichen Punkten weiter zu entwickeln, Verbesserungen im operativen Bereich zu erzielen und die Weichen auf Wachstum zu stellen. Diese Aktivitäten werden mit unverminderter Energie 2007 fortgeführt.

Auch personell haben wir uns weiter verstärkt. Nicolaus Graf von Luckner verantwortet seit dem 1. Juli 2006 das Finanzressort. Damit wird der Bereich Finanzen im Vorstand – nach dem Tod des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Knut Hinrichs – wieder durch einen Kaufmann vertreten. Insgesamt verfügt Graf von Luckner über 27 Jahre Berufserfahrung im Automobilbereich. Seine Kompetenz ist eine wertvolle Bereicherung für uns.

Dr. Klaus Weyer hat zum 31. Dezember 2006 den Vorstand verlassen. Dennoch bleibt er als Mitgründer des Unternehmens und Pionier im Bereich der Automobilelektronik mit seinem Know-how als Aufsichtsratsmitglied der ELMOS weiter erhalten. Im Namen des gesamten Vorstandes danke ich Dr. Klaus Weyer ausdrücklich für seine herausragenden Leistungen.

Erwähnen wollen wir auch, dass das Jahr 2006 durch Umstände geprägt war, die uns vor zusätzliche Herausforderungen gestellt haben. Aufgrund der Schwäche der amerikanischen Automobilhersteller ist unser USA-Geschäft rund zehn Prozent unter unseren Erwartungen geblieben. Die Energie- und Rohstoffpreise, insbesondere bei unserem Ausgangsmaterial, den Silizium-Wafern, sind deutlich gestiegen. Diese Belastungen werden im Jahr 2007 anhalten.

Die Marktbedingungen bezüglich unserer Automobilkunden haben sich schneller als jemals zuvor geändert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr Unterstützung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand, andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Bürstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®, einsetzen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass wir das Jahr 2007 nutzen werden, um unsere Strategie weiter konsequent umzusetzen. Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme für erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb für eine weitere Effizienzverbesserung in den Abläufen sorgen. Von der Einführung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehäuse nach Fernost wird ebenfalls positive Beiträge zur Ergebnissituation liefern.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Anstrengungen, dem Marktumfeld und den erheblichen Vorleistungen erwarten wir 2007 ein solides Umsatzwachstum von rund zehn Prozent und eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Bruttomarge von rund 45 Prozent.

Sie sehen, ELMOS unternimmt große Anstrengungen, um nicht nur in 2007 weiter zu wachsen, sondern die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren zu schaffen. Das bisher Erreichte stimmt uns zuversichtlich, dass wir weitere Verbesserungen erzielen werden. Nicht zuletzt sind es auch die Rückmeldungen unserer Kunden, die mich positiv stimmen. In zahlreichen persönlichen Gesprächen haben sie unsere Leistungen anerkannt und uns mit ehrgeizigen Aufgabenstellungen zu weiteren Höchstleistungen angespornt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle den drei wichtigsten Eckpfeilern unseres Geschäftes einen besonderen Dank, auch im Namen des ganzen Vorstandes, aussprechen: unseren Kunden, weil wir ohne sie nicht gebraucht werden, unseren Mitarbeitern, weil wir von ihnen und ihren Leistungen als Firma getragen werden, und nicht zuletzt gilt unser Dank Ihnen, unseren Aktionären, die Vertrauen in unser Unternehmen haben.

Vor uns liegt ein Jahr der Weiterentwicklung und des weiteren Wachstums.

Ihr


Dr. Anton Mindl

Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG

Vorstandsmitglieder



von links: Nicolaus Graf von Luckner, Reinhard Senf, Dr. Klaus Weyer, Dr. Frank Rottmann, Dr. Anton Mindl

Dr. rer. nat. Anton Mindl *Diplom-Physiker | Lüdenscheid | Geboren 1957*

Vorstandsvorsitzender

Dr. Anton Mindl kam im Oktober 2005 zu der ELMOS Semiconductor AG und übernahm im Januar 2006 den Vorstandsvorsitz. Davor war er seit 2003 als Divisions-CEO bei SiemensVDO tätig, wo er zuerst die Division Cockpitmodule und Systeme leitete und dann die Infotainment Solutions übernahm. Von 1998 bis 2003 war Dr. Mindl Geschäftsführer für Entwicklung und Vertrieb bei Kostal. Die ersten elf Jahre war er bei Bosch und Bosch/Blaupunkt in verschiedenen Positionen tätig. Der Diplom-Physiker schloss 1982 sein Studium an der Technischen Universität München ab und promovierte im Jahre 1987.

Dr. rer. nat. Anton Mindl übte zum 31.12.2006 keine weiteren Mandate aus.
Er ist als Vorstand bis 2010 bestellt.

Nicolaus Graf von Luckner *Diplom-Volkswirt | Oberursel | Geboren 1949*

Nicolaus Graf von Luckner hat Volkswirtschaft in Kiel studiert. Er verfügt über 27 Jahre Berufserfahrung im Automobil-Bereich. Einem ersten Abschnitt bei der damals noch eigenständigen VDO folgten acht Jahre als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Danach setzte er seine berufliche Laufbahn bei VDO bzw. SiemensVDO fort. Bevor er zu ELMOS wechselte, war er bei SiemensVDO als CFO der Division Infotainment Solutions tätig. Graf von Luckner ist seit Juli 2006 Finanzvorstand der ELMOS.

Nicolaus Graf von Luckner übte zum 31.12.2006 keine weiteren Mandate aus.

Er ist als Vorstand bis 2011 bestellt.

Reinhard Senf *Diplom-Ingenieur | Iserlohn | Geboren 1951*

Reinhard Senf erwarb 1974 den Dipl.-Ing. Physik und Technik elektronischer Bauelemente an der TU Ilmenau. Von 1974 bis 1991 arbeitete er als Produktionsingenieur und später als Geschäftsführer im VEB Funkwerk/Mikroelektronik in Erfurt. Seit 1992 ist er bei ELMOS, zunächst als Assistent der Geschäftsführung, von 1993 bis 1999 als Bereichsleiter Qualitätswesen und darauf folgend als Bereichsleiter Backend. 2001 übernahm er den Bereich Produktion im Vorstand.

Reinhard Senf übte zum 31.12.2006 keine weiteren Mandate aus.

Er ist als Vorstand bis 2011 bestellt.

Dr. rer. nat. Klaus G. Weyer *Diplom-Physiker | Schwerte | Geboren 1948*

Dr. Klaus Weyer ist einer der Gründer von ELMOS. Er studierte Physik in Köln und promovierte anschließend an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Danach war er als Unternehmensberater im Bereich der Mikroelektronik für kleine und mittlere Firmen tätig. Von 1984 bis 1999 war er Geschäftsführer und von 1999 bis Ende Dezember 2006 Vorstand für Technik der Aktiengesellschaft. Zudem war er von März bis Dezember 2005 Vorstandsvorsitzender. Seit Januar 2007 ist er Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft.

Dr. rer. nat. Klaus G. Weyer übte zum 31.12.2006 folgende Mandate aus:

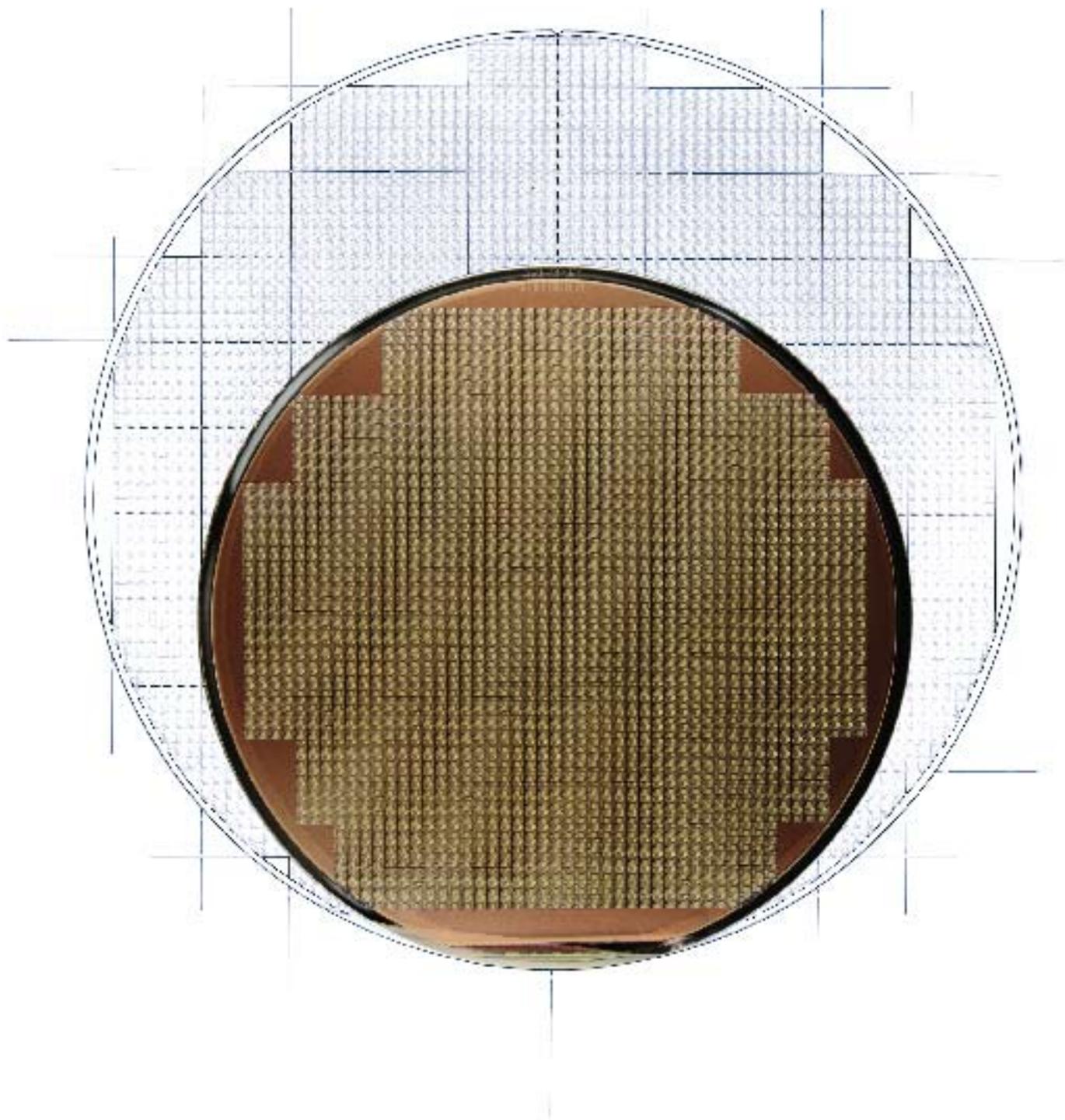
- ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Paragon AG
- ▶ Mitglied im MST Projektbeirat Dortmund

Dr.-Ing. Frank Rottmann *Diplom-Ingenieur | Dortmund | Geboren 1958*

Dr. Frank Rottmann ist seit 1992 in verschiedenen Positionen bei ELMOS aktiv. Zu Beginn seiner Laufbahn bei ELMOS war er im Vertrieb tätig, den er von 1997 bis 2003 leitete. Im Oktober 2003 wechselte er als Geschäftsführer für Vertrieb und Entwicklung zur MECHALESS Systems GmbH, einer Tochterfirma der ELMOS Semiconductor AG. Seit Oktober 2005 ist er Vorstand für Entwicklung und Vertrieb. Dr. Rottmann schloss sein Studium der Elektrotechnik 1984 an der Universität Dortmund ab und promovierte dort anschließend im Bereich Hochfrequenztechnik/Integrierte Optik.

Dr.-Ing. Frank Rottmann übte zum 31.12.2006 keine weiteren Mandate aus.

Er ist als Vorstand bis 2010 bestellt.



WEITER WACHSEN

durch

8-Zoll-Wafer

Was sind Wafer?

Ausgangsmaterial unserer Produkte sind Wafer (engl. für Scheibe). Sie sind metallisch-glänzend, aus einkristallinem Silizium gefertigt und noch nicht einmal einen Millimeter dick. In mehreren hundert Einzelschritten stellen wir darauf unsere Halbleiter-Schaltkreise her.

Warum wachsen wir durch 8-Zoll-Wafer weiter?

In unserer neuen Fertigung in Duisburg nutzen wir ausschließlich Wafer mit einem Durchmesser von 8 Zoll bzw. 200 Millimeter. Im Vergleich zum Hauptsitz in Dortmund, der mit 6-Zoll-Wafern arbeitet, passt rund die doppelte Menge an Chips auf einen Wafer.

Dies bedeutet für uns,

mehr Kapazität für hochvolumige Produkte.

Unser Profil

Unsere Ideen zünden die Lösungen unserer Kunden

Das Erfolgsrezept des Wachstums basiert auf drei Säulen: eigene CMOS-Technologie, eigenes Chip-Design und eigene Fertigung. Diese Vorteile bündeln wir durch ein einzigartiges Applikations-Know-how in einem Konzern. Unsere Abteilungen Chip-Design, Produktion, Qualitätswesen und Vertrieb stehen im ständigen Kontakt. Eine systematische Herangehensweise, die unseren Kunden den Weg zu ihrer Lösung wesentlich verkürzt.

Wir arbeiten mit unseren Kunden Hand in Hand und bieten ihnen umfangreiche Unterstützung und erstklassige Produkte. Das Wichtigste für uns ist, einen Chip herzustellen, der einfach besser funktioniert. Dies ist unsere tägliche Herausforderung. Das Wachstum ist der Beweis der erfolgreichen Arbeit.

Seit über 20 Jahren wachsen wir jedes Jahr. Seit dem Börsengang 1999 haben wir unseren Umsatz kontinuierlich gesteigert. Auch in schwierigen Zeiten haben wir unsere Flexibilität und Kompetenz gezeigt und ein positives Ergebnis vorgelegt. Der Grundgedanke lautet seit Gründung: Wir wollen ein langfristiges, profitables Wachstum.

Das Geheimnis in der Halbleiterindustrie ist mehr Funktionalität auf kleinerer Fläche. Wir haben dies verstanden und setzen es täglich mit immer kleineren Strukturgrößen und optimalem Chip-Design um. Darum wachsen wir.

Unsere Produkte begeistern unsere Kunden

Unsere Produkte sind das Kernstück unseres Wachstums. Sie helfen Ihnen jeden Tag und machen Ihren Alltag sicherer. Im Auto messen, steuern und regeln sie beispielsweise die Klimaanlage oder die Fahrzeugstabilität. Bei Antriebsanwendungen zeichnen sich unsere Lösungen durch hochpräzise analoge Eingangsverstärker, Leistungsendstufen und integrierte Mikroprozessoren aus – alles, was eine moderne Elektronik benötigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und effizient wie möglich zu gestalten. Dies ist besser für unsere Kunden und besser für unsere Umwelt.

Ein weiteres Beispiel des Wachstums: Unsere Lösung für die Zündung eines Airbags zeichnet sich seit mehr als zehn Jahren durch hohe Qualität aus. Wir entwickeln und produzieren für einen der größten Airbagsystemhersteller bereits die vierte Generation dieser unverzichtbaren Sicherheitsapplikation. Die Volumina erhöhen sich stetig.

Neben den Automobilanwendungen wollen wir vermehrt Chips für industrielle Produkte und Konsumgüter vertreiben. Schon jetzt steuern unsere Chips den Wasserstand in der Waschmaschine, das automatische Abschalten des Bügeleisens oder die exakte Messung der Personengewichte. Auch bei der automatischen Öffnung eines Mülleimers bis zum berührungslosen Dimmer für Lampen werden unsere Chips eingesetzt.

Dabei bieten wir unseren Kunden immer das Produkt an, welches für ihre Aufgaben die richtige Lösung ist: ein maßgeschneiderter Chip, ein Standardprodukt oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor, Auswerteelektronik und speziellem Gehäuse. Unsere Lösung soll die Kunden begeistern.

Unsere Produktion setzt auf fortschrittliche Technologien

Wir produzieren jährlich über 120 Millionen Chips. Dabei setzen wir in der gesamten Produktion auf fortschrittliche Technologien. Mehr als 150 Produkte befinden sich gleichzeitig in unserer Produktion am Hauptsitz in Dortmund.

Über 120 Millionen
Chips pro Jahr

Unsere Fertigung verfügt an verschiedenen Standorten über mehr als 5.000 Quadratmeter Fläche. Diese ist optimal auf unsere Anforderungen abgestimmt. Durch eine enge Einbindung aller Bereiche, insbesondere von Forschung und Entwicklung, dem Chip-Design und der Produktion, weisen unsere Produkte intelligente Funktionen auf und zeichnen sich durch höchste Qualität aus.

Unsere Fertigung verhilft unseren Produkten zu Spitzenleistungen und bringt unserem Unternehmen Wachstum.

Unsere Qualität liefert fehlerfreie Produkte

Unser Grundsatz für alle Produkte lautet: Wir erkennen Fehlerquellen schon im Vorfeld. Defekte werden, noch bevor sie auftreten können, beseitigt. Zusätzlich prüfen wir 100 Prozent unserer Chips auf „Herz und Nieren“. Zehn Millionen Testschritte pro Woche garantieren eine lückenlose Überprüfung und eine hohe Qualität.

Lückenlose
Überprüfung

Unsere Null-Fehler-Strategie ist die Basis für unser Wachstum. So tragen unsere Chips zu einem ungetrübten, umweltfreundlicheren Fahrvergnügen mit Ihrem Auto und einem reibungslosen, intuitiven Umgang mit Haushaltsgeräten bei. Für unsere Kunden steht unsere Qualität für ein perfektes Zusammenspiel zwischen unseren Chips und ihren Systemen. Das Ergebnis ist Wachstum für uns und unsere Kunden.

Unsere Standorte sind nah am Kunden

Die sprichwörtliche Nähe zum Kunden ist ein Geheimnis des Wachstums. Bei der Betreuung und der Beratung von der ersten Idee bis zum fertigen Chip ist ein ständiger Austausch notwendig. Deshalb besitzt EL MOS auf vier Kontinenten Vertriebsniederlassungen und garantiert schnelle Hilfe in direkter Nähe zum Kunden.

Wir haben den Anspruch, für alle Fragen der Kunden immer den richtigen Ansprechpartner zu haben. Dies betrifft das gesamte Produktportfolio von Auswerteelektronik über Sensorik bis hin zur Gehäuse-Technik für Systemlösungen auf Halbleiterbasis.

Daher befinden sich neben dem Hauptsitz in Dortmund Niederlassungen in Stuttgart, München und Paris. Also in direkter Nähe zu den großen europäischen Automobilherstellern. In Amerika betreuen wir Kunden vom Herzen der US-Automobilindustrie in Detroit aus und aus dem Silicon Valley in Kalifornien. In Asien sind wir in Tokio und Seoul vertreten.

Neben den Vertriebsbüros produzieren wir an vier Standorten auf zwei Kontinenten Halbleiterchips, Sensoren und Gehäuse. Durch die räumliche Trennung der Produktion führen wir Spezialisten verschiedener Länder zusammen und fördern den Wissensaustausch. Die Kompetenzen der Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Dortmund und Duisburg, den Niederlanden sowie den USA verbinden sich zu einem internationalen Produkt – einem Mikrosystem, welches ein neues, wichtiges Standbein unseres Wachstums wird.

Unsere Aktie

Allgemeine Entwicklung an den Börsen

Jahresschlusskurs
von 7,58 Euro

Die allgemein positive Stimmung am Aktienmarkt wurde im vergangenen Jahr von den Halbleiter- und Technologieaktien nur teilweise nachvollzogen. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor gut zwei Prozent, während der Kurs der ELMOS-Aktie im Jahr 2006 um knapp 16 Prozent sank. Die Aktie erreichte ihr Jahreshoch am 9. Februar 2006 mit 10,60 Euro. Vom Jahrestief am 18. Juli 2006 mit 6,67 Euro erholte sich der Aktienkurs bis Ende August und pendelte sich bis Anfang Dezember 2006 zwischen 7,50 Euro und 8,60 Euro ein. Der Markt honorierte noch nicht die erkennbaren Verbesserungen bei wesentlichen Kennzahlen. Zum Jahresschluss notierte die Aktie am 29. Dezember 2006 auf 7,58 Euro.

Relative Kursentwicklung 2006



Die Jahresperformance 2006 der ELMOS-Aktie ist mit – 15,8 Prozent deutlich schlechter als der TecDAX (25,5 Prozent) und der Philadelphia Semiconductor Index, SOX (– 2,4 Prozent).

Entwicklung der ELMOS-Aktie

Zeitraum bis 31. Dezember 2006	Seit 1.1.2005	Seit 1.1.2006
ELMOS (Xetra)	- 35,8%	- 15,8%
Branchenindizes		
TecDax	43,9%	25,5%
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	8,0%	- 2,4%
DJ Euro Stoxx Technology	26,0%	3,4%
Prime Technology	26,6%	31,9%
Prime Automobile	64,8%	25,7%
Allgemeine Marktindizes		
Dax	55,0%	22,0%
GEX	76,5%	27,9%

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der ELMOS-Aktie (Xetra und Frankfurt am Main) lag mit rund 37 Tausend Aktien wesentlich unter dem Vorjahreswert (rund 81 Tausend Aktien täglich). Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen in den ersten drei Quartalen nahm kontinuierlich ab und stieg erst im vierten Quartal wieder an. Rund 90 Prozent der Aktien wurden auf Xetra gehandelt.

ELMOS-Aktienkennzahlen

	2005	2006
Ausstehende Aktien in Stück	19.412.424	19.413.805
Höchstkurs (Xetra)	15,20 Euro 11.4.	10,60 Euro 9.2.
Tiefstkurs (Xetra)	8,83 Euro 15.12.	6,67 Euro 18.7.
Jahresendkurs (Xetra)	9,00 Euro	7,58 Euro
Jahresperformance (ohne Dividende)	- 23,7%	- 15,8%
Marktkapitalisierung am Jahresresultimo	174,7 Mio. Euro	147,2 Mio. Euro
Marktwert zu Buchwert* am Jahresresultimo	1,2	1,0
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag	84,0 Tausend	37,2 Tausend
Davon auf Xetra in Prozent	82%	94%
Ergebnis je Aktie	0,52 Euro	0,55 Euro
Dividende je Aktie	0,00 Euro	0,00 Euro**

* Bilanzielles Eigenkapital | ** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2007

Stammdaten

ISIN	DE0005677108
WKN	567710
Börsenkürzel	ELG
Reuters	ELGG.DE
Bloombergkürzel	ELGG.GR
Prime Branche	Technologie
Industry Group	Semiconductors

Die Marktkapitalisierung von ELMOS betrug zum Jahresende 147,2 Millionen Euro basierend auf 19,4 Millionen ausstehenden Aktien. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich 2006 durch Ausübung von Aktienoptionen nur unwesentlich verändert. Im laufenden Geschäftsjahr 2007 können aufgrund des Aktienoptionsprogrammes weitere neue Aktien entstehen.

Angaben zum Wertpapier

Art der Aktien (Gattung)	Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zulassungssegment	Prime Standard, Regulierter Markt
Börsengang	11. Oktober 1999
Designated Sponsors	HSBC Trinkaus & Burkhardt, WestLB
Indexzugehörigkeit	CDax, GEX, Prime All Share, Tech All Share

Basisinformationen zur Aktie

Die ELMOS-Aktie ist eine Inhaberaktie ohne Nennwert (Stückaktie). Sie wird an allen deutschen Wertpapierbörsen sowie im Xetra-System gehandelt. ELMOS ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Prime Standard Unternehmen müssen über das Maß des General Standards hinaus, der die gesetzlichen Mindestanforderungen des amtlichen Marktes oder des Regulierten Marktes stellt, hohe internationale Transparenzanforderungen erfüllen. ELMOS ist zudem Bestandteil des Anfang 2005 eingeführten German Entrepreneurial Index (GEX). Dem GEX gehören Unternehmen an, die neben der Notierung im Prime Standard noch die Kriterien der Eigentümerdominanz (gründer- oder eigentümergeführte Unternehmen) und des Post-IPO-Alters (maximal zehn Jahre nach Börsengang) erfüllen.

Aktionärsstruktur

Das Grundkapital der ELMOS Semiconductor AG ist eingeteilt in 19.413.805 nennwertlose Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden, anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro. Von diesen Aktien werden 52,9 Prozent (rund 10,3 Millionen Aktien) von der ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) gehalten, die die stabile Aktionärsbasis der ELMOS darstellt. Die EFH befindet sich im Besitz von Dr. Klaus Weyer, Prof. Dr. Günter Zimmer und der Familie von Knut Hinrichs, dem früheren Vorstandsvorsitzenden.

47,1 Prozent der Aktien (rund 9,1 Millionen Aktien) befinden sich im Streubesitz. Gemessen am bekannten Streubesitz (ca. ein Fünftel des gesamten Streubesitzes) halten deutsche Aktionäre rund 30 Prozent der Aktien des Streubesitzes, Schweizer Investoren gut 27 Prozent und das sonstige Kontinentaleuropa ist mit rund 32 Prozent der Aktien des Streubesitzes vertreten, während Investoren in den USA weitere 11 Prozent der bekannten Aktien halten.

Abgesehen von der EFH hält zum Ende des Berichtsjahres kein Aktionär mehr als 5 Prozent des Grundkapitals von ELMOS; die zehn größten Aktionäre (ohne EFH) besitzen rund 77 Prozent des bekannten Streubesitzes (bzw. knapp 7 Prozent des Grundkapitals).

Investor Relations

Im Jahr 2006 haben das ELMOS Management und das Investor Relations Team eine Vielzahl von Einzelgesprächen mit Investoren geführt. Diese fanden im Rahmen von Roadshows, Technologie- und Automobilkonferenzen, auf denen sich ELMOS präsentiert hat und bei Unternehmensbesuchen am Standort Dortmund statt. Auf knapp 20 Konferenzen und Roadshows in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Benelux-Länder und Skandinavien) und den USA hat ELMOS den Dialog mit Analysten und Investoren gepflegt. Darüber hinaus informierten wir Analysten und Investoren in Form von Telefonkonferenzen im Anschluss an die Veröffentlichung von Ergebnissen und auf Wunsch auch einzelne Aktionäre. Des Weiteren haben wir auf unserer Analystenkonferenz am 6. Dezember 2006 in Dortmund umfassend die Strategie und Geschäftsentwicklung erläutert.

Die Aktivitäten werden auch im kommenden Jahr in umfangreichem Maße weitergeführt. Hiermit ermöglichen wir unseren Aktionären und anderen interessierten Kapitalmarktteilnehmern,

Research-Coverage

CAI Cheuvreux
Credit Suisse First Boston
Dawnay, Day Lockhart
DZ Bank
Fairesearch
HSBC Trinkaus & Burkhardt
IXIS Securities
Kepler Equities
SES Research MM Warburg
Viscardi Securities
WestLB

unsere Geschäftslage angemessen zu bewerten und insbesondere unsere Perspektiven einzuschätzen. Unser Ziel ist es, frühzeitig und umfassend zu informieren und jederzeit erreichbar zu sein – für private und institutionelle Investoren, für Analysten und interessierte Anleger. Anfang 2007 empfiehlt die Mehrheit der ELMOS beurteilenden Analysten die Aktie mit positivem Ausblick.

Im Bestreben nach umfassender und zeitnaher gleicher Information für alle Zielgruppen haben wir auf unserer Website zahlreiche Unternehmensinformationen bereitgestellt. Interessierte Anleger können sich im Internet unter www.elmos.de ausführlich über das Unternehmen, seine Produkte und Technologien informieren. In der Sektion Investor Relations werden neben Informationen zur Corporate Governance auch Finanzberichte (Geschäfts- und Quartalsberichte), ein Finanzkalender zu allen wesentlichen Terminen und Veröffentlichungen, die Satzung der Gesellschaft, Informationen zur Hauptversammlung, Pressemitteilungen und meldepflichtige Wertpapiergeschäfte präsentiert. Das Investor Relations Team verschickt zudem Informationen, wie Geschäftsbericht oder Quartalsberichte, auch gern per Post.

Umfassende
Informationen

Hauptversammlung

An der siebten Ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2006 nahmen, wie in den vergangenen Jahren, rund 300 private und institutionelle Investoren teil. Die Veranstaltung fand erstmals im Casinosaal Hohensyburg in Dortmund statt. Es waren 12.770.335 Euro oder 65,8 Prozent des Grundkapitals präsent. Die Vorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten nahm die Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit an. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wurde die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die Aufhebung eines bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit entsprechender Satzungsänderung sowie die Änderung eines weiteren bereits 2004 bedingten Kapitals beschlossen. Eine weitere Satzungsänderung, die den Anforderungen des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechtes gerecht wird, wurde ebenso beschlossen wie das Unterbleiben der in §285 und §314 HGB verlangten individualisierten Angaben zur Vorstandsvergütung.

Bei der Hauptversammlung 2006 ist von der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, erneut rege Gebrauch gemacht worden. Aktionäre, die nicht persönlich vor Ort waren, konnten 2006 die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Bei der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 haben Aktionäre wieder die Möglichkeit, die Internetübertragung zu nutzen. Zudem können Aktionäre ihr Stimmrecht selbst ausüben oder entweder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Übertragung der
Hauptversammlung
im Internet

Kontakt ELMOS Semiconductor AG

Investor Relations

Heinrich-Hertz-Straße 1 | 44227 Dortmund | Deutschland

Telefon +49 (0) 231-75 49-287 | Telefax +49 (0) 231-75 49-548

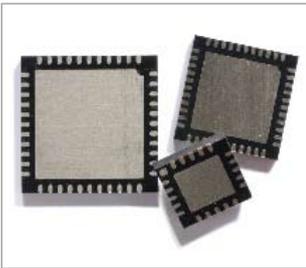
invest@elmos.de | www.elmos.de

2006 im Blick

1. Quartal

Dr. Anton Mindl übernimmt Vorstandsvorsitz

Im Januar 2006 hat Dr. Anton Mindl den Vorstandsvorsitz der ELMOS Semiconductor AG übernommen. Durch seine 20-jährige Erfahrung in der Automobilbranche hat er schon nach kurzer Zeit wichtige Impulse für das laufende Geschäft und die Zukunft des Unternehmens gegeben. Zuletzt war er bei einem wichtigen Kunden von uns, SiemensVDO, als Chief Executive Officer (CEO) für die Division Infotainment Solutions verantwortlich.



Standard-Chips im QFN-Gehäuse

Applikations-Standard-Chips rücken in den Fokus

Wir bauen unser Applikations-Standard-Chip-Portfolio konsequent aus. Die Bandbreite reicht dabei von Halbleitern für Sensor-Schnittstellen und Hall-Sensorik über Ripple-Detektion-IC bis zur Lüfteransteuerung. Dabei steht immer ein unkomplizierter Zugang zu den Produkten für unsere Kunden im Vordergrund. So stellen wir beispielsweise in einer Broschüre zwölf Chips vor, die jeweils mit Gehäuse-Spezifikationen, Betriebsspannungsbereich, Arbeitstemperatur sowie weiteren elektrischen Merkmalen beschrieben werden.

Jahresabschluss präsentiert

Auf der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz gibt der Vorstand den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 bekannt. Dabei geht Dr. Anton Mindl neben den Ergebnissen insbesondere auf die richtungsweisenden Themen 2006 ein. Dies sind unter anderem die Vorbereitungen für den erfolgreichen Start der Produktion am neuen Standort Duisburg sowie für den Beginn von Mikrosystemprojekten. Insgesamt stellt der Vorstand nach dem enttäuschenden Jahr 2005 wieder deutlich positive Perspektiven in Aussicht.

2. Quartal

Aufsichtsrat beruft Finanzvorstand

Der Aufsichtsrat hat Nicolaus Graf von Luckner zum Finanzvorstand berufen. Er wird diese Position zum 1. Juli 2006 antreten. Damit ist im Vorstand das Finanzressort – nach dem Tod des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Knut Hinrichs – wieder durch einen Kaufmann vertreten. Graf von Luckner verfügt über 27 Jahre Berufserfahrung im Automobilbereich und war unter anderem in leitender Funktion bei SiemensVDO tätig.

Erfolgreiche Hauptversammlung

Rund 300 Aktionäre nahmen an unserer siebten Ordentlichen Hauptversammlung teil. Alle Tagesordnungspunkte haben die Anteilseigner mit großer Mehrheit angenommen. Zudem erläuterte der Vorstand die aktuelle Produkt- und Geschäftsstrategie. Dabei ging er insbesondere auf persönliche Gespräche bei Kunden und deren positive Reaktionen auf das Produkt-Portfolio ein.

Umweltbericht erschienen

Bei uns sind der Umweltschutz und die Arbeitssicherheit feste Bestandteile der Unternehmensführung. Der jährlich erscheinende Umweltbericht informiert umfassend über alle Aktivitäten auf diesen Gebieten. So hat beispielweise erstmals der relative Erdgasverbrauch die Grenze von 1.000 MWh/m² produzierte Waferfläche unterschritten. Damit hat sich der relative Verbrauch in den Jahren von 2002 bis 2005 halbiert.



7. Ordentliche Hauptversammlung

3. Quartal

Erste Produkte aus Duisburg

Die neue Fertigungsstätte in Duisburg hat im Juli 2006 erste Produkte an Kunden geliefert. Erfreulich sind die durchweg hohen Ausbeuten. Im Mittelpunkt des Produktionsanlaufs standen hochvolumige Produkte, die als erste von Dortmund nach Duisburg verlagert worden sind. Der Standort Duisburg produziert auf 8-Zoll-Wafern. Damit kann im Vergleich zum Hauptstandort in Dortmund, der mit 6-Zoll-Wafern arbeitet, rund die doppelte Menge an Chips auf einem Wafer produziert werden. Die Kapazität ist signifikant erhöht.

Neuer Testbereich gestartet

Kurz nachdem die neue Fertigungsstätte in Duisburg erste Produkte lieferte, haben wir am Hauptsitz in Dortmund den neuen Testbereich in Betrieb genommen. Momentan führt unser Testbereich wöchentlich zehn Millionen Testschritte aus. Unter anderem werden die Halbleiterchips unter extremen Temperaturen von -40°C bis zu $+175^{\circ}\text{C}$ auf einwandfreie Funktion getestet. Durch den Start beider Produktionseinrichtungen haben wir wichtige Voraussetzungen für das zukünftige Wachstum geschaffen.

Zukunftsweisende Kooperation

Wir werden in Zukunft bei ausgewählten Bauteilen eng mit dem amerikanischen Halbleiterhersteller Freescale kooperieren. Durch diese strategische Allianz werden den Kunden schon 2007 erste Multi-Chip-Produkte angeboten. Dabei steht eine Kombination der Kernkompetenzen beider Unternehmen im Mittelpunkt. Die Produkte werden daher die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontrollerarchitekturen (MCU) von Freescale mit den Hochvolt-CMOS Standardprodukten von uns vereinen.



Neue 8-Zoll-Fertigung in Duisburg

4. Quartal

Tochter stellt Rekord auf

Unsere Tochter Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien/USA, stellte einen Produktionsrekord auf. 40.000 Drucksensoren werden in der kürzlich modernisierten Fertigung pro Tag hergestellt. Der Drucksensor von SMI wird in einem breiten Applikationsfeld verwendet. Es reicht von Hochdruck-Systemen im Automobil über Niederdruck-Applikationen im Medizinsektor. Zudem hat SMI das ISO/TS 16949 Zertifikat erhalten. Die Zertifizierung bestätigt die Einhaltung der Automobilzulieferer-Richtlinien bei standardisierten Produktionsprozessen.

Innovationen im Messeherbst

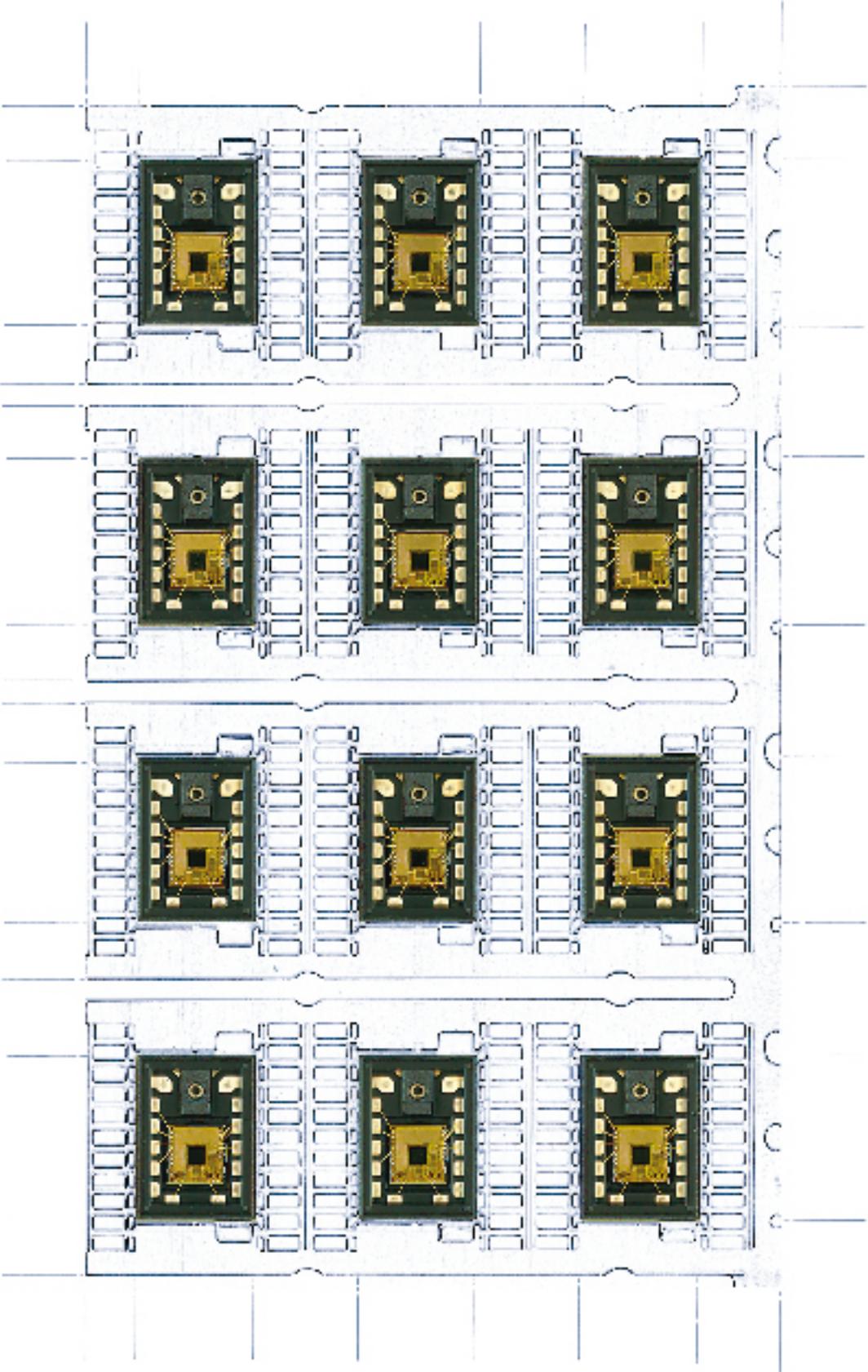
Der Herbst stand ganz im Zeichen der wichtigsten Branchenmessen. Unter anderem haben wir unser Portfolio auf der Convergence in Detroit, USA, und der electronica in München präsentiert. Auf besonderes Interesse stieß das neue Verfahren zur sensorlosen Ansteuerung von Elektromotoren. Diese werden aufgrund bedeutsamer Vorteile vermehrt in Automobil- und Industrieanwendungen eingesetzt. Es sind Standardprodukte und kundenspezifische Halbleiterlösungen geplant. Die Entwicklung hat begonnen und wird intensiv fortgesetzt.

Schwerpunkt auf Spezialgehäuse

Unser Standort in den Niederlanden, ELMOS Advanced Packaging, wird sich künftig auf Spezialgehäuse für Halbleiterbausteine konzentrieren. Nach unserer Akquisition des Spezialisten für Gehäuse im Jahre 2001 war das erste Ziel, dort den automobilen Standard zu etablieren und in der Folge die Produktionsvolumina zu erhöhen. Dabei wurde von über 50 Kunden die Freigabe für die Fertigungsstätte eingeholt. Halbleiterbausteine, die ein kostengünstiges Standardgehäuse benötigen, werden in Zukunft vermehrt in Fernost assembliert.



ELMOS auf der electronica in München



WEITER WACHSEN

durch

Applikations-Standards

Was sind Applikations-Standards?

Applikations-Standards sind Produkte, die in einer bestimmten Anwendung eine Funktion erfüllen. Diese Chips sind zwar an die Anwendung gebunden, nicht aber an einen einzelnen Kunden. Ein Beispiel dafür ist unser standardisierter Chip für die Messung von Druck. Einsatzort ist u.a. der Ansaugtrakt eines Ottomotors.

Warum wachsen wir durch Applikations-Standards weiter?

Mit Applikations-Standards können wir unseren bestehenden Kunden eine größere Vielfalt anbieten und gleichzeitig neue Kunden ansprechen. Die Grundlage dafür ist unser Portfolio von standardisierten Schaltungsblöcken. In Verbindung mit dem Fertigungs-Know-how können wir in kurzer Zeit ein hohes Volumen von qualitativ hochwertigen Halbleitern anbieten.

Für den Kunden bedeutet dies **eine schnelle Umsetzung seiner Ideen.**

Corporate Governance Bericht

Eine verantwortungsvolle und transparente Unternehmensleitung ist einer der wichtigsten Aspekte unserer Unternehmenskultur. Dies gilt für sämtliche Bereiche und im gesamten Konzern. Vorstand und Aufsichtsrat berichten gemeinsam über die Corporate Governance bei ELMOS.

Mit der Entsprechenserklärung legt ELMOS offen, dass die Gesellschaft in vier Punkten von den Empfehlungen des Kodexes abweicht. Dies betrifft den Selbstbehalt der Organmitglieder für die D&O Versicherung (Ziffer 3.8), die Vergütung der Mitglieder in den Aufsichtsratsausschüssen (Ziffer 5.4.7) sowie die individualisierte Offenlegung der Gehälter von Vorstand und Aufsichtsrat (Ziffern 4.2.4 und 5.4.7). Die Entsprechenserklärung ist im Geschäftsbericht im Anschluss an diesen Corporate Governance Bericht abgedruckt.

Enge Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand hinsichtlich der Leitung des Unternehmens. Er ist an allen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für den Konzern beteiligt und ernannt oder entlässt die Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und aktuell über alle Entwicklungen und Ereignisse, die für die Geschäftsentwicklung und die Lage des ELMOS-Konzerns von Bedeutung sind. Auch im abgelaufenen Berichtsjahr haben Vorstand und Aufsichtsrat wieder eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die Geschäftsordnungen beider Organe regeln unter anderem diese Zusammenarbeit.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen. Herbert Sporea hat mit Wirkung zum Ende Dezember 2006 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Dr. Klaus Weyer, Vorstandsmitglied bis Dezember 2006, wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Der Hauptversammlung im Mai 2007 soll vorgeschlagen werden, Dr. Klaus Weyer als Aufsichtsratsmitglied für die restliche Amtszeit von Herbert Sporea, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2010 zu wählen. Mit ihren verschiedenen beruflichen Werdegängen spiegeln die für fünf Jahre gewählten Aufsichtsratsmitglieder die Vielfalt der Aktivitäten der ELMOS wider. Nähere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats können der Organübersicht entnommen werden.

Der Vorstand ist das ausführende Organ von ELMOS. Dr. Anton Mindl hat im Januar 2006 den Vorsitz im Vorstand von Dr. Klaus Weyer übernommen. Im Juli 2006 wurde Nicolaus Graf von Luckner in den Vorstand berufen und hat dort das Ressort Finanzen übernommen. Dr. Klaus Weyer ist, wie oben erwähnt, im Dezember 2006 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Transparenz für unsere Aktionäre

ELMOS ist stets bestrebt, eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Unsere Aktionäre werden regelmäßig über die aktuellsten Entwicklungen des Unternehmens bezüglich der Finanzlage und der strategischen Ausrichtung informiert.

Wichtige Termine für die Aktionäre werden jährlich in einem Finanzkalender veröffentlicht. Alle Quartals- und Geschäftsberichte und Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Internetseite publiziert sowie über weitere Distributionskanäle öffentlich gemacht. Wir führen regelmäßige Treffen mit Analysten und institutionellen Anlegern durch. Das Informationsangebot unserer Internetseite wird ständig erweitert, um unsere Aktionäre noch umfassender zu informieren.

Größtmögliche
Transparenz

§15a des Wertpapierhandelsgesetzes sieht vor, dass Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats oder ihnen nahestehende Personen den Erwerb und die Veräußerung von ELMOS-Aktien offen legen. Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte veröffentlichen wir auf unserer Homepage und im Corporate Governance Bericht. Zukünftig werden wir diese Daten gemäß neuer Gesetzeslage europaweit verbreiten und ins Unternehmensregister stellen.

Die Hauptversammlung ist für unsere Aktionäre die wichtigste Plattform zur Ausübung ihrer formalen Rechte. Die Aktionäre erhalten im Vorfeld unseren Geschäftsbericht und die Tagesordnung. Das Anmelde- und Legitimationsverfahren haben wir auf das seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts vorgeschriebene „Record Date“ umgestellt. Die Hauptversammlung wird vollständig per Webcast auf unserer Internetseite übertragen, um auch denen die Verfolgung der Veranstaltung zu ermöglichen, die aus Zeitgründen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auf von ELMOS ernannte Stimmrechtsvertreter zu übertragen. Sämtliche Dokumente zum Thema Hauptversammlung sowie weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmabgabe sind auf unserer Internetseite verfügbar oder können dort angefordert werden. Die nächste Hauptversammlung findet am 10. Mai 2007 in Dortmund statt.

Vorausschauendes Risikomanagement

Bewusstes unternehmerisches Risikomanagement ist ebenfalls ein Teil guter Corporate Governance. Ein solches Risikomanagement trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Alle Bereiche des Unternehmens geben regelmäßig eine Einschätzung der mit ihrem Gebiet verbundenen Risiken ab. Die Risiken werden bewertet und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Parameter für die Einschätzung eines Risikos sind Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Schadenshöhe. Diese Risikoeinschätzung wird vierteljährlich, im Bedarfsfall auch kurzfristiger aktualisiert. Über die aktuellen Unternehmensrisiken berichten wir im Lagebericht.

Regelmäßige Einschätzung
der Risiken

Abschlussprüfung durch Ernst & Young

Bevor der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers unterbreitet wurde, holte der Aufsichtsrat vom Prüfer eine Erklärung ein, inwieweit Beziehungen des Prüfers, seiner Organe und Prüfungsleiter zu der Gesellschaft oder deren Organmitgliedern bestehen. Zweifel an deren Unabhängigkeit bestanden nicht. Der Aufsichtsrat hat entsprechend Ziffer 7.2.3 des Corporate Governance Kodexes mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser über alle Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung er-

geben und für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlich sind. Ebenso legte er fest, dass der Prüfer den Aufsichtsrat informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er Abweichungen von der vom Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex ermittelt. Solche Unrichtigkeiten wurden nicht festgestellt.

Verhaltenskodex

Detaillierte Informationen
über die unternehmerische
Verantwortung

ELMOS hat seine hohen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche in einem „Kodex des verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex informiert detailliert über die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns. Damit will ELMOS zu einwandfreiem Verhalten und angemessenem Umgang mit Interessenkonflikten anhalten.

Vergütungsbericht

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich an der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Konzerns. Dem Personalausschuss obliegt die Festlegung der angemessenen Vergütung. Die Gesamtvergütung umfasst unterschiedliche Vergütungsbestandteile. Es handelt sich einerseits um erfolgsunabhängige Komponenten wie ein fixes Monatsgehalt, Nebenleistungen und Pensionszusagen sowie andererseits um erfolgsabhängige Komponenten wie die variablen Bezüge.

Das fixe Monatsgehalt ist eine leistungsunabhängige Grundvergütung. Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Vorstands Nebenleistungen in Form von Sachbezügen wie Übernachtungskosten und Dienstwagenutzung sowie Pensionszusagen. Die variablen Bezüge sind so strukturiert, dass sie einen deutlichen Anreiz für das Erreichen der vorgegebenen Ziele darstellen. Sie leiten sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ab.

Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird in Anbetracht der Wahrung der Privatsphäre verzichtet. Eine solche Offenlegung trägt nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten Transparenz in Form von zusätzlichen kapitalmarktrelevanten Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19. Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungs-Gesetz vom 3. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung zu befreien.

Gesamteinkommen der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2006 in Tausend Euro:

	Fixe Bezüge Tausend Euro	Variable Bezüge Tausend Euro	Aktienoptionen Stück
Vorstand	1.522	565	0

ELMOS hat für Pensionszusagen (unmittelbare Zusage) gegenüber Mitgliedern des Vorstands Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.066 Tausend Euro (2005: 2.871 Tausend Euro) gebildet. Des Weiteren bestehen für Mitglieder des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden sind. In 2006 betragen die Beiträge für diese Pensionspläne 341 Tausend Euro (2005: 177 Tausend Euro). Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2006 79 Tausend Euro. Ferner wurde eine Prämie für eine Rückdeckungsversicherung in Höhe von 53 Tausend Euro entrichtet. Für sie besteht eine Pensionsrückstellung in Höhe von 1.494 Tausend Euro.

Weitere Leistungen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit sind keinem Vorstandsmitglied zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten. Im Jahr 2006 wurden keine Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder ausgegeben.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Der Aufsichtsrat nimmt nicht am Aktienoptionsprogramm teil.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der Vorsitzende das Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2006 in der Summe 126 Tausend Euro. Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 281 Tausend Euro.

Da in 2006 keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, wurde an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006 keine variable Vergütung gezahlt.

Wertpapiergeschäfte

Aufgeführt sind Transaktionen im Jahr 2006 bezogen auf Aktien der ELMOS Semiconductor AG (ISIN DE0005677108).

Datum / Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs/ Basispreis	Gesamt- volumen
30. März 2006/ Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	9,55 Euro	9.555 Euro
23. Mai 2006/ Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,97 Euro	7.970 Euro
24. Mai 2006/ Xetra	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,95 Euro	7.950 Euro
06. Juni 2006/ Frankfurt/Main	Felix Christian Mindl	minderjähriger Sohn von Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	100	7,84 Euro	784 Euro

Aktienbesitz

Am 31. Dezember 2006 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien und Aktienoptionen von ELMOS:

Vorstand	Aktien	Optionen
Dr. Klaus Weyer	10.000	25.000
Dr. Anton Mindl	7.250	0
Reinhard Senf	1.948	40.000
Dr. Frank Rottmann	0	9.200
Nicolaus Graf von Luckner	1.000	0
Aufsichtsrat	Aktien	Optionen
Prof. Dr. Günter Zimmer	0	0
Dr. Burkhard Dreher	1.900	0
Jörns Haberstroh	3.956	0
Herbert Sporea	4.165	0
Dr. Peter Thoma	9.200	40.000
Jutta Weber	200	0

Dortmund, im März 2007

Für den Aufsichtsrat
Prof. Dr. Günter Zimmer

Für den Vorstand
Dr. Anton Mindl

Entsprechenserklärung

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Dezember 2006 die nach §161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG erklären gemäß §161 AktG:

„Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (kurz: DCGK) in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden Ausnahmen:

- ▶ Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCGK Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- ▶ Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen Komponenten, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktioptionen) ausgewiesen. Jedoch erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK Nr. 4.2.4). Von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungs-Gesetz vom 03. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zu einer individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütungen ist die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Mai 2006 für einen Zeitraum von fünf Jahren befreit.
- ▶ Auch die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Corporate Governance Bericht angegeben (DCGK Nr. 5.4.7).
- ▶ Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet (DCGK Nr. 5.4.7).“

Dortmund, im Dezember 2006

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

Unsere Verantwortung

Verantwortung für unsere Umwelt

Unser Ziel ist es, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Im Idealfall verringern wir mit einer Maßnahme die Umweltauswirkungen, verbessern die Arbeitssicherheit und erzielen ökonomische Einspareffekte. Sämtliche Prozesse innerhalb der Produktion werden kontinuierlich auf Verbesserungen und Einsparpotenziale analysiert. Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass Mitarbeiter und Anwohner auch zukünftig in einer gesunden Umwelt leben können.

ELMOS lebt ein Umweltmanagementsystem entsprechend den strengen rechtlichen Anforderungen gemäß DIN EN ISO 14001. Dies wird jährlich durch externe Fachleute bestätigt. Das Fundament hierzu bildet die ELMOS-Umweltpolitik. In ihr sind die Grundlagen für das umweltgerechte Handeln von Führungskräften und Mitarbeitern verbindlich festgelegt. Mithilfe unseres Umweltmanagementsystems gewährleisten wir Rechtssicherheit. Die Mitglieder des Vorstands tragen die Gesamtverantwortung für den Umweltschutz. Wesentliche Funktionen im Umweltschutz und in der Arbeitssicherheit sind als Stabsfunktion dem Vorstand direkt unterstellt. Das gemeinsame Handeln aller Führungskräfte und Mitarbeiter entsprechend den in der Umweltpolitik festgelegten Grundsätzen füllt das Umweltmanagementsystem mit Leben. Jeder Mitarbeiter wirkt an der Reduzierung von Umweltbelastungen mit. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür schaffen wir durch bedarfsorientierte Schulungen und Weiterbildung der Mitarbeiter zu umwelt- und sicherheitsrelevanten Themen.

Oberstes Ziel unseres Abfallmanagements ist die Abfallvermeidung. Nicht vermeidbare Abfälle werden verwertet, wann immer dies ökologisch sinnvoll und technisch machbar ist. Abfälle mit höchster Umwelrelevanz sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle. Verbesserte Wartungsintervalle und eine bessere Abfalltrennung haben in den vergangenen sechs Jahren die Menge der Materialien mit schädlichen Verunreinigungen (beispielsweise Tücher) pro Quadratmeter Waferfläche um mehr als die Hälfte reduziert.

Ein Beispiel für das Engagement ist die folgende Verbesserung: In der Fotolithographie, einem bedeutenden Produktionsschritt in der Herstellung unserer Chips, wurde ein Gefahrstoff per Hand in eine Anlage eingefüllt. Ein Service-Ingenieur konstruierte aus eigener Motivation einen Dosierwagen, der mit Sicherheitsschnellverschlüssen an die Anlage angeschlossen wird. Die Mitarbeiter brauchen nun nicht mehr mit dem Gefahrstoff zu arbeiten. Zudem wird Abfall vermieden und die laufenden Kosten sinken.

Auszeichnung für Engagement

Für unser Engagement zeichneten uns Kempen Capital Management und SNS Asset Management in den Niederlanden aus. Dieses bestätigt unsere Anstrengungen hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit und für soziale Belange. Parallel zu der Prämierung sind wir als Kandidat für den Kempen/SNS Smaller Europe Social Responsibility Index vorgeschlagen worden.

Alle Daten und Fakten zu unserer Verantwortung für die Umwelt publizieren wir jährlich in einem Umweltbericht, der umfassend über den Umweltschutz, die Arbeitssicherheit und die Umweltauswirkungen am Standort Dortmund informiert. Dieser Umweltbericht steht auf unserer Homepage zum Herunterladen zur Verfügung oder kann kostenlos angefordert werden.

Verantwortung für unsere Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource und eine große Stärke zur Erreichung unserer unternehmerischen Ziele. Aus diesem Grund sind wir uns unserer sozialen Verantwortung, die wir für unsere Mitarbeiter als Arbeitgeber tragen, bewusst und erfüllen diese mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Die Fluktuation ist seit Jahren sehr gering und spiegelt die Kontinuität und das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserem Unternehmen wider. Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Der offene und kooperative Stil der Unternehmenskultur findet sich in allen Bereichen unseres Unternehmens wieder. Das Prinzip der „offenen Türen“ ist daher ein wichtiger Grundsatz in unserem Konzern.

Ein Schwerpunkt der nachhaltigen Strategie ist die Schaffung von beruflichen Perspektiven für Mitarbeiter. Daher fördern wir aktiv die Kreativität und geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr persönliches Potenzial zu erweitern und herausragende Leistungen zu erbringen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber sehen wir es zudem als unsere Aufgabe und Pflicht an, Mitarbeitern zu helfen, die sich in einer Notsituation befinden. Wir versuchen dieses Ziel unter anderem durch finanzielle Unterstützung, durch eine eigens hierfür angelegte Unterstützungskasse, die dem Initiator und langjährigen, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Knut Hinrichs gewidmet ist, zu verwirklichen.

Berufliche
Perspektiven

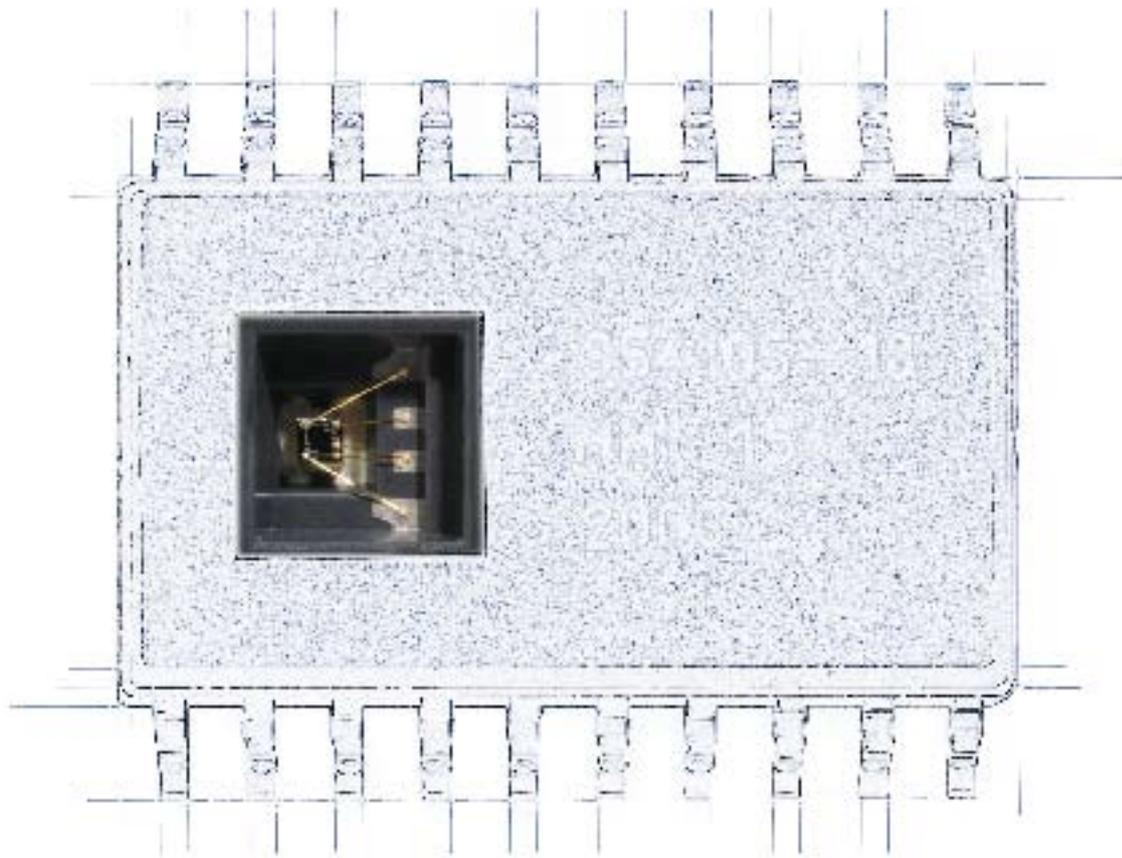
Verantwortung für die Gesellschaft

Es ist uns als Unternehmen ein wichtiges Anliegen, auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Die Jugend- und Ausbildungsförderung gehört für uns zur Verantwortung ebenso wie die Unterstützung von wohltätigen Einrichtungen. Wir beabsichtigen, im Sinne der Nachhaltigkeit, auch jenseits unserer Geschäftsinteressen einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und soziale Verantwortung zu übernehmen.

Wir sehen es aber zudem als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, jungen Menschen die Möglichkeit einer qualifizierten Ausbildung zu geben. Die heutigen Auszubildenden sind unsere Fachleute von morgen. Knapp die Hälfte der jeweils neuen Auszubildenden erlernt typischerweise den Beruf des Mikrotechnologen, der Ende der Neunziger Jahre entstanden ist und maßgeblich von uns mitgestaltet wurde. Zudem kooperieren wir mit der RAG Bildung, welche seit 2001 eine Umschulung zum Mikrotechnologen anbietet. Neben Mikrotechnologen bieten wir eine Vielzahl von Ausbildungsgängen an, die den Interessen und Talenten der künftigen Mitarbeiter entgegenkommen.

Qualifizierte
Ausbildung

In den vergangenen Jahren haben wir durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Spendenaktionen versucht, Beiträge zur Minderung akuter Probleme im In- und Ausland zu leisten. Durch unsere Spenden versuchen wir natürlich auch, regionale Einrichtungen zu unterstützen. So haben wir unter anderem Spenden für die Kinderkrebstation eines lokal ansässigen Krankenhauses sowie für die Dortmunder Tafel e.V. gesammelt und finanzieren ein viel beachtetes Kulturprogramm in Dortmund mit.



WEITER WACHSEN

durch

Mikrosysteme

Was sind Mikrosysteme?

Mikrosysteme sind die Kombination von Sensoren und Auswerteelektronik in einem speziellen Gehäuse. Ergebnis ist ein komplettes System für die Messung von Druck, Beschleunigung oder Neigung. Einsatzort im Automobil ist beispielsweise ein Mikrosystem für die präzise Steuerung eines Airbags.

Warum wachsen wir durch

Mikrosysteme weiter?

Ein Mikrosystem ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Sie sind erste Wahl, wenn kostenoptimiert, auf kleinstem Raum und zuverlässig der Druck, die Beschleunigung oder die Neigung gemessen werden muss. Zudem erfüllen sie den Kundenwunsch nach wenigen Schnittstellen.

Für unsere Kunden bedeutet dies

höchst effiziente Lösungen für ihre Produkte.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2006 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Unverändert wird ELMOS, wie auch in den vergangenen Jahren, mit 12 Prozent Marktanteil von dem Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest im März 2006 als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach den Firmen STMicroelectronics und NEC aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichteten Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung zu überzeugen. So entwickelt ELMOS in der Regel Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 90 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien/USA. SMI entwickelt, produziert und vertreibt mikromechanische Bauelemente (MEMS) und zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium. Neben Drucksensoren entwickelt SMI Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie geeignet sind. Mit

einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standardgehäusen gemäß JEDEC-Normen gehören vor allem kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP deckte in 2006 noch rund 40 Prozent des Assembly-Bedarfs für ELMOS ab. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt die Gesellschaft auch Sondergehäuse für Drittkunden. In Zukunft wird sich ELMOS AP komplett auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialgehäusen fokussieren. Die Produktion von Standardgehäusen wird zu langjährigen Partnern nach Südostasien verlagert.

Eigene
Fertigungsstätten

ELMOS produziert alle ASICs in einer eigenen Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) in Dortmund sowie in der im Berichtsjahr in Betrieb genommenen Produktionslinie in Duisburg. Sowohl durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Der in 2005 neu geschaffene Bereich ELMOS Microsystems ergänzt dieses Angebot durch die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei entwickelnden und produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS außerdem im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese nicht automobilen Märkte werden in Zukunft von der im Berichtsjahr gegründeten ELMOS Industries intensiv betreut. Sie haben im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

Strategie

ELMOS ist mit einer klaren Strategie in das Berichtsjahr gestartet und hat dabei deutliche Fortschritte gemacht. Im Vordergrund stand die Fokussierung auf kundenspezifische, automobiler Applikationen, bei denen ELMOS jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der automobilen Halbleiter hat. Hier war die Inbetriebnahme der zweiten Produktionsstätte in Duisburg sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund des größeren Waferdurchmessers ein wichtiger Schritt. Erste Kundenfreigaben wurden im dritten Quartal erteilt, weitere folgten zum Jahresende.

Fokussierung auf
kundenspezifische, automobiler
Applikationen

Daneben stand der Ausbau der Entwicklung und des Vertriebs von Applikations-Standards (ASSPs) im Fokus. Hierfür hat ELMOS den Bereich Applikationen & Systeme (AS) geschaffen,

der gezielt Applikations-Standards produziert und vertreibt. Hierbei fließen insbesondere auch patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® und VirtuHall® ein, die für ELMOS Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Mikrosysteme wecken großes Marktinteresse

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, stoßen derzeit auf großes Interesse im Markt. Mit der Fähigkeit, solche Systeme im internen Firmenverbund zu entwickeln und zu produzieren, grenzt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert ihren Kunden einen einzigartigen Vorteil.

Fortschritte wurden auch bei der Integration von Fremdsilizium in eigene Systemlösungen erzielt. Erste Projekte, basierend auf nicht selbst produzierten Bauelementen, wurden bis zur Prototypenreife vorgebracht. Diese Zukaufelemente werden entweder bei strategischen Partnerfirmen oder bei großen Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach Konstruktionsplänen von ELMOS produziert. Dank der technischen Möglichkeiten von ELMOS AP werden eigene und fremdbezogene Bauelemente in funktionalen Gehäusen als Multi-Chip-Modul zusammengefasst.

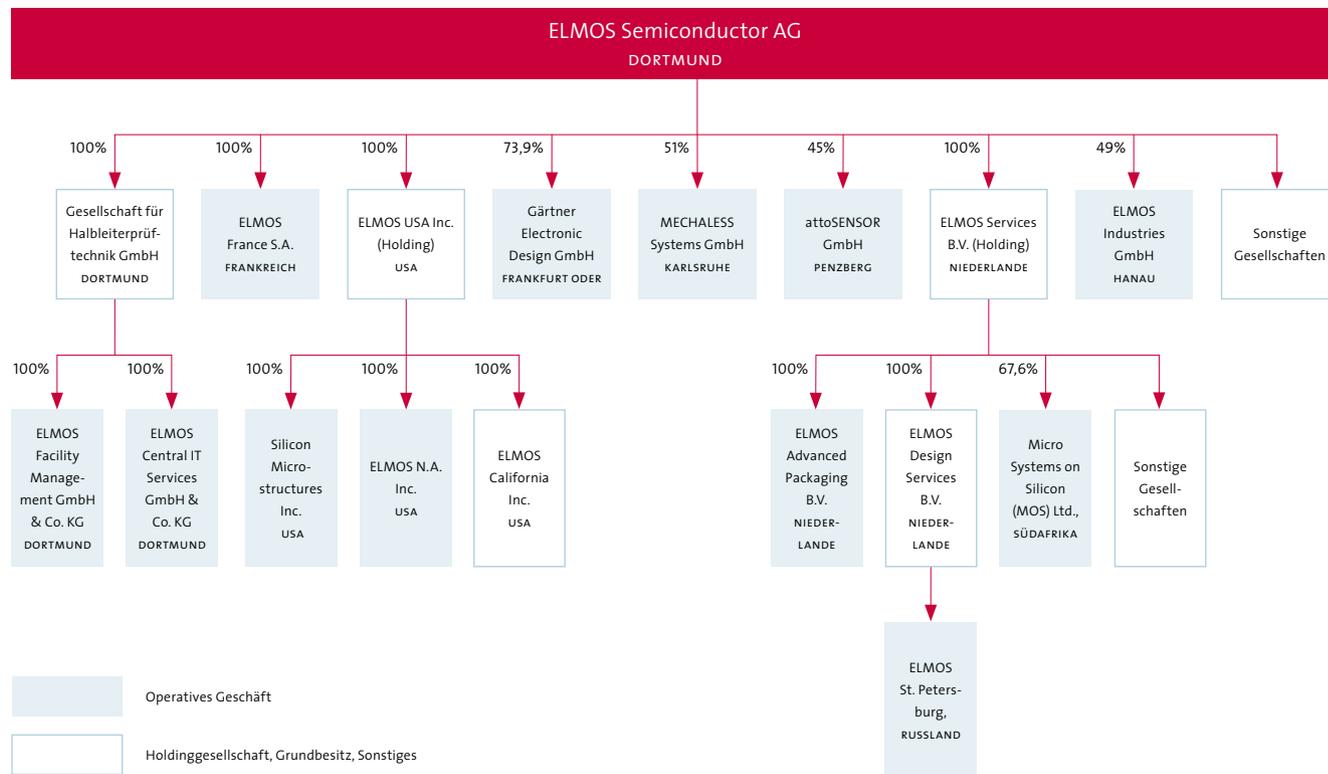
Schließlich wurde die geplante Adressierung zusätzlicher Märkte neben dem Automobilmarkt durch die Gründung der ELMOS Industries umgesetzt. Diese Tochterfirma hat im vierten Quartal des Berichtsjahres ihre Arbeit aufgenommen. Für nicht-automobile Märkte, d.h. Industrie- und Konsummärkte, strebt ELMOS mittelfristig einen Umsatzanteil von 20 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes an.

Organisationsstruktur

Orientierung an der Automobilindustrie

Das ELMOS-Geschäftsmodell orientiert sich an den Anforderungen der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der verteilten Struktur der ELMOS-Gruppe wider. Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort. Dies umfasst unter anderem die Niederlassungen in München und Stuttgart, die Tochtergesellschaften ELMOS France, ELMOS North America, MECHALESS und GED sowie die Kooperationspartner attoSENSOR, DMOS und MAZ. ELMOS France betreut Frankreich und Südeuropa und bietet Applikationsunterstützung und Customer Service vor Ort. Der französische Markt ist aktuell für ELMOS neben Deutschland die wichtigste Region. ELMOS North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei Detroit/USA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. Neben der Vertretung in Tokio ist im Berichtsjahr ein zweiter asiatischer Stützpunkt in Seoul, Korea, hinzugekommen.

Organisationsstruktur im Überblick



In der Segmentberichterstattung unterscheidet EL MOS zwischen den Bereichen Halbleiter und Mikromechanik. Das Segment Mikromechanik reflektiert die Geschäftstätigkeit von SMI. Die weiteren Gesellschaften und Aktivitäten werden im Segment Halbleiter geführt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die EL MOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der EL MOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

Rahmenbedingungen

Automobiler Halbleitermarkt

Der für EL MOS relevante Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund sieben Prozent des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Es wird erwartet, dass der Wertanteil der Elektroniksysteme bei höherwertigen Fahrzeugen von heute rund 25 Prozent bis 2010 auf rund 35 Prozent ansteigen wird. Elektronik und Mikroelektronik für den Automobileinsatz wuchsen in der Vergangenheit und wachsen auch langfristig um ein Vielfaches schneller als die Zahl der neu produzierten Kraftfahrzeuge. Eine Fortsetzung dieses Trends ist mindestens für die nächsten zehn Jahre zu erwarten.

Langfristige Kundenbeziehungen

Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie besonders harte Umgebungsbedingungen, die robuste Halbleitertechnologien erfordern.

Der weltweite Markt der automobilen Halbleiter betrug im Jahr 2006 19,1 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre sagen Experten ein Wachstum für den automobilen Halbleitermarkt von sieben bis acht Prozent pro Jahr voraus. So erwartet das Marktforschungsinstitut Semicast Estimates, dass der Markt bis 2015 auf 36,5 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

ASIC-Markt im Fokus

Der von EL MOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter, der sogenannten ASICs. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche eine hohe Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Wettbewerber der EL MOS sind bei typischen ASIC-Projekten mit mittleren Stückzahlen Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht EL MOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2006 hat sich der Trend des Jahres 2005 fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die sogenannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Da die Produktentwicklungszeiten in der Automobilindustrie immer kürzer werden, steigt auch der Termindruck an. Durch eine nach langfristigen Verhandlungen verspätete Auftragsvergabe wird die Situation häufig noch verschärft. Andererseits können selbst kleinste Überschreitungen des Projektendtermins dazu führen, dass ein Auftrag nicht in die Produktion überführt werden kann.

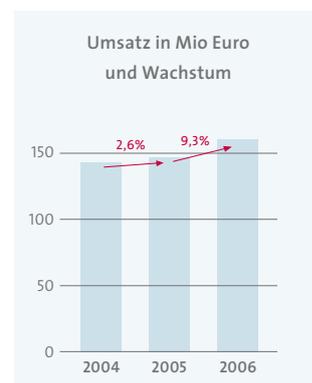
Auch bei der Übernahme der Entwicklungskosten gelten härtere Spielregeln. Früher hat der Kunde in der Regel rund die Hälfte der Entwicklungskosten übernommen. Heute ist die Bereitschaft zur Übernahme von Entwicklungskosten durch den Kunden stark rückläufig, was sich durch den härteren Wettbewerb erklären lässt. Damit wächst die Gefahr, dass der Kunde ein Projekt abbricht, z.B. weil er den Auftrag von seinem Endkunden verloren hat.

Besonders bei sehr großen Projekten verlangt der Kunde in der Regel die Umlage der Entwicklungskosten in die Serie. Zudem sind hier häufiger parallele Entwicklungen durch zwei Lieferanten – im Gegensatz zum früher üblichen Single-Sourcing – anzutreffen. Eine Folge davon und des starken Kostendrucks ist, dass heutzutage ein Wechsel des Zulieferers bei derartigen Projekten sogar während der Serienproduktion eines Fahrzeugs möglich ist.

Geschäftsverlauf im Jahr 2006

Das Jahr 2006 verlief für ELMOS insgesamt zufriedenstellend. Nach dem deutlichen Einbruch im dritten Quartal 2005 konnte seither Quartal für Quartal ein Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen erzielt werden. Insgesamt wurde im Berichtsjahr ein Umsatz von mehr als 160 Millionen Euro erreicht, dies entspricht einem Wachstum zwischen neun und zehn Prozent ausgehend von 147 Millionen Euro Vorjahresumsatz. Dies ist umso bemerkenswerter, da der amerikanische Automobilmarkt eine ausgeprägte Schwäche zeigte und unsere Umsatzerwartungen dort um mehr als zehn Prozent verfehlt wurden.

Die negativen Einflussfaktoren des Vorjahres wie Preisdruck, veränderter Produktmix sowie Verschiebungen und Stornierungen von Projekten wirkten auch im Berichtsjahr fort. Daneben mussten die deutlich gestiegenen Rohstoffkosten – vor allem für Siliziumwafer, aber auch für Edelmetalle – und die höheren Energiekosten aufgefangen werden. Schließlich belasteten die Aufwendungen für den Anlauf der zweiten Fertigungslinie in Duisburg sowie Vorleistungen für Mikrosysteme und ASSPs die Bruttomarge, die bei einer Marke von 45% im Jahresverlauf verharrte.



Produktion

Komplexität der Produkte gestiegen

In 2006 wurden 15 Prozent mehr Chips produziert als im Jahr zuvor. Dabei sind die Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer) erheblich gestiegen.

Die 2006 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150 mm-Wafer-Linie (entspricht 6 Zoll) produziert. Die Produktion auf der 200 mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Standort Duisburg wurde in der zweiten Jahreshälfte für ausgewählte automotiv ASICs lieferwirksam.

Die Linie in Dortmund wurde im Berichtsjahr weiter planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein.

Zum Jahresende 2006 lag die Maschinenkapazität bei rund 480 Waferstarts pro Tag; die durchschnittliche Ausnutzung übertraf mit 430 Waferstarts pro Tag das Niveau des Vorjahres (rund 400 Waferstarts). Insgesamt wurden in 2006 über 177.000 Wafer (2005: ca. 131.000 Wafer) gefertigt.

Vierter Bauabschnitt fertiggestellt

Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und den Ausbau von Räumen erweitert werden. Im Jahr 2006 wurde der vierte Bauabschnitt fertiggestellt, der neue Reinraumflächen für die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2006 verfügbar machte. Dieser Baukörper wird seit dem dritten Quartal 2006 für eine Erweiterung unseres Testbereiches genutzt und kann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch Raum für die Erweiterung des Frontends schaffen.

Der zweite Baustein zur Kapazitätssicherung ist die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg. ELMOS hat in 2006 den Transfer erster Prozesstechnologien und die Qualifikation der dort existierenden 200mm-Wafer-Linie abgeschlossen sowie die Freigabe erster Produkte erreicht. Wie geplant konnten ab Mitte 2006 die Produktionslose in Duisburg gestartet und geliefert werden.

Der behutsame Ausbau der Kapazitäten in Dortmund, die neue Produktionsstätte in Duisburg sowie die zukünftige Nutzung von Foundry-Kapazitäten stellen die erforderliche Fertigungskapazität für die mittelfristige Zukunft der ELMOS sicher.

Verlagerung des Standardprodukte-Assemblys

Im Geschäftsbereich Assembly (ELMOS AP) wurde im Geschäftsjahr 2006 mit der Verlagerung von Standardprodukten zu Assemblypartnern im asiatischen Raum begonnen. Damit wurden interne Kapazitäten für höherwertige Spezialprodukte geschaffen und die Kostenvorteile aus dem Euro-Dollar-Wechselkurs erschlossen. Im Laufe des Jahres 2007 soll die Verlagerung der Standardgehäuse abgeschlossen werden.

Forschung und Entwicklung

Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit führen zu verlangsamter Einführung neuer Technologiegenerationen bei Halbleitern in der Automobil-elektronik. Allerdings nutzen Industrie- und Konsumgütermärkte neue Technologien als Innovationstreiber. ELMOS nutzt diesen Sachverhalt indem z.B. in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden. Dies führt zu besserer Qualität auch bei neuen Produkten für das Automobil.

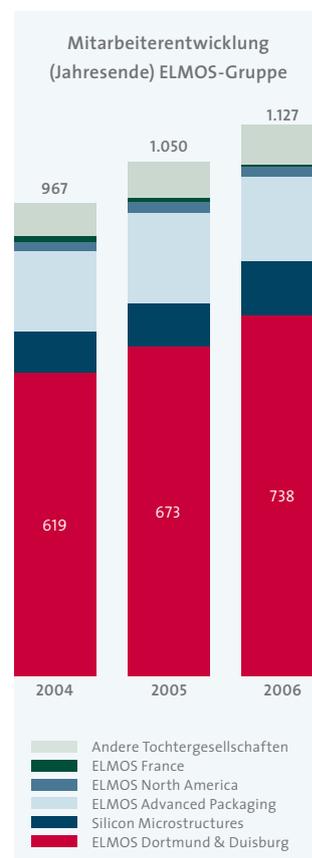
Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung der Abschluss des Transfers des 0,8µm-Prozesses zum Standort Duisburg. Die ersten Kundenfreigaben wurden planmäßig im Sommer erteilt. Im weiteren Verlauf des Jahres startete der Serienanlauf mit transferierten Produkten. Die Arbeiten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen (0,35µm-Technologie) und Flash-Option machten einen weiteren Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Diese Aktivitäten wurden parallel dazu in Duisburg direkt in der 200mm-Linie durchgeführt, um mit den hochintegrierenden Technologien und den großen (200mm) Wafern den größten Kostenvorteil zu erreichen. Damit verfolgt ELMOS weiterhin die Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können.

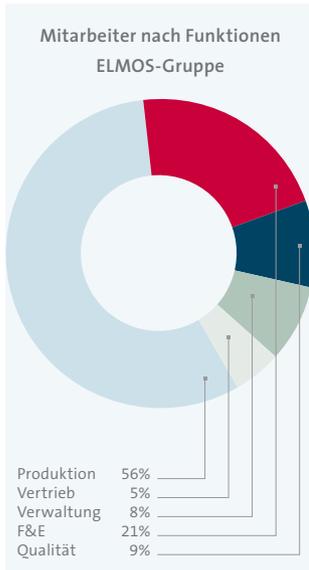
Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit, verstärkte sich im Jahr 2006 die Tendenz, dass der Kunde die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs nicht mehr übernimmt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienfertigung amortisieren kann. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu. In Folge davon stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen Euro auf 29,6 Millionen Euro an, entsprechend einer Quote von rund 18,4 Prozent vom Gesamtumsatz.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

ELMOS hat auch 2006 wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Mittel wurden im Geschäftsjahr 2006 konzernweit 1.102 Mitarbeiter im Vergleich zu 1.028 Mitarbeitern in 2005 beschäftigt. Die Neueinstellungen entfielen einerseits auf den Produktionsbereich für den Ausbau des Standorts Duisburg, andererseits wurden auch Entwicklung und Vertrieb an Schlüsselpositio-





nen verstärkt. Zum Jahresende wurden 1.127 Mitarbeiter (2005: 1.050 Mitarbeiter) von den verschiedenen Konzerngesellschaften beschäftigt, davon 738 an den Standorten Dortmund und Duisburg (2005: 673). Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter im ELMOS-Konzern liegt bei 36 Jahren (2005: 36 Jahre).

Rund zehn Prozent der Dortmunder Mitarbeiter sind Auszubildende. ELMOS bildet in zahlreichen kaufmännischen und technischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen. Ende 2006 befanden sich 70 (2005: 59) der Dortmunder Mitarbeiter in der Ausbildung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung/Aktionsoptionsprogramme

Die Mitarbeiter sind derzeit über Aktionsoptionsprogramme am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeitern unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Für Tranchen seit 2004 gilt für den Vorstand als zusätzliche Bedingung eine Begrenzung der Wertsteigerung (Cap). Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Zum 31.12.2006 standen insgesamt 715.201 Aktienoptionen (31.12.2005: 843.359) aus den Programmen der Jahre 2000 bis 2004 aus. In 2006 wurden Optionen aus der 2002 beschlossenen und 2003 ausgegebenen Tranche ausgeübt. Dadurch sind 1.381 neue Aktien entstanden. Nähere Informationen zu den verschiedenen Tranchen der Optionsprogramme erhalten Sie unter Textziffer 24 im Anhang zum IFRS-Abschluss.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Aufsichtsrat kein neues Aktienoptionsprogramm beschlossen. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zur früheren Behandlung nach US-GAAP höheren Aufwands, der sich nach der von IFRS 2 vorgeschriebenen Bilanzierung nach dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) ermittelt, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, dass andere Maßnahmen zur Incentivierung von Mitarbeitern und Vorständen eingesetzt werden sollen.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

Konsequente Umsetzung
der Null-Fehler-Strategie

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS Advanced Packaging und GED sowie erstmalig auch SMI und die Fertigung in Duisburg wurden in 2006 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Effektive
Prävention

Neben der Veröffentlichung des Umweltberichts für 2005, der ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitssicherheit informiert, hat ELMOS ihre hohen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche in einem „Kodex des verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex berichtet detailliert über die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter des ELMOS-Konzerns. Damit wollen wir – für jedermann nachvollziehbar – zu einwandfreiem Verhalten anhalten und mehr Transparenz schaffen. Dieses wird honoriert durch den Kapitalmarkt, indem ELMOS von Kempen Capital Management und SNS Asset Management als Unternehmen prämiert worden ist, welches speziellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und soziale Belange legt. Parallel zu der Prämierung ist ELMOS als Kandidat für den Kempen/SNS Smaller Europe Social Responsibility Index ausgewählt worden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Abschluss nach IFRS

Umsatz plus 9,3 Prozent Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG für das Geschäftsjahr 2006 wurde gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach IFRS

in Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	147,0	160,7	9,3%
Bruttoergebnis	70,6	73,0	3,4%
in Prozent	48,1%	45,5%	
Forschungs- und Entwicklungskosten	28,1	29,6	5,2%
in Prozent	19,1%	18,4%	
Vertriebskosten	9,4	9,7	2,9%
in Prozent	6,4%	6,0%	
Verwaltungsaufwendungen	13,0	14,2	9,6%
in Prozent	8,8%	8,8%	
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen	20,1	19,6	-2,8%
in Prozent	13,7%	12,2%	
EBIT	20,0	19,8	-0,9%
in Prozent	13,6%	12,3%	
Ergebnis vor Steuern	16,4	17,3	5,7%
in Prozent	11,2%	10,8%	
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen	10,0	10,7	6,6%
in Prozent	6,8%	6,7%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	0,52	0,55	6,6%
Dividende je Aktie in Euro	0,00	0,00*	n.a.

* Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2007

Umsatzentwicklung

Obwohl das Jahr 2006 durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet war, konnte sich die Gesellschaft zufriedenstellend entwickeln. Durch den von Quartal zu Quartal wachsenden Umsatz konnte das angestrebte Umsatzwachstum von zehn Prozent knapp erreicht, aber nicht übertroffen werden. Hier war die Schwäche des US-Automobilmarktes ein wesentlicher Grund, der unsere Erwartungen um rund zehn Prozent verfehlte. Negativ wirkte hier auch der Euro-Dollar-Wechselkurs. Durch die hohen Belastungen aus dem Anlauf der Fertigung in Duisburg, den Vorbereitungen für den Anlauf von Mikrosystemprojekten und dem ungünstigeren Produktmix blieben, wie erwartet, die Margen unter Druck. Zusätzlich mussten die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten aufgefangen werden.

Umsatz nach Regionen

Im Berichtsjahr 2006 hat sich die regionale Umsatzverteilung nur geringfügig geändert. Der Deutschland-Anteil hat im Vergleich zum Vorjahr (35,2 Prozent) auf 37,4 Prozent leicht zugenommen; der Anteil der Sonstigen EU-Länder ist auf 37,3 Prozent (2005: 42,9 Prozent) unwesentlich zurückgegangen. Der Umsatzanteil in den USA ist ebenfalls gesunken und beläuft sich auf 13,4 Prozent (2005: 16,6 Prozent). Gerade der rückläufige Umsatz in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2006 zeigt die Schwäche des dortigen Marktes. Ein Großteil der Veränderungen resultieren aus der Verschiebung von den Sonstigen EU-Ländern und den USA zu den Sonstigen Ländern. Hier sind vor allem Kanada, China, Mexiko, Schweiz und Taiwan als Länder mit Umsatzzuwachs zu nennen. Die Veränderungen sind teilweise auf den Wechsel einzelner Lieferadressen der Kunden zurückzuführen und nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung der Kundenstruktur.

Umsatz nach Kunden

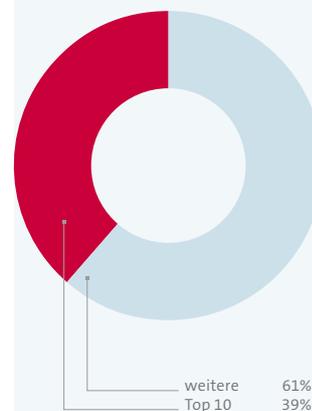
ELMOS beliefert in Summe rund 130 Kunden. Dies sind überwiegend Automobilzulieferer und zu einem kleineren Anteil Industriekunden und KonsumproduktHersteller. In 2006 waren, wie in früheren Jahren, der französische Automobilzulieferer Valeo, die schwedische Autoliv und die Schweizer Saia-Gruppe unsere größten Kunden, die jeweils mehr als zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht haben. Der mit unseren größten Kunden getätigte Umsatz verteilt sich in der Regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklusses befinden. Die zehn größten Kunden machten in 2006 rund 68 Prozent (2005: 67 Prozent) oder zwei Drittel unseres Umsatzes aus.

Auftragsbestand

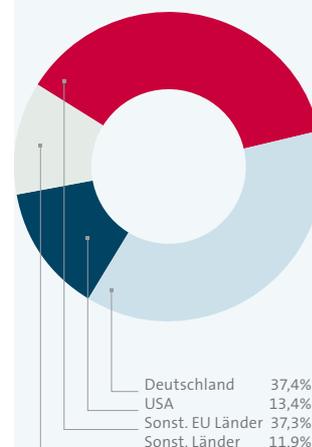
Für das Book-to-bill Verhältnis vergleichen wir den Auftragsbestand für die kommenden Monate mit dem Umsatz der vergangenen Monate. Zu Ende Dezember 2006 betrug dieser für den Halbleiterbereich 0,99.

Der Auftragsbestand wird üblicherweise bei Erhalt der Kundenbestellung erfasst. Der in die Berechnung des Book-to-bill eingehende Auftragsbestand umfasst die zu liefernden Produkte der kommenden drei Monate im Verhältnis zu den Umsätzen der vergangenen drei Monate. Der Auftragsbestand wird durch verschiedene Faktoren wie Nachfrage, Bestellverhalten, Vorlaufzeiten der Fertigung, etc. beeinflusst. Der Auftragsbestand kann zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Lieferung variieren. Dies ist bedingt durch Veränderungen im Bedarf

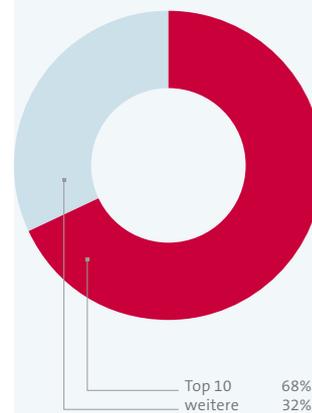
Umsatz nach Produkten



Umsatz nach Regionen



Umsatz nach Kunden



der Kunden oder Marktbedingungen. Sobald die Produktion gestartet ist, ist eine Bestellung üblicherweise nicht mehr rückgängig zu machen. Hinzu kommt, dass die Kunden typischerweise auch ihrerseits viel Zeit und Aufwand in die Entwicklung eines Produkts gesteckt haben, sodass sie normalerweise auch ihre Bestellungen durchführen. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass sich der Auftragsbestand in Umsatz verwandelt.

Neuprojekte (Design Wins)

Im Jahr 2006 hat sich der weiterhin starke Wettbewerb um ASIC-Aufträge fortgesetzt. Allerdings sind wir durch unsere langjährige Kompetenz bei der Entwicklung und Produktion von ASICs weiterhin sehr gut bei der Akquise von ASIC-Neuprojekten aufgestellt. Die strategische Ausrichtung auf den vermehrten Vertrieb von ASSPs hat sich im Jahr 2006 bereits positiv auf die Akquisitionen ausgewirkt. Wenn auch das mit den ASSP-Projekten verbundene Einzelvolumen in der Regel deutlich geringer ist als bei ASIC-Aufträgen, so deutet doch die hohe Anzahl der gewonnenen ASSP-Designs auf hohes Marktinteresse hin. Die von ELMOS angebotenen Mikrosysteme stoßen generell auf großes Interesse am Markt.

Ertragslage

Gestiegene
Herstellungskosten

Bruttoergebnis

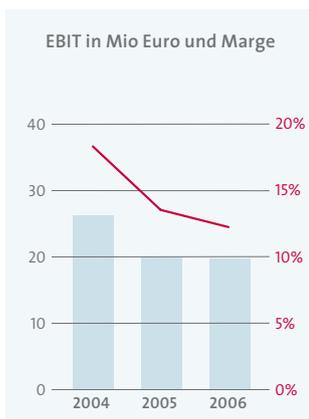
Das Bruttoergebnis stieg um 3,4 Prozent auf 73,0 Millionen Euro und damit wie erwartet unterproportional zum Umsatz. Dies erklärt sich vor allem durch die oben genannten Einflussgrößen Rohstoff- und Energiepreise sowie die Anlaufkosten für die Fertigung in Duisburg und die Vorbereitung der Mikrosysteme und ASSPs, wodurch die Herstellungskosten um 14,8 Prozent auf 87,6 Millionen Euro angestiegen sind. Die resultierende Bruttomarge betrug 45,5 Prozent im Vergleich zu 48,1 Prozent in 2005.

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)

Das Betriebsergebnis sank infolge des schlechteren Bruttoergebnisses um 2,8 Prozent auf 19,6 Millionen Euro und erreichte damit eine Marge von 12,2 Prozent (2005: 13,7 Prozent). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung sind insgesamt von 34,4 Prozent vom Umsatz auf 33,3 Prozent vom Umsatz gesunken. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sind beeinflusst von der großen Anzahl der sich in der Entwicklung befindlichen Projekte einschließlich der Mikrosysteme und ASSPs sowie von den Entwicklungsarbeiten für die nächste Prozessgeneration. Sie betragen 29,6 Millionen Euro oder 18,4 Prozent des Umsatzes (2005: 19,1 Prozent). Die Aufwendungen für den Vertrieb stiegen auf 9,7 Millionen Euro bzw. 6,0 Prozent vom Umsatz und sind begründet durch die neuen Aktivitäten im Bereich Mikrosysteme und ASSPs. Allgemeine Verwaltungskosten stiegen auf 14,2 Millionen Euro, blieben aber relativ zum Umsatz konstant bei 8,8 Prozent.

EBIT

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat um 0,9 Prozent auf 19,8 Millionen Euro (2005: 20,0 Millionen Euro) abgenommen und resultierte in einer EBIT-Marge von 12,3 Prozent des Umsatzes (2005: 13,6 Prozent). Das EBIT unterscheidet sich vom Betriebsergebnis durch die zusätzliche Berücksichtigung von Wechselkursverlusten/(-gewinnen), Aufwendungen/(Erträgen) aus assoziierten Unternehmen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen).



Ergebnis vor Steuern, Konzernüberschuss und Ergebnis pro Aktie

Die Finanzierungserträge/-aufwendungen lagen in 2006 mit 2,5 Millionen Euro klar unter dem Vorjahreswert (2005: 3,6 Millionen Euro). Dies ist insbesondere auf günstigere Refinanzierungszinssätze bei den langfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 17,3 Millionen Euro oder 10,8 Prozent vom Umsatz (2005: 16,4 Millionen Euro bzw. 11,2 Prozent). Die Steueraufwendungen sind mit 6,6 Millionen Euro gegenüber 2005 um 0,6 Millionen Euro angestiegen, dabei lag die Steuerquote bei 38,4 Prozent (2005: 37,0 Prozent). Die höhere Steuerquote resultiert im Wesentlichen aus einer Änderung des niederländischen Steuerrechts, wodurch latente Steuern erfolgswirksam wurden. Der Jahresüberschuss nach Abzug der Minderheitenanteile beträgt 10,7 Millionen Euro in 2006 und liegt damit um 6,6 Prozent über dem Vorjahreswert von 10,0 Millionen Euro. Die Nettogewinnmarge erreichte damit mit 6,7 Prozent fast den Vorjahreswert (2005: 6,8 Prozent). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,55 Euro gegenüber 0,52 Euro in 2005.



Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die ELMOS Semiconductor AG* erzielte einen Jahresüberschuss von 2,4 Millionen Euro nach HGB. Der Gewinnvortrag nach HGB aus dem Jahr 2005 beträgt 42,5 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 vor, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Trotz der deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr sehen Vorstand und Aufsichtsrat im Hinblick auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens die Notwendigkeit, die erreichte Liquidität im Unternehmen zu belassen und schlagen vor, keine Dividende auszuschütten, um so auch die notwendigen Investitionen des Jahres 2007 intern finanzieren zu können und keine zusätzlichen Fremdmittel aufnehmen zu müssen.

Umsatz- und Ertragslage in den Segmenten

	Segment	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse in Mio Euro				
	Halbleiter	138,1	150,0	8,6%
	Mikromechanik	8,9	10,7	20,4%
Bruttoergebnis in Mio Euro				
	Halbleiter	68,0	70,4	3,5%
	Mikromechanik	2,6	2,7	2,4%
Bruttomarge in Prozent				
	Halbleiter	49,3%	46,9%	
	Mikromechanik	29,4%	25,0%	
Betriebsergebnis in Mio Euro				
	Halbleiter	19,3	20,3	5,2%
	Mikromechanik	0,8	-0,8	-195,6%
Betriebsergebnis in Prozent				
	Halbleiter	14,0%	13,6%	
	Mikromechanik	9,0%	-7,1%	

*Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen.

Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt und kann als Sonderdruck angefordert werden.

Halbleiter

Halbleiterumsatz plus 8,6 Prozent

Das Halbleiter-Kerngeschäft des ELMOS-Konzerns wird über die verschiedenen Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA abgewickelt. Der Drittumsatz des Segments Halbleiter stieg um 8,6 Prozent auf 150,0 Millionen Euro an. Damit hat der Halbleiter-Bereich nach wie vor die größte Bedeutung für ELMOS und macht, ähnlich wie im Vorjahr, wieder mehr als 90 Prozent des Umsatzes der ELMOS-Gruppe aus. Das Bruttoergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr, die Marge blieb aber unter Druck. Die Betriebsergebnismarge des Halbleiterbereichs ist von 14,0 Prozent in 2005 auf 13,6 Prozent in 2006 leicht gesunken, liegt aber dennoch deutlich über der Marge des Mikromechanik-Bereichs, die im Berichtsjahr aufgrund außerordentlicher Belastungen sogar negativ war.

Mikromechanik

Der Bereich Mikromechanik umfasst die Tätigkeiten der Tochtergesellschaft SMI. Der SMI-Umsatz mit Dritten wird fast ausschließlich in US-Dollar erzielt. Der Umsatz von SMI stieg um 20,4 Prozent auf 10,7 Millionen Euro in 2006. Bruttoergebnis und –marge konnten dem Umsatzzuwachs nicht folgen, da zahlreiche Produktanläufe die Fertigung belasteten und erhebliche Aufwendungen für die Vorbereitung von Mikrosystem-Projekten und die Ertüchtigung der Fertigung für die automobilen Qualifikation notwendig waren. Aus den gleichen Gründen berichtet SMI ein negatives Betriebsergebnis.

Finanzlage

Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach IFRS

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	2005	2006	Veränderung
Konzernüberschuss	10,0	10,7	6,6%
Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen	15,5	16,3	5,1%
Veränderung Nettoumlaufvermögen	-4,3	0,0	n.a.
Übrige Posten	-1,6	1,5	n.a.
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19,7	28,5	45,0%
Investitionen in das Anlagevermögen	-29,6	-26,4	-11,0%
in Prozent vom Umsatz	20,1%	16,4%	
Sonstige Posten	-0,8	6,4	n.a.
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-30,4	-19,9	-34,5%
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	6,7	-4,1	n.a.
Veränderung der liquiden Mittel	-4,0	4,5	n.a.
Free Cash Flow*	-10,7	8,6	n.a.

*Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Deutlich gesteigener Cash Flow

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um fast 9 Millionen Euro angestiegen. Erheblich dazu beigetragen haben die erreichten Verbesserungen im Nettoumlaufvermögen sowie deutliche Einsparungen bei den Steuerzahlungen. Zudem ist der Anteil der latenten Steuern an der Gesamtsteuerlast um 128 Prozent gestiegen.

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

ELMOS hat in 2006 die Investitionen weiter zurückgefahren und insgesamt 26,4 Millionen Euro in das Anlagevermögen investiert. Dieser Wert unterschreitet den Vorjahresbetrag (29,6 Millionen Euro) und entspricht rund 16 Prozent des Umsatzes (2005: 20,1 Prozent). Die Investitionen entfielen vor allem auf das Dortmunder Frontend und Backend für Maschinen und Betriebsvorrichtungen sowie auf die Ausstattung des Reinraums am Standort Duisburg. Das Halbleiter-Segment war für den größten Teil der Investitionen verantwortlich, auf die Mikromechanik entfielen 2,6 Millionen Euro. Der im Halbleiter-Segment enthaltene Assembly-Bereich hat in Maschinen zur Fertigung von Spezialgehäusen rund 0,9 Millionen Euro investiert.

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

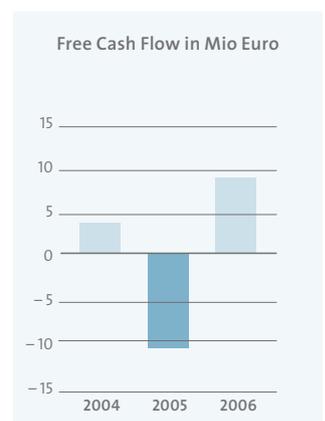
Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat die in 2006 erforderlichen Investitionen mehr als decken können. Die darüber hinaus zur Verfügung stehende Liquidität wurde hauptsächlich zur Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten genutzt. Die liquiden Mittel stiegen im Berichtsjahr von 11,4 Millionen Euro auf 16,6 Millionen Euro. Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermögen beträgt 6,9 Prozent (2005: 4,8 Prozent).

Vermögenslage

Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach IFRS

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	31.12.2005	31.12.2006	Veränderung
Immaterielle Vermögenswerte	34,8	39,0	12,0%
Sachanlagen	102,0	95,6	-6,3%
Sonstige langfristige Vermögenswerte	9,7	4,8	-50,2%
Vorratsvermögen	27,7	31,1	12,4%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29,1	27,8	-4,4%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	33,7	43,6	29,3%
Aktiva, gesamt	237,0	241,9	2,1%
Eigenkapital	144,3	152,9	5,9%
Langfristige Schulden	35,5	29,8	-16,0%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,6	12,7	20,4%
Sonstige kurzfristige Schulden	46,7	46,5	-0,3%
Passiva, gesamt	237,0	241,9	2,1%

Die Bilanzsumme der ELMOS-Gruppe stieg von 237,0 Millionen Euro im Jahr 2005 um 2,1 Prozent auf 241,9 Millionen Euro. Wesentliche Einflussfaktoren waren der Rückgang der latenten Steuerforderungen, die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten sowie der Anstieg der zur Veräußerung gehaltenen Wirtschaftsgüter. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Erweiterung des Produktionsgebäudes in Dortmund, welches im Jahr 2007 im Zuge einer Sale-and-Lease-back Transaktion veräußert werden soll.



Nettoumlaufvermögen

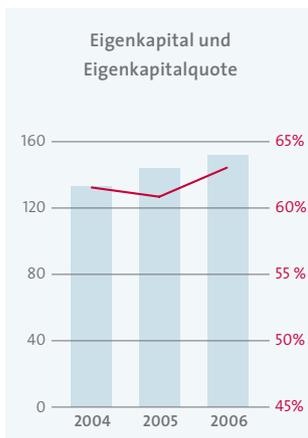
Die Vorräte stiegen umsatzbedingt von 27,7 Millionen Euro zu Beginn des Berichtsjahres auf 31,1 Millionen Euro am 31. Dezember 2006. Der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen stieg im Vergleich zu 2005 von 11,7 Prozent auf 12,9 Prozent. Dank verbessertem Forderungsmanagement nahmen bei gestiegenen Umsätzen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 4,4 Prozent ab, von 29,1 Millionen Euro auf 27,8 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 20,4 Prozent von 10,6 Millionen Euro in 2005 auf 12,7 Millionen Euro in 2006.

Passiva

Die Nettoverschuldung sank zum Bilanzstichtag 2006 auf 48,4 Millionen Euro, ein Rückgang um 5,5 Prozent gegenüber dem 31. Dezember 2005. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang von langfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Kennzahlen der ELMOS-Gruppe

	Berechnung	Einheit	2005	2006
Nettoumlaufvermögen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Millionen Euro	46,2	46,2
	vom Umsatz	Prozent	31,4%	28,7%
Umschlagshäufigkeit der Vorräte	Herstellungskosten/Vorräte	x	2,8x	2,8x
Umschlagshäufigkeit der Forderungen	Umsatz/Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	x	5,1x	5,8x
Umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten	Herstellungskosten/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	x	7,2x	6,9x
Cash Cycle	Inventartage + Forderungstage – Verbindlichkeitentage	Tage	154	140
Nettoverschuldung	Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig) – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – Wertpapiere	Millionen Euro	51,2	48,4
Gearing	Nettoverschuldung/Eigenkapital	Prozent	35,5%	31,6%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital/Gesamtvermögen	Prozent	60,9%	63,2%



Das Eigenkapital stieg von 144,3 Millionen Euro auf 152,9 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote wuchs aufgrund des unterproportionalen Anstiegs der Bilanzsumme ebenfalls auf 63,2 Prozent (31. Dezember 2005: 60,9 Prozent).

Berichterstattung nach §315 Abs. 4 HGB i.d.F. des Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.413.805,00 Euro ist voll eingezahlt.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2006 wie folgt dar:

	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789,00	7,6
Hinrichs GmbH	3.236.584,00	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584,00	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833,00	11,9
Streubesitz	9.148.015,00	47,1
	19.413.805,00	100,0

4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

5. Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

6. Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

7. Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 886.195,00 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 25.04.2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%ige Beteiligungs-

gesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100% igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25.04.2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 18.11.2007 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

8. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

9. Entschädigungsvereinbarungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

Vergütungsbericht

Die Gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer Reihe von Vergütungsbestandteilen. Nähere Einzelheiten enthält der Vergütungsbericht, der im Corporate Governance Bericht in diesem Geschäftsbericht zu finden ist. Dieser vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Vergütungsbericht ist Teil des Lageberichts.

Risikobericht

Risikomanagementsystem

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des §91 (2) AktG erfüllt, Schritt für Schritt auf die Unternehmen im Konzern angewendet, weiter verfeinert und anwenderfreundlicher gemacht. Das Risikomanagementsystem von ELMOS und seine Anwendung wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung bzw. -vermeidung oder -abwehr beschließen. Das Risikomanagementsystem wird auch zukünftig kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Regelmäßige Erfassung
und Bewertung des Risikos

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90 Prozent des Umsatzes wird mit Halbleitern für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht nur durch ein Produkt entsteht, das heißt auch überlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um eine gegenseitige Abhängigkeit. Daher können größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden Zeichen für eine langfristige Kundenbeziehung mit entspre-

chenden Umsatzpotenzialen sein. Es kommt nur bei sehr großen Volumina vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten im Fertigungsbereich bedeutet. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an viele Kunden verkauft werden können.

Wettbewerb

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus geschützter Position, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschäft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Rückgänge zu verzeichnen hat. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich oftmals auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumigere Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren. Insbesondere seit 2005 hat ELMOS die negativen Folgen des Wettbewerbs insofern gespürt, als einige Projekte nicht bis in die Produktion gebracht werden konnten, da die Kunden aufgrund von Parallelentwicklungen auf einen Wettbewerber zurückgreifen konnten.

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Sehr spezifisches
Know-How

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die

Entwicklungskosten zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Dies gilt insbesondere für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, da hierfür unter Umständen noch kein fester Kundenauftrag vorliegt.

Bei Entwicklungen von Produkten, die ELMOS nicht rechtzeitig fertig stellt, kann die Lieferung möglicherweise erst ein Jahr später oder im schlimmsten Fall gar nicht erfolgen, wenn der Kunde eine Alternativlösung – entweder vom Konkurrenten oder als konventionelle Lösung – einsetzt.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen.

Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Allerdings zeigte sich im Berichtsjahr eine Verknappung bei Silizium-Wafern, da durch den Boom der Solarbranche die weltweite Nachfrage deutlich gestiegen ist. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit der Tochtergesellschaft ELMOS AP jedoch ihre Wertschöpfungskette vertikal vertieft.

Verknappung bei
Silizium-Wafern

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Überwachungs- und Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten ei-

nes etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Nachtragsbericht

Herbert Sporea hat mit Wirkung zum Ende Dezember 2006 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Dr. Klaus Weyer, Vorstandsmitglied bis Dezember 2006, wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Der Hauptversammlung im Mai 2007 soll vorgeschlagen werden, Dr. Klaus Weyer als Aufsichtsratsmitglied für die restliche Amtszeit von Herbert Sporea, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2010 zu wählen. Es sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Prognosebericht

Ausrichtung des Konzerns

ELMOS wird sich zukünftig weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Um die im Berichtsjahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen im Unternehmen teils erhebliche Änderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung vorgenommen und dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS-eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobiler ASIC-Geschäft wird ergänzt durch den Aufbau weiterer Geschäftsfelder. Wir sind überzeugt davon, dass diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeiträge liefern werden. Insgesamt richten wir den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Dieser Prognosebericht basiert auf sorgfältiger Analyse der signifikanten Faktoren.

Folgende Themen werden den Geschäftsverlauf 2007 charakterisieren:

- ▶ Die Erweiterung der neuen 8-Zoll-Fertigung in Duisburg wird in 2007 intensiv betrieben, so dass sie zunehmend signifikante Liefermengen beiträgt. Auf der Kundenseite werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um unsere auf 200mm-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien schneller liefern zu können.
- ▶ Wir haben mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament für ein Wachstum in den Märkten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Märkte von derzeit rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.

- ▶ Wir haben in 2006 sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gestartet. Durch den vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstützung durch ELMOS Industries können wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste Projekte in Serie gehen.
 - ▶ Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg großes Interesse bei den Kunden. Wir werden mit neuen Produkten im Jahr 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden große Vorteile bei ihren Applikationen bringt.
- Erweiterte Kooperation**
- ▶ Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor für System-in-Package-Solutions eröffnet neue Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und Herstellung intelligenter Lösungen für die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. Im Jahr 2007 werden erste Produkte vorgestellt.
 - ▶ Mitte 2006 hat die Verlagerung des Standardgehäuse-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Von dem Assembly-Umsatz bei ELMOS AP wurde im vergangenen Jahr bereits mehr als 40 Prozent durch höherwertige Spezialgehäuse erzielt. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehäuse im zweiten Quartal 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren.
 - ▶ Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in Fertigungseinrichtungen tätigen zu müssen. Im Jahr 2007 wird dieses Projekt mit hohem Engagement weitergeführt.

Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme für erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb für eine weitere Effizienzverbesserung in den Abläufen sorgen. Von der Einführung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehäuse nach Fernost wird mittelfristig ebenfalls positive Beiträge zur Ergebnissituation liefern.

Marktsituation

Marktwachstum für
automobile Chips
von 7 bis 8 Prozent
prognostiziert

Für das Jahr 2007 sind die Erwartungen des Zentralverbandes der Elektronik-Industrie (ZVEI) für den gesamten Halbleitermarkt gedämpft positiv. Eine Voraussetzung für ein nennenswertes Wachstum wäre eine positive Trendwende, die spätestens mit Ende des ersten Quartals einsetzen muss. Für die Automobilindustrie zeigen die Prognosen keine größere Veränderung in der weltweiten Nachfrage. Die neuen EU-Regeln hinsichtlich des CO₂ Ausstoßes lösen aber die Diskussion über die Berechtigung von Oberklassefahrzeugen aus, die als Innovationsträger der Automobilelektronik in der Vergangenheit wesentliche Impulse gegeben haben. Auf der anderen Seite finden Hybridkonzepte zunehmende Beachtung. So wird der Elektronikanteil je Fahr-

zeug in jedem Fall auch weiterhin kontinuierlich steigen und der Markt für automobiler Halbleiter weiter wachsen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein durchschnittliches Wachstum von etwa sieben bis acht Prozent bis 2015 prognostiziert.

Die Marktbedingungen haben sich schneller als jemals zuvor geändert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr Unterstützung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand, andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Bürstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®, einsetzen.

Das Marktumfeld in den USA wird weiterhin schwierig bleiben. Auch bei den Kosten für Rohstoffe und Energie rechnen wir mit keiner Entlastung in 2007.

Erwartete Finanzlage

Wir bestätigen die Prognose aus Dezember 2006. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von rund zehn Prozent. Die Bruttomarge wird rund 45 Prozent betragen. Beim EBIT gehen wir von rund zwölf Prozent vom Umsatz aus. Die Zielgröße für das Nettoergebnis ist rund sieben Prozent vom Umsatz. Beim Free Cash Flow wird eine freundliche Entwicklung und dementsprechend ein positives Ergebnis erwartet.

Prognose
bestätigt

Dortmund, im März 2007

Der Vorstand



Dr. Anton Mindl



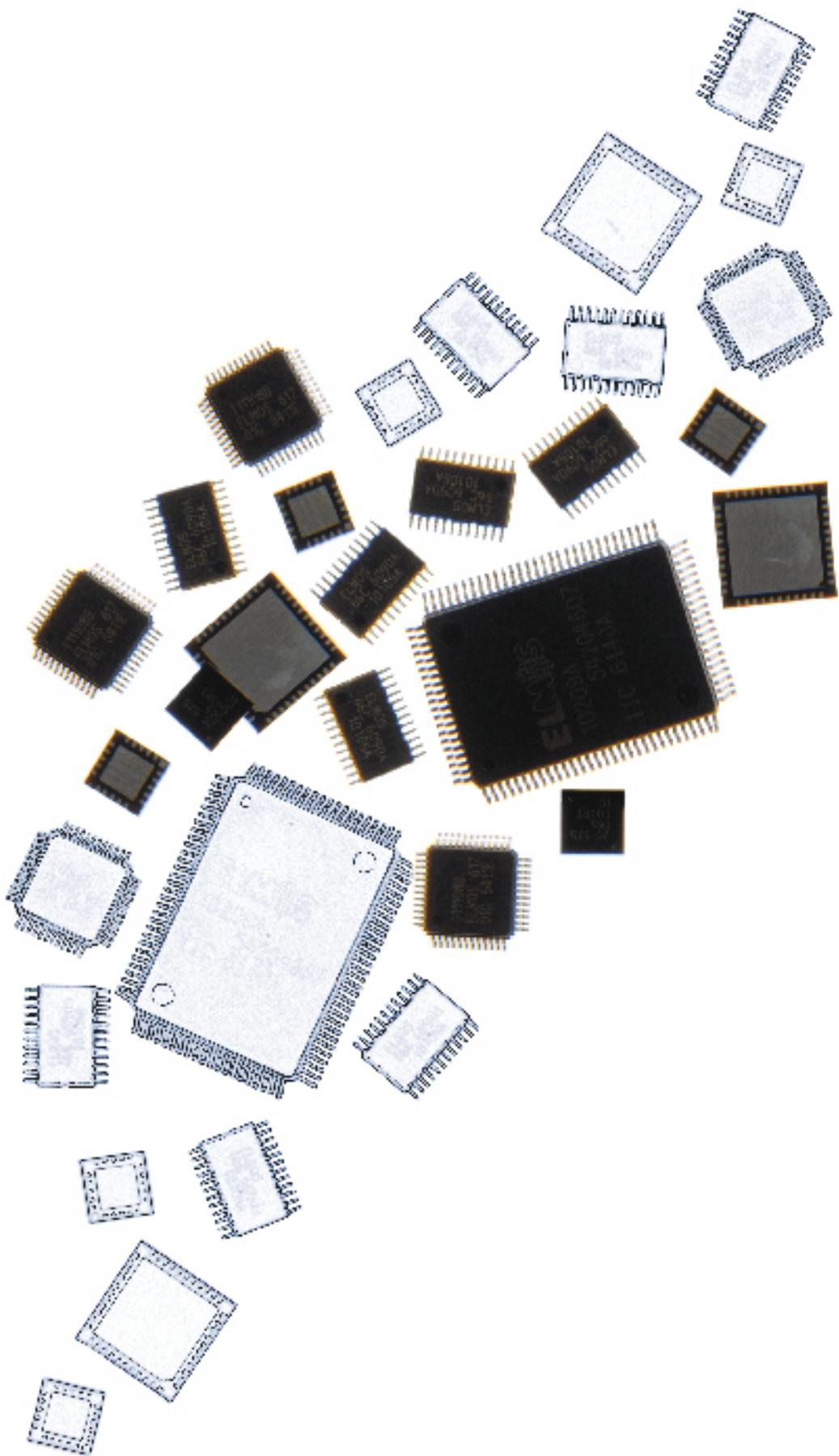
Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf



Dr. Frank Rottmann



WEITER WACHSEN

in

Andere Märkte

Was sind für uns andere Märkte?

Unser Hauptmarkt ist der automobiler Halbleitermarkt. Wenn wir von anderen Märkten sprechen, meinen wir darüber hinausgehende Einsatzbereiche für Halbleiterchips. Unsere Technologien bieten die ideale Grundlage für Produkte im Industriebereich und in Konsumgütern.

Warum wachsen wir in anderen Märkten weiter?

Umweltfreundliche und stromsparende Lösungen sind heute mehr als jemals zuvor gefragt. Der Grund sind steigende Energie- und Rohstoffkosten. Unsere Chips erbringen im Industriebereich und in Konsumgütern hohe Leistungen bei extrem geringem Energieverbrauch. Bei der Ansteuerung von Elektro-Motoren überzeugen wir die Kunden beispielsweise mit einem patentierten, kostensparenden Verfahren.

Für unsere Kunden in anderen Märkten bedeutet dies

Wettbewerbsvorteile durch Innovationen.

Jahresabschluss

Konzernbilanz nach IFRS

Aktiva	Anhang	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte	13	39.023.949	34.844.237
Sachanlagen	14	95.556.490	101.959.587
At-Equity bewertete Beteiligungen	15	2	1
Wertpapiere und Anteile	15	126.154	645.795
Latente Steueransprüche	16	4.725.700	9.101.839
Summe langfristige Vermögenswerte		139.432.295	146.551.459
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorratsvermögen	17	31.142.235	27.704.590
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	27.774.401	29.064.040
Wertpapiere	19	0	5.350.375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20	16.634.086	11.418.640
Sonstige Vermögenswerte	21	13.586.114	10.937.674
		89.136.836	84.475.319
Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird	22	13.343.658	5.997.193
Summe kurzfristige Vermögenswerte		102.480.494	90.472.512
Bilanzsumme		241.912.789	237.023.971

Passiva	Anhang	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Eigenkapital			
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital			
Grundkapital	23	19.413.805	19.412.424
Kapitalrücklage	23	88.733.815	88.270.716
Gewinnrücklage		102.224	102.224
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals	23	-4.991.418	-2.943.060
Bilanzgewinn		49.091.408	38.912.998
		152.349.834	143.755.302
Minderheitenanteil		505.088	528.190
Summe Eigenkapital		152.854.922	144.283.492
Schulden			
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	25	1.142.637	1.121.704
Finanzverbindlichkeiten	26	28.284.983	32.864.259
Sonstige Verbindlichkeiten	27	354.307	1.488.110
Summe langfristige Schulden		29.781.927	35.474.073
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	25	5.122.981	4.392.625
Steuerverbindlichkeiten	27	280.169	1.245.929
Finanzverbindlichkeiten	26	36.712.756	35.060.684
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	12.731.544	10.574.161
Sonstige Verbindlichkeiten	27	4.428.490	5.993.007
Summe kurzfristige Schulden		59.275.940	57.266.406
Summe Schulden		89.057.867	92.740.479
Bilanzsumme		241.912.789	237.023.971

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

	Anhang	2006 Euro	2005 Euro
Umsatzerlöse	5	160.673.887	146.963.437
Umsatzkosten	6	87.629.925	76.336.529
Bruttoergebnis		73.043.962	70.626.908
Forschungs- und Entwicklungskosten	6	29.583.236	28.124.440
Vertriebskosten	6	9.679.254	9.409.620
Verwaltungsaufwendungen	6	14.216.140	12.970.297
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)		19.565.332	20.122.551
Finanzierungserträge	8	– 452.319	– 3.973.355
Finanzierungsaufwendungen	8	2.954.883	7.588.365
Wechselkursverluste/(-gewinne)	9	288.115	– 193.744
Aufwendungen (Erträge) aus assoziierten Unternehmen		48.999	67.636
Sonstige betriebliche Erträge	10	– 4.176.926	– 2.051.664
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	3.581.829	2.294.635
Ergebnis vor Steuern		17.320.751	16.390.678
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteueraufwand	11	1.185.589	3.663.913
Latente Steuern	11	5.458.781	2.394.482
		6.644.370	6.058.395
Konzernüberschuss		10.676.381	10.332.283
Davon entfallen auf:			
Minderheitenanteile		– 18.291	296.456
Anteilseigner des Mutterunternehmens		10.694.672	10.035.827
Ergebnis je Aktie			
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,55	0,52
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,55	0,52

Konzern-Kapitalflussrechnung

	Anhang	2006 Euro	2005 Euro
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit			
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen		10.694.672	10.035.827
Abschreibungen		16.287.270	15.499.930
Latente Steuern		5.458.781	2.394.482
Ertragsteueraufwand		1.185.589	3.663.913
Minderheitenanteile		- 18.291	296.456
Aufwand/Ertrag aus der Bewertung „at equity“		48.999	67.636
Veränderung der Pensionsrückstellungen		20.933	- 416.888
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm		453.611	1.289.725
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.296.722	- 1.286.139
Vorräte		- 3.437.645	- 2.556.856
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte		- 1.907.421	- 5.059.327
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.157.383	- 465.063
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten		- 834.160	2.775.504
Ertragsteuerzahlungen		- 2.886.707	- 6.565.582
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit		28.519.736	19.673.618
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		- 9.578.886	- 7.006.925
Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 16.772.554	- 22.604.502
Investitionen in zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte		- 7.346.464	- 4.631.966
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		10.198.918	4.070.876
Erwerb/Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens		3.629.862	42
Erwerb/Abgang von Beteiligungen		- 45.723	- 244.296
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		- 19.914.847	- 30.416.771
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Dividenden		0	- 4.053.000
Einzahlung aus Kapitalerhöhung		10.868	884.777
Gewinnausschüttung durch konsolidierte Tochtergesellschaft an Minderheitsgesellschafter		0	- 270.000
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten		325.000	0
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten		- 5.674.655	- 3.852.822
Aufnahme/Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.266.460	14.029.988
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		- 4.072.327	6.738.943
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel		4.532.562	- 4.004.210
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel		682.884	136.255
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres		11.418.640	15.286.595
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	20	16.634.086	11.418.640

Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals nach IFRS

	Aktien Stück	Grundkapital Euro	Kapitalrücklage Euro
Stand 1. Januar 2005	19.300.000	19.300.000	86.208.638
Dividendenausschüttung			
Aufwand aus Aktienoptionen			1.289.725
Ausübung von Optionen	112.424	112.424	772.353
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Erwerb Minderheitenanteile ELMOS France			
Jahresüberschuss 2005			
Stand 31. Dezember 2005	19.412.424	19.412.424	88.270.716
Aufwand aus Aktienoptionen			453.611
Ausübung von Optionen	1.381	1.381	9.487
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2006			
Stand 31. Dezember 2006	19.413.805	19.413.805	88.733.815

Gewinnrücklagen Euro	Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals Euro	Bilanzgewinn Euro	Gesamt Euro	Minder- heitenanteil Gesamt Euro	Konzern Gesamt Euro
102.224	- 5.307.063	32.930.171	133.233.970	592.427	133.826.397
		- 4.053.000	- 4.053.000	- 270.000	- 4.323.000
			1.289.725		1.289.725
			884.777		884.777
	1.211.241		1.211.241		1.211.241
	1.152.762		1.152.762		1.152.762
				- 90.693	- 90.693
		10.035.827	10.035.827	296.456	10.332.283
102.224	- 2.943.060	38.912.998	143.755.302	528.190	144.283.492
			453.611		453.611
			10.868		10.868
	- 1.211.241		- 1.211.241		- 1.211.241
	- 837.117		- 837.117		- 837.117
		- 516.262	- 516.262	- 4.811	- 521.073
		10.694.672	10.694.672	- 18.291	10.676.381
102.224	- 4.991.418	49.091.408	152.349.834	505.088	152.854.922

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2006

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN						31.12.2006 Euro
	1.1.2006 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Korrektur Eröffnungs- werte Euro	Zugänge* Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	
Langfristige Vermögenswerte							
Immaterielle Vermögenswerte							
Geschäfts- oder Firmenwert	8.033.733	- 598.090	0	0	0	0	7.435.643
Entwicklungsprojekte	8.556.162	0	0	1.368.679	2.261.699	0	12.186.540
Software und Lizenzen	27.175.111	- 131.153	0	1.660.340	4.896.524	93.591	33.507.231
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	4.155.055	0	0	6.549.867	- 6.997.868	72.001	3.635.053
	47.920.061	- 729.243	0	9.578.886	160.355	165.592	56.764.467
Sachanlagen							
Grund und Boden	6.027.539	- 187.549	0	0	0	2.002.755	3.837.235
Gebäude und Einbauten	69.140.182	- 759.104	0	2.226.724	162.144	6.689.478	64.080.468
Technische Anlagen und Maschinen	127.672.747	- 824.771	155.275	6.405.443	8.244.252	575.770	141.077.176
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.472.312	1	0	8.193.032	- 8.566.751	3.846.410	4.252.184
	211.312.780	- 1.771.423	155.275	16.825.199	- 160.355	13.114.413	213.247.063
At-Equity bewertete Beteiligungen	67.637	0	0	49.000	0	0	116.637
Wertpapiere und Anteile	645.795	0	0	0	0	519.641	126.154
	259.946.273	- 2.500.666	155.275	26.453.085	0	13.799.646	270.254.321

*Veränderungen im Konsolidierungskreis 52.645 Euro

**Veränderungen im Konsolidierungskreis 47.910 Euro

1.1.2006 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Korrektur Eröffnungs- werte Euro	Zugänge** Euro	Zuschrei- bungen Euro	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN			BUCHWERT	
					Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	31.12.2006 Euro	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
0	0	0	0	0	0	0	0	7.435.643	8.033.733
2.709.938	0	0	1.737.644	0	0	0	4.447.582	7.738.958	5.846.224
10.365.886	- 32.215	0	2.978.827	0	74.023	93.585	13.292.936	20.214.295	16.809.225
0	0	0	0	0	0	0	0	3.635.053	4.155.055
13.075.825	- 32.215	0	4.716.471	0	74.023	93.585	17.740.519	39.023.949	34.844.237
612.702	0	0	0	0	0	0	612.702	3.224.533	5.414.837
27.637.455	- 51.800	0	3.354.909	0	0	605.194	30.335.370	33.745.098	41.502.727
81.103.036	- 323.279	155.275	8.263.800	0	- 74.023	2.382.308	86.742.501	54.334.675	46.569.711
0	0	0	0	0	0	0	0	4.252.184	8.472.312
109.353.193	- 375.079	155.275	11.618.709	0	- 74.023	2.987.502	117.690.573	95.556.490	101.959.587
67.636	0	0	48.999	0	0	0	116.635	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	126.154	645.795
122.496.654	- 407.294	155.275	16.384.179	0	0	3.081.087	135.547.727	134.706.595	137.449.620

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2005

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					31.12.2005 Euro
	1.1.2005 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Zugänge Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	
Langfristige Vermögenswerte						
Immaterielle Vermögenswerte						
Geschäfts- oder Firmenwert	5.642.918	776.237	1.614.578	0	0	8.033.733
Entwicklungsprojekte	6.594.140	0	1.582.932	732.535	353.445	8.556.162
Software und Lizenzen	23.382.269	170.219	695.843	2.943.238	16.458	27.175.111
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	5.161.697	0	3.113.572	- 3.675.773	444.441	4.155.055
	40.781.024	946.456	7.006.925	0	814.344	47.920.061
Sachanlagen						
Grund und Boden	7.202.876	242.945	0	0	1.418.282	6.027.539
Gebäude und Einbauten	63.040.386	982.895	1.326.680	3.820.908	30.687	69.140.182
Technische Anlagen und Maschinen	107.992.133	599.262	6.012.317	16.402.740	3.333.705	127.672.747
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.253.989	0	15.265.505	- 20.223.648	823.534	8.472.312
	192.489.384	1.825.102	22.604.502	0	5.606.208	211.312.780
At-Equity bewertete Beteiligungen	57.234	0	10.403	0	0	67.637
Wertpapiere und Anteile	502.594	0	143.201	0	0	645.795
	233.830.236	2.771.558	29.765.031	0	6.420.552	259.946.273

1.1.2005 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Zugänge Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN		BUCHWERT	
					31.12.2005 Euro	31.12.2005 Euro	31.12.2004 Euro	
0	0	0	0	0	0	8.033.733	5.642.918	
1.529.498	0	1.289.322	0	108.882	2.709.938	5.846.224	5.064.642	
7.751.077	29.865	2.601.216	0	16.272	10.365.886	16.809.225	15.631.192	
0	0	0	0	0	0	4.155.055	5.161.697	
9.280.575	29.865	3.890.538	0	125.154	13.075.825	34.844.237	31.500.449	
612.702	0	0	0	0	612.702	5.414.837	6.590.174	
23.703.326	41.896	3.898.165	0	5.932	27.637.455	41.502.727	39.337.060	
74.044.715	200.925	7.711.226	0	853.830	81.103.036	46.569.711	33.947.418	
0	0	0	0	0	0	8.472.312	14.253.989	
98.360.744	242.821	11.609.391	0	859.762	109.353.193	101.959.587	94.128.641	
0	0	67.636	0	0	67.636	1	57.234	
0	0	0	0	0	0	645.795	502.594	
107.641.319	272.686	15.567.565	0	984.916	122.496.654	137.449.620	126.188.918	

Konzernanhang

Allgemeines

Die ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft („die Gesellschaft“ oder „ELMOS“) hat ihren Sitz in Dortmund (Deutschland) und ist dort beim Amtsgericht im Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. 13698 eingetragen. Es gilt die Satzung in der Fassung vom 26. März 1999, welche zuletzt am 15. Dezember 2006 geändert wurde.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von mikroelektronischen Bauelementen und Systemteilen (Application Specific Integrated Circuits oder kurz: ASICs) sowie von funktionsverwandten technologischen Einheiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu pachten und sich an solchen zu beteiligen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftsvertrag dienlich sind. Die Gesellschaft ist befugt, Geschäfte im Inland wie im Ausland zu betreiben.

Die Gesellschaft hat neben den inländischen auch Vertriebsgesellschaften in Frankreich und den USA und kooperiert in der Entwicklung und Herstellung von ASIC-Chips mit anderen deutschen und internationalen Unternehmen.

Die Gesellschaft ist börsennotiert, ihre Aktien werden im Prime Standard in Frankfurt gehandelt.

Die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft lautet:
44227 Dortmund, Heinrich-Hertz-Straße 1.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Grundsätze der Rechnungslegung Allgemeines

Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt.

Der Konzernabschluss per 31. Dezember 2006 für das Geschäftsjahr 2006 wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board (IASB) formulierten International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Alle für das Geschäftsjahr 2006 verpflichtend anzuwendenden International Accounting Standards (IAS) und International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie die Auslegungen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC, vormals: Standing Interpretations Committee (SIC)) wurden berücksichtigt.

Die Konzernbilanz und die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind in Anlehnung an IAS 1 „Presentation of financial statements“ aufgestellt. Einzelne Posten sind zur Verbesserung der Klarheit zusammengefasst; die Posten werden im Anhang erläutert.

Der Abschluss wird voraussichtlich im März 2007 durch den Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Schätzungen und Annahmen

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am Stichtag bestehende wesentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches Risiko besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein wird, werden nachstehend erläutert.

Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts

Der Konzern überprüft mindestens einmal jährlich, ob der Geschäfts- oder Firmenwert wertgemindert ist. Dies erfordert eine Schätzung der Nutzungswerte der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. Zur Schätzung des Nutzungswerts muss die Unternehmensleitung die voraussichtlichen künftigen Cash Flows der zahlungsmittelgenerierenden Einheit schätzen und darüber hinaus einen angemessenen Abzinsungssatz wählen, um den Barwert dieser Cash Flows zu ermitteln. Der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts betrug zum 31. Dezember 2006

7.435.643 Euro (2005: 8.033.733 Euro). Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Anhangangabe 13 zu finden.

Aktive latente Steuern

Aktive latente Steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, so dass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Für die Ermittlung der Höhe der aktiven latenten Steuern ist eine wesentliche Ermessensausübung der Unternehmensleitung auf der Grundlage des erwarteten Eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der zukünftigen Steuerplanungsstrategien erforderlich. Weitere Einzelheiten sind in der Anhangangabe 16 dargestellt.

Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen und anderen medizinischen Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird anhand von versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt. Die versicherungsmathematische Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Annahmen in Bezug auf die Abzinsungssätze, erwartete Erträge aus Planvermögen, künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Sterblichkeit und die künftigen Rentensteigerungen. Entsprechend der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne unterliegen solche Schätzungen wesentlichen Unsicherheiten. Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrug zum 31. Dezember 2006 1.142.637 Euro (2005: 1.121.704 Euro). Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Anhangangabe 25 zu finden.

Entwicklungskosten

Entwicklungskosten werden entsprechend der in der Anhangangabe 2.4 dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode aktiviert. Für Zwecke der Ermittlung der zu aktivierenden Beträge hat die Unternehmensleitung Annahmen über die Höhe der erwarteten künftigen Cash Flows aus Vermögenswerten, die anzuwendenden Abzinsungssätze und den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen Cash Flows, die die Vermögenswerte generieren, vorzunehmen. Nach bestmöglicher Schätzung betrug der Buchwert der aktivierten Entwicklungskosten zum 31. Dezember 2006 7.993.837 Euro (2005: 7.039.118 Euro).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden mit folgenden Ausnahmen:

Der Konzern hat im Geschäftsjahr die nachfolgend aufgelisteten neuen und überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen angewandt. Aus der Anwendung dieser neuen oder überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. Sie führten jedoch teilweise zu zusätzlichen Angaben.

- ▶ IAS 19 Änderung – Leistungen an Arbeitnehmer
- ▶ IAS 21 Änderung – Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse
- ▶ IAS 39 Änderung – Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
- ▶ IFRIC 4 Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält
- ▶ IFRIC 5 Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung, Wiederherstellung und Umweltsanierung
- ▶ IFRIC 6 Verbindlichkeiten, die sich aus einer Teilnahme an einem spezifischen Markt ergeben – Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Die folgenden IFRS Standards wurden in 2006 verabschiedet und sind erst ab dem Jahr 2007 und später anzuwenden.

- ▶ IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben
- ▶ IAS 1 Änderung – Darstellung des Abschlusses
- ▶ IAS 32 Angaben und Darstellung
- ▶ IFRIC 8 Anwendungsbereich von IFRS 2
- ▶ IFRIC 11 Konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen Anteilen nach IFRS 2
- ▶ IFRIC 12 Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

Der Konzern hat beschlossen, diese Standards nicht vorzeitig anzuwenden. Aus derzeitiger Sicht ergibt sich hieraus keine materielle Auswirkung.

2 Grundsätze der Konsolidierung

Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

In den für das Geschäftsjahr 2006 aufgestellten Konzernabschluss sind neben der ELMOS Semiconductor AG alle Gesellschaften – soweit nicht unwesentlich – einbezogen, bei denen die ELMOS unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt oder aufgrund sonstiger Rechte ein Beherrschungsverhältnis im Sinne von IAS 27 „Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS“ besteht. Der Kapitalkonsolidierung liegt die Erwerbsmethode zugrunde. Dabei werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit dem anteiligen Saldo der zum beizulegenden Zeitwert erworbenen identifizierten Vermögenswerte und Schulden aufgerechnet. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden vollständig mit den beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Der Saldo eines verbleibenden aktiven Unterschiedsbetrags ist als Geschäftswert ausgewiesen.

Die Jahresabschlüsse der in den ELMOS-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt.

Alle wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Transaktionen zwischen den konsolidierten Gesellschaften wurden im Konzernabschluss eliminiert.

Beteiligungen von mehr als 20%, aber nicht mehr als 50%, wurden, falls wesentlich, unter Anwendung der Equity-Methode erfasst.

Im Januar 1998 hat das Standing Interpretations Committee die Interpretation Nr. 12, „Konsolidierung – Zweckgesellschaften“ (SIC 12) veröffentlicht. SIC 12 stellt die Anwendung des IAS 27 hinsichtlich derjenigen einzubeziehenden Gesellschaften klar, deren Eigenkapitalgeber keine Kontrolle gemäß dem control-Konzept ausüben. Es erfordert die Konsolidierung von Gesellschaften, deren überwiegender Teil der erwarteten Verluste und Gewinne von dem berichtenden Konzern aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder anderer vertraglicher Vereinbarungen bzw. finanzieller Interessen übernommen werden.

Eine Aufstellung der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen befindet sich unter Textziffer 33.

Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen

Die funktionale Währung der ELMOS Semiconductor AG und der europäischen Tochtergesellschaften ist der Euro. Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt.

Auf Fremdwährung lautende Vermögenswerte und Schulden werden grundsätzlich zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Für Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die lokale Währung des jeweiligen Landes ist, in dem diese Gesellschaft ihren Sitz hat, werden Aktiva und Passiva, die in Fremdwährung in den

Bilanzen der ausländischen wirtschaftlich selbstständigen Tochtergesellschaften bilanziert werden, zu dem jeweiligen Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen Fremdwährungskursen während des zugrunde liegenden Zeitraums umgerechnet. Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der Bewertung des Eigenkapitals zum historischen Kurs und zum Stichtagskurs ergibt, wird als erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen.

Die Gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kursicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht an Spekulationsgeschäften beteiligt. Die Devisentermingeschäfte stellen kein Risiko für die Ertragslage der Gesellschaft dar, da die Gewinne und Verluste aus diesen Verträgen in der Regel die Gewinne und Verluste aus den gesicherten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgleichen. Sowohl zum 31. Dezember 2006 als auch zum 31. Dezember 2005 bestanden keine Devisentermingeschäfte.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Laufe des Berichtsjahres durch Mittelzuflüsse und -abflüsse verändert haben. Die Auswirkungen von Akquisitionen und Desinvestitionen und sonstigen Veränderungen des Konsolidierungskreises sind dabei eliminiert. In Übereinstimmung mit IAS 7 wird zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Tätigkeit, aus dem Investitionsbereich und aus dem Finanzierungsbereich unterschieden. Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finanzierungsaufwendungen und -erträge entsprechen im Wesentlichen den gezahlten Beträgen.

3 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von ASICs, ASSPs und mikromechanischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung. Die Umsatzerlöse werden ohne Umsatzsteuer und nach Abzug von gewährten Skonti ausgewiesen.

Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den Kunden bzw. bei Gefahrenübergang auf den Kunden.

Geschäfts- oder Firmenwert

Durch die Anwendung von IFRS 3, IAS 36 (überarbeitet 2004) und IAS 38 (überarbeitet 2004) ab dem Geschäftsjahr 2004 werden Geschäftswerte aus Unternehmensakquisitionen nicht länger planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Zum Erwerbszeitpunkt wird der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert jener zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet, die erwartungsgemäß von den erzielten Synergien aus dem Unternehmenszusammenschluss profitieren wird. Die Wertminderung wird durch die Ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierenden Einheit bzw. „Cash Generating Units“ (CGU), auf die sich der Geschäftswert bezieht, bestimmt. Liegt der erzielbare Betrag der CGU unter ihrem Buchwert, ist ein Wertminderungsaufwand auf den Geschäfts- oder Firmenwert zu erfassen.

Darüber hinaus ist ein Werthaltigkeitstest durchzuführen, sofern besondere Ereignisse oder Marktentwicklungen anzeigen, dass der Marktwert einer Berichtseinheit unter ihren Buchwert gefallen sein könnte.

Grundsätzlich wird die Werthaltigkeitsprüfung wie folgt durchgeführt:

Alle Geschäfts- oder Firmenwerte werden den entsprechenden CGUs zugeordnet. Dabei stellen die Tochtergesellschaften im Regelfall jeweils eine CGU dar.

Für jede CGU werden auf Basis einer Mehrjahresplanung die zukünftigen Cash Flows ermittelt. Die Mehrjahresplanung erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Danach wird eine 1,0%ige Wachstumsrate zugrunde gelegt. Anschließend wird der Barwert (im Folgenden auch „Value in Use“ genannt) dieser zukünftigen Cash Flows errechnet. Der verwendete Vorsteuer-Zinssatz wurde mit Hilfe des Capital Asset Pricing Model (CAPM) ermittelt und beträgt für die ELMOS Semiconductor AG 6,35%. Der Zinssatz entspricht den gewichteten, durchschnittlichen Kapitalkosten. Diese beruhen auf einem länderspezifischen risikofreien Zinssatz (4,35%) zuzüglich der durchschnittlichen Marktrisikoprämie (5,0%) multipliziert mit einem unternehmensbezogenen Eigenkapitalbeta (β) von 0,6 bis 0,7. Alle genannten Werte sind aus Marktdaten abgeleitet.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Aus der Entwicklung entstehende immaterielle Vermögenswerte werden entsprechend IAS 38 nur aktiviert, wenn es u.a. (a) hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird und (b) die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bemessen werden können. Diese Kriterien treffen für die aktivierten Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von ASICs zu. Mit der Abschreibung wird nach Abschluss der Entwicklungsphase bzw. bei Beginn der Vorseerienfertigung begonnen.

Die Aktivierung der Entwicklungskosten erfolgt, nachdem die technologische Durchführbarkeit bzw. Realisierbarkeit hergestellt ist und die sog. Engineering-Phase (sog. QB II-Status) erreicht wird.

Die Aktivierung findet nur für Projekte statt, die im Kundenauftrag erfolgen.

Die Kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen Grundlage über die geschätzte Nutzungsdauer von 7 Jahren amortisiert.

Aufwendungen für die Anmeldung von Patenten und den Erwerb von Design- und Prozesstechnologie werden aktiviert. Aufwendungen werden unter Verwendung der linearen Methode über die jeweils kürzere geschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Technologien, die Schutzfrist bei Patenten oder die Vertragsdauer, aber maximal über 18 Jahre abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 8 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Sachanlagen

Sachanlagen werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.

Die Sachanlagen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt linear abgeschrieben:

Gebäude	25 bis 50 Jahre
Einbauten	10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 12 Jahre

Im Falle, dass der Buchwert den voraussichtlich erzielbaren Betrag übersteigt, wird entsprechend IAS 36 (überarbeitet 2004) eine Wertminderung auf diesen Wert vorgenommen.

Bei Verkauf oder Abgang von Sachanlagevermögen werden die entsprechenden Anschaffungskosten sowie die dazugehörige kumulierte Abschreibung aus den entsprechenden Konten entfernt. Gewinn

ne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen werden als sonstige betriebliche Erträge oder Aufwendungen gezeigt. Wartung oder Instandhaltungsaufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

Unter Anwendung von IAS 17 werden geleaste Gegenstände, die der Gesellschaft als wirtschaftlichem Eigentümer zuzuordnen sind, aktiviert und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben (sog. Finance Leases). Entsprechend wird die Verbindlichkeit, die aus dem Leasingverhältnis entsteht, passiviert und um den Tilgungsanteil der geleisteten Leasingraten gemindert.

Andere Leasingverhältnisse, die die Gesellschaft eingegangen ist, werden als Operating-Leasingverhältnisse eingestuft. Die geleisteten Leasingzahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung linear über die Laufzeit erfasst.

Finanzinstrumente

Die bilanzierten Finanzinstrumente enthalten liquide Mittel, zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, übrige Fremdfinanzierungen und Finanzierungsleasing.

Finanzielle Vermögenswerte werden folgendermaßen klassifiziert: bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen, zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. Finanzielle Vermögenswerte mit festgelegten oder bestimmaren Zahlungen und festen Laufzeiten, die die Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten möchte und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und Forderungen, werden als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen klassifiziert. Finanzielle Vermögenswerte, die hauptsächlich erworben wurden, um einen Gewinn aus kurzfristigen Preis- bzw. Kursschwankungen zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Alle sonstigen finanziellen Vermögenswerte, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und Forderungen, werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte eingestuft.

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen werden unter den langfristigen Vermögenswerten bilanziert, es sei denn, sie werden innerhalb von 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag fällig. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden unter den kurzfristigen Vermögenswerten bilanziert. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden als kurzfristig eingestuft, wenn sie innerhalb von 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag realisiert werden sollen.

Bei der erstmaligen Erfassung eines finanziellen Vermögenswertes wird dieser mit den Anschaffungskosten angesetzt, die dem beizu-

legenden Zeitwert der gegebenen Gegenleistung entsprechen; Transaktionskosten werden mit einbezogen. Zur Veräußerung verfügbare und zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden in der Folge mit ihrem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von gegebenenfalls anfallenden Transaktionskosten und unter Angabe ihres notierten Marktpreises zum Bilanzstichtag bewertet.

Gewinne und Verluste aus der Bewertung eines zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerts zum beizulegenden Zeitwert werden direkt im übrigen Eigenkapital erfasst, bis der finanzielle Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder bis eine Wertminderung für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wurde, so dass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im Eigenkapital erfasste, kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis einbezogen wird.

Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten werden im Finanzergebnis erfasst. Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Erfassung entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt der vertraglichen Vereinbarung entweder als Schulden oder als Eigenkapital eingestuft.

Zinsen, Dividenden, Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, die als finanzielle Schulden klassifiziert werden, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen bzw. Erträge in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. Ausschüttungen an Inhaber von Finanzinstrumenten, die als Eigenkapital klassifiziert werden, werden direkt vom Eigenkapital abgesetzt. Sind Rechte und Pflichten bezüglich der Art der Erfüllung eines Finanzinstrumentes abhängig vom Eintreten oder Nichteintreten ungewisser zukünftiger Ereignisse oder dem Ausgang ungewisser Umstände, die außerhalb der Kontrolle sowohl des Emittenten als auch des Inhabers liegen, so wird das Finanzinstrument als Schuld klassifiziert, soweit es nicht zum Zeitpunkt der Emission sehr unwahrscheinlich ist, dass der Emittent zur Erfüllung von Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten verpflichtet ist. In diesem Fall würde das Instrument als Eigenkapital klassifiziert werden.

Vorratsvermögen

Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren Nettoverkaufswert am Bilanzstichtag bewertet. In den Herstellungskosten werden, neben den direkt zurechenbaren Kosten, auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen. Dabei werden fixe Gemeinkosten auf Grundlage der Normalauslastung der Produktionsanlagen berücksich-

tigt. Kosten der nicht genutzten Produktionskapazitäten (Leerkosten) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den Kosten der umgesetzten Leistung ausgewiesen. Wertberichtigungen auf Vorräte werden vorgenommen, soweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über den erwarteten Nettoveräußerungserlösen liegen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennbetrag unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Liquide Mittel)

Liquide Mittel umfassen für Zwecke der Finanzierungsrechnung Kassenbestände, Schecks, Bankguthaben sowie jederzeit veräußerbare Wertpapiere.

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche

Nach IFRS 5 wird ein Unternehmensbestandteil zu dem Zeitpunkt als aufgegeben eingestuft, ab dem dieser Unternehmensbestandteil die Kriterien für eine Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten erfüllt. Ein solcher Unternehmensbestandteil stellt einen gesonderten, wesentlichen Geschäftszweig oder geografischen Geschäftsbereich dar, ist Teil eines einzelnen, abgestimmten Plans zur Veräußerung eines gesonderten, wesentlichen Geschäftszweigs oder geografischen Geschäftsbereichs oder ist ein Tochterunternehmen, das ausschließlich mit der Absicht einer Weiterveräußerung erworben wurde.

Ein Vermögenswert ist als zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren, wenn der zugehörige Buchwert überwiegend durch ein Veräußerungsgeschäft und nicht durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für rechtliche oder faktische Verpflichtungen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, dann gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der Verpflichtung zu einem Abfluss von Konzernressourcen führt und eine zuverlässige Schätzung der Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann.

Die periodischen Netto-Rentenbeiträge unter IAS 19 setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die verschiedene Aspekte der finanziellen Vereinbarungen des Unternehmens sowie die Kosten der von den Arbeitnehmern bezogenen Leistungen widerspiegelt. Diese Komponenten werden unter Anwendung der versicherungsmathematischen Kostenmethode bestimmt und basieren auf versicherungsmathematischen Annahmen, die unter Textziffer 25 angegeben sind.

Die Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sehen vor:

- ▶ in der geplanten Leistungsverpflichtung alle Leistungsverbesserungen widerzuspiegeln, zu denen das Unternehmen ab dem aktuellen Bewertungsdatum verpflichtet ist,
- ▶ kumulative versicherungsmathematische Gewinne und Verluste von mehr als 10% der geplanten Leistungsverpflichtung über die erwarteten zukünftigen Leistungen aktiver im Plan erfasster Arbeitnehmer zu amortisieren.

Rückstellungen für Gewährleistung werden ab dem Verkaufszeitpunkt auf Grundlage des Verhältnisses der Garantiekosten zu den Umsatzerlösen in der Vergangenheit gebildet.

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern bemisst sich die Steuerlast nach der Höhe des jährlichen Einkommens und berücksichtigt Steuerlatenzen. Latente Steuern werden mit Hilfe der Verbindlichkeits-Methode (liability-method) ermittelt. Latente Ertragsteuern spiegeln den Nettosteueraufwand/-ertrag temporärer Unterschiede zwischen dem Buchwert eines Vermögenswertes oder einer Schuld in der Bilanz und deren Steuerwert wider. Die Bemessung latenter Steueransprüche und -schulden erfolgt anhand der Steuersätze, die erwartungsgemäß für die Periode gelten, in der ein Vermögenswert realisiert oder eine Schuld beglichen wird. Die Bewertung latenter Steuerschulden und -ansprüche berücksichtigt die steuerlichen Konsequenzen, die daraus resultieren, in welcher Art und Weise ein Unternehmen zum Bilanzstichtag erwartet, den Buchwert seiner Vermögenswerte zu realisieren oder seine Schulden zu begleichen.

Latente Steueransprüche und -schulden werden unabhängig von dem Zeitpunkt erfasst, an dem sich die temporären Buchungsdifferenzen voraussichtlich umkehren. Latente Steueransprüche und -schulden werden nicht abgezinst und werden in der Bilanz als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden ausgewiesen.

Ein latenter Steueranspruch wird für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede in dem Maße bilanziert, wie es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das der temporäre Unterschied verwendet werden kann. Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen nicht bilanzierte latente Steueransprüche neu. Das Unternehmen setzt einen bislang nicht bilanzierten latenten Steueranspruch in dem Umfang an, in dem es wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig zu versteuerndes Ergebnis die Realisierung des latenten Steueranspruches gestatten wird. Umgekehrt vermindert es den Buchungswert eines latenten Steueranspruches in dem Umfang, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ausreichendes zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen

wird, um vom Nutzen des latenten Steueranspruches – entweder zum Teil oder insgesamt – Gebrauch zu machen.

Tatsächliche Steuern und latente Steuern werden unmittelbar dem Eigenkapital belastet oder gutgeschrieben, wenn sich die Steuer auf Posten bezieht, die in der gleichen oder einer anderen Periode unmittelbar dem Eigenkapital gutgeschrieben oder belastet wird.

In dem Umfang wie nicht ausgeschüttete Gewinne ausländischer Beteiligungen auf unabsehbare Zeit in diesem Unternehmen investiert bleiben sollen, fallen keine latenten Steuerschulden an. Eine latente Steuerschuld wird für alle zu versteuernden temporären Differenzen ausgewiesen, soweit die latente Steuerschuld nicht aus dem Geschäftswert resultiert, für den eine Abschreibung zu Steuerzwecken nicht möglich ist.

Die aktiven latenten Steuern umfassen auch Steuerminderungsansprüche, die sich aus der erwarteten Nutzung bestehender Verlustvorträge in Folgejahren ergeben und deren Realisierung mit hinreichender Sicherheit gewährleistet ist.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden.

Gemäß IAS 1.70 werden latente Steuern als langfristig ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4 Segmentberichterstattung

Das primäre Berichtsformat der Gesellschaft basiert auf Geschäftssegmenten, das sekundäre Berichtsformat auf geografischen Segmenten. Die operativen Geschäfte werden hinsichtlich der Art der Produkte getrennt voneinander organisiert und geleitet, wobei jedes Segment eine strategische Geschäftseinheit darstellt, die unterschiedliche Produkte bereitstellt und unterschiedliche Märkte bedient. Die Umsätze zwischen den Segmenten erfolgen zu Verrechnungspreisen – abzgl. gezahlter Provisionen –, die denen bei Transaktionen mit fremden Dritten entsprechen.

Primäres Berichtsformat

Die Gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in zwei Bereiche ein:

Das Halbleitergeschäft wird über die verschiedenen Ländergesellschaften und -niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Südafrika und in den USA abgewickelt.

Umsätze im Mikromechanik-Bereich erwirtschaftet die Tochtergesellschaft SMI in den USA.

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu Erträgen und Ergebnissen sowie bestimmte Informationen zu Vermögenswerten und Schulden der Geschäftssegmente des Konzerns für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2006 und 2005.

Geschäftsjahr zum 31.12.2006	Halbleiter Tausend Euro	Mikromechanik Tausend Euro	Eliminierung Tausend Euro	Gesamt Tausend Euro
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	150.009	10.665	0	160.674
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	352	1.690	- 2.042	0
Segmentumsatzerlöse	150.361	12.355	- 2.042	160.674
Ergebnis				
Operatives Ergebnis	20.327	- 762		19.565
Finanzergebnis				- 2.791
Ergebnisanteil von Beteiligungsunternehmen	- 49			- 49
Sonstige betriebliche Erträge				4.177
Sonstige betriebliche Aufwendungen				- 3.582
Ergebnis vor Steuern				17.321
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				6.644
Jahresüberschuss inklusive Minderheitenanteilen				10.676
Vermögenswerte und Schulden				
Segmentvermögen	221.648	20.139		241.787
Beteiligungsinvestitionen	126	0		126
Gesamtvermögen	221.774	20.139		241.913
Segmentschulden	86.215	2.843		89.058
Sonstige Segmentinformationen				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	23.730	2.621		26.351
Abschreibungen	15.496	791		16.287
Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen (-) und Erträge	- 6.185	269		- 5.916
Geschäftsjahr zum 31.12.2005				
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	138.104	8.859	0	146.963
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	119	1.638	- 1.757	0
Segmentumsatzerlöse	138.223	10.497	- 1.757	146.963
Ergebnis				
Operatives Ergebnis	19.326	797		20.123
Finanzergebnis				- 3.421
Ergebnisanteil von Beteiligungsunternehmen	- 68	0		- 68
Sonstige betriebliche Erträge				2.052
Sonstige betriebliche Aufwendungen				- 2.295
Ergebnis vor Steuern				16.391
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				- 6.058
Jahresüberschuss inklusive Minderheitenanteilen				10.332
Vermögenswerte und Schulden				
Segmentvermögen	211.506	24.872		236.378
Beteiligungsinvestitionen	646	0		646
Gesamtvermögen	212.152	24.872		237.024
Segmentschulden	89.356	3.384		92.740
Sonstige Segmentinformationen				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	28.430	1.181		29.611
Abschreibungen	14.547	953		15.500
Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen (-) und Erträge	- 2.877	- 686		- 3.563

Sekundäres Berichtsformat

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu Umsatzerlösen, Aufwendungen und zu bestimmten Vermögenswerten der geographischen Segmente des Konzerns für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2006 und 2005.

Geschäftsjahr zum 31.12.2006	Deutschland Tausend Euro	EU-Länder Tausend Euro	USA Tausend Euro	Sonstige Tausend Euro	Eliminierung Tausend Euro	Gesamt Tausend Euro
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	60.019	59.933	21.545	19.177	0	160.674
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	1.688	2	352	0	- 2.042	0
Segmentumsatzerlöse	61.707	59.935	21.897	19.177	- 2.042	160.674
Vermögenswerte und Schulden						
Segmentvermögen	191.570	26.933	23.267	17		241.787
Beteiligungsinvestitionen	107	0	19	0		126
Gesamtvermögen	191.677	26.933	23.286	17		241.913
Segmentverschulden	82.334	3.663	3.053	8		89.058
Sonstige Segmentinformationen						
Investitionen in das Anlagevermögen	22.698	956	2.697	0		26.351
Abschreibungen	13.655	1.736	892	4		16.287

Geschäftsjahr zum 31.12.2005	Deutschland Tausend Euro	EU-Länder Tausend Euro	USA Tausend Euro	Sonstige Tausend Euro	Eliminierung Tausend Euro	Gesamt Tausend Euro
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	51.716	63.055	24.438	7.754	0	146.963
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	119	0	1.638	0	- 1.757	0
Segmentumsatzerlöse	51.835	63.055	26.076	7.754	- 1.757	146.963
Vermögenswerte und Schulden						
Segmentvermögen	165.057	39.874	31.447	0		236.378
Beteiligungsinvestitionen	107	0	19	520		646
Gesamtvermögen	165.164	39.874	31.466	520		237.024
Segmentverschulden	83.659	5.402	3.679	0		92.740
Sonstige Segmentinformationen						
Investitionen in das Anlagevermögen	26.311	2.051	1.249	0		29.611
Abschreibungen	12.196	2.232	1.072	0		15.500

5 Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von ASICs, ASSPs und mikromechanischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung.

Die Umsatzerlöse setzen sich für den Konzern und seine Segmente wie folgt zusammen:

	2006 Euro	2005 Euro
Halbleiter	150.009.437	138.104.306
Mikromechanik	10.664.450	8.859.131
Konzern	160.673.887	146.963.437

Die Umsatzerlöse überschritten in 2006 erstmals die 160 Millionen-Euro-Marke und liegen damit um 9,3% über denen des Vorjahres. Der Mikromechanik-Bereich trug deutlich zum Umsatzwachstum bei und stieg um 20,4% auf 10,7 Millionen Euro in 2006.

6 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Umsatzkosten

Die Herstellungskosten enthalten die Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen. Neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten enthalten sie auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen. Die Herstellungskosten enthalten dazu die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Die Herstellungskosten haben sich wie folgt entwickelt:

	2006 Euro	2005 Euro
Materialaufwand	31.474.574	22.727.634
Personalaufwand	29.595.550	28.833.110
Sonstige Gemeinkosten	31.137.729	27.242.520
Bestandsverminderung (-erhöhung)	- 4.577.928	- 2.466.735
	87.629.925	76.336.529

Der starke Umbruch im Produktmix wirkte sich weiterhin belastend auf die Umsatzkosten aus. Die im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich höhere Anzahl komplexer Produkte und der Anlauf der neuen Fertigung in Duisburg, sowie die Vorleistungen für Mikrosystemprojekte und ASSPs erhöhten die Herstellkosten. Zudem stiegen die Rohstoff- und Energiekosten deutlich.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Bedeutende Aufwendungen fallen regelmäßig im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten an, die in Erwartung auf zukünftige Erlöse durchgeführt werden. Forschungsaufwendungen werden

entsprechend dem Anfall der Arbeiten ergebnismindernd berücksichtigt. Entwicklungsaufwendungen werden je nach Projekt aktiviert und dann planmäßig abgeschrieben bzw. – sofern die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind – ergebnismindernd verbucht. Im Geschäftsjahr 2006 wurden Ausgaben in Höhe von 29.583.236 Euro (2005: 28.124.440 Euro) als Aufwand erfasst.

Vertriebskosten

Zu den Vertriebskosten gehören im Wesentlichen Aufwendungen für Personal und Abschreibungen.

Verwaltungsaufwendungen

Zu den Verwaltungsaufwendungen zählen neben den Kosten des im Verwaltungsbereich tätigen Personals auch anteilige Personalkosten des Vorstands. Wesentliche Posten sind weiter die Aufwendungen aus Abschreibungen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung im Verwaltungsbereich an.

7 Zusätzliche Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Im Rahmen der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung in Form des Umsatzkostenverfahrens erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen nach Funktionsbereichen. In den Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten und den Kosten für Forschung und Entwicklung waren die nachstehend aufgeführten Kostenarten wie folgt enthalten:

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2006 40.699.442 Euro und sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Vorjahreswert: 38.830.018 Euro). Sie setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand stieg um 8,1% von 52.466.931 Euro im Geschäftsjahr 2005 auf 56.711.212 Euro im Geschäftsjahr 2006. Im gleichen Berichtszeitraum ist die Anzahl der Mitarbeiter – gemessen als durchschnittlicher Beschäftigungsquotient – von 1.028 im Geschäftsjahr 2005 auf 1.102 im Geschäftsjahr 2006 gestiegen. Der Anstieg des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Anzahl von Beschäftigten zurückzuführen. Weiter gehende Angaben zu den Beschäftigten finden sich unter Textziffer 40 Mitarbeiterzahlen.

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagenpiegel.

Aufgrund des Umsatzkostenverfahrens sind die Abschreibungen für Sachanlagegüter und übrige immaterielle Vermögenswerte in der Gewinn- und Verlustrechnung auf die Positionen Umsatzkosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebskosten und Verwaltungskosten verteilt worden.

8 Finanzierungsaufwendungen und -erträge

Die Finanzierungsaufwendungen betragen 2.954.883 Euro in 2006 gegenüber 7.588.365 Euro in 2005. Sie beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Banken sowie langfristige Verbindlichkeiten.

Unter der Position Finanzierungserträge wurden im Berichtsjahr im Wesentlichen Zinserträge ausgewiesen. Die Finanzierungserträge beliefen sich in Summe auf 452.319 Euro (2005: 3.973.355 Euro).

Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finanzierungsaufwendungen und -erträge entsprechen im Wesentlichen den gezahlten Beträgen.

9 Wechselkursverluste und -gewinne

Die erfolgswirksam erfassten Verluste aus Umrechnungsdifferenzen betragen im Geschäftsjahr 2006 288.115 Euro (2005: 193.744 Euro Umrechnungsgewinne).

Die erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferenzen belaufen sich im Geschäftsjahr 2006 auf 4.991.418 Euro (2005: 4.154.301 Euro) unter Berücksichtigung der darauf entfallenden latenten Steuern. Weitergehende Angaben zu den erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferenzen stehen unter der Textziffer 23 Eigenkapital.

10 Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (2006: 4.176.926 Euro, 2005: 2.051.664 Euro) umfassen wesentliche Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 1.416 Tausend Euro und Investitionszuschüssen in Höhe von 363 Tausend Euro.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2006: 3.581.829 Euro, 2005: 2.294.635 Euro) enthalten unter anderem Aufwendungen für Garantieleistungen (einschließlich Zuführungen zu den Rückstellungen) und Wertberichtigungen auf Forderungen.

11 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Als Ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder geschuldeten Steuern auf Einkommen und Ertrag als auch die latenten Steuerabgrenzungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ausgewiesen.

	2006 Euro	2005 Euro
Ertragsteueraufwand		
Deutschland	627.597	2.493.839
Ausland	557.992	1.170.074
	1.185.589	3.663.913
davon Anpassungen von im Vorjahr angefallenen tatsächlichen Ertragssteuern	23.140	69.243
Latente Steuern		
Deutschland	2.257.994	592.686
Ausland	3.200.787	1.801.796
	5.458.781	2.394.482
	6.644.370	6.058.395

Latente Steuern sind nach der so genannten Verbindlichkeitsmethode gemäß IAS 12 berechnet worden. Für Deutschland wurde der kombinierte Ertragsteuersatz von 39,9% (2005: 39,9%) angewandt. Dieser kombinierte Steuersatz der Gesellschaft berücksichtigt den Gewerbesteuerhebesatz von 450% (2005: 450%), den Körperschaftsteuersatz von 25,0% (2005: 25,0%) sowie den Solidaritätszuschlag von 5,5% (2005: 5,5%).

Latente Steuern spiegeln die steuerlichen Auswirkungen aus zeitlichen Unterschieden zwischen den Buchwerten der Aktiva und Passiva in den handelsrechtlichen Abschlüssen einerseits und den in den steuerlichen Abschlüssen verwendeten Werten andererseits wider. Wesentliche Bestandteile der aktiven und passiven latenten Steuern der Gesellschaft sind unter der Textziffer 16 Latente Steueransprüche dargestellt.

Die Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Nominalsteuersatz und den von der Gesellschaft tatsächlich zu zahlenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag stellen sich wie folgt dar:

	2006 Prozent	2005 Prozent
Gesetzlicher Nominalsteuersatz	39,90	39,90
Nicht abzugsfähige Aufwendungen	0,58	0,83
Dividenden auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	0,00	- 5,56
Unterschiedsbetrag aus ausländischen Steuersätzen	- 7,70	0,03
Steuersatzänderungen Ausland	6,34	1,28
Sonstige	- 0,80	0,48
Effektiver Steuersatz	38,32	36,96

Der Effekt aus der Absenkung der Steuersätze ab 2007 in den Niederlanden beträgt 1.100 Tausend Euro.

12 Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Stammaktien berechnet. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien zuzüglich aller Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter nach der sogenannten „Treasury Stock Method“ berechnet.

Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde wie folgt ermittelt:

Abstimmung der Aktien

	2006	2005
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien	19.413.310	19.343.663
Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter	14.056	68.014
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien einschließlich Verwässerungseffekt	19.427.366	19.411.677

Berechnung des Ergebnisses pro Aktie

	2006	2005
Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen	10.694.672	10.035.827
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,55	0,52
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,55	0,52

Erläuterungen zur Bilanz

13 Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
SMI		
Anschaffungskosten	7.567.365	7.567.365
Fremdwährungsanpassung	- 2.513.636	- 1.937.532
Buchwert	5.053.729	5.629.833
ELMOS NA		
Anschaffungskosten	554.617	554.617
Fremdwährungsanpassung	6.549	28.535
Buchwert	561.166	583.152
ELMOS France	1.614.578	1.614.578
ELMOS Services B.V.	206.170	206.170
	7.435.643	8.033.733

Gemäß IFRS 3 wird der Geschäfts- oder Firmenwert nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern auf Werthaltigkeit getestet. Die Bewertung erfolgt auf Basis einer CGU. In 2006 wurden Werthaltigkeitstests durchgeführt, aus denen sich kein Wertminderungsbedarf ergab.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Entwicklungsprojekte	7.738.958	5.846.224
Software und Lizenzen	20.214.295	16.809.225
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	3.635.053	4.155.055
	31.588.306	26.810.504

Entwicklungsprojekte

In 2006 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Produktentwicklungen in Höhe von 2.692.363 Euro (2005: 2.359.434 Euro) aktiviert. Die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungen betragen in 2006 1.737.644 Euro (2005: 1.289.322 Euro). Der Buchwert der aktivierten Entwicklungsleistungen (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen Projekte) beträgt zum 31. Dezember 2006 7.993.837 Euro (2005: 7.039.118 Euro).

Software und Lizenzen

In 2006 wurden Aufwendungen für Prozesstechnologie in Höhe von 2.119.337 Euro aktiviert. Die Abschreibungen betragen in 2006 420.713 Euro. Bis zum 31. Dezember 2006 beliefen sich die aktivierten Buchwerte für als Gegenstände des Anlagevermögens aktivierte Prozesstechnologie auf 9.319.802 Euro, zum 31. Dezember 2005 beliefen sich diese auf 7.621.177 Euro.

Sonstiges

Die Kosten, die mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte verbunden sind, sowie bedeutende Produktverbesserungen werden entsprechend ihres Anfalls in den Aufwand gebucht und sind in den Kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 3.190 Tausend Euro wurden von Kunden in 2006 erstattet (3.124 Tausend Euro in 2005).

14 Sachanlagen

Sachanlagen

Die Entwicklung der Sachanlagen ist im Konzern-Anlagenspiegel dargestellt.

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Grund und Boden	3.224.533	5.414.837
Gebäude und Einbauten	33.745.098	41.502.727
Technische Anlagen und Maschinen	54.334.675	46.569.711
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.252.184	8.472.312
	95.556.490	101.959.587

Der Abschreibungsaufwand belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf 11.618.709 Euro (2005: 11.609.391 Euro).

Im Geschäftsjahr 2006 und im Vorjahr wurden keine Fremdkapitalkosten aktiviert.

Leasingverhältnisse

Am 22. Dezember 1997 hat die Gesellschaft eines ihrer Geschäftsgebäude (einschließlich Grundstück und Einbauten) für einen Gesamtkaufpreis von 23.008.135 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von 9 Jahren sowie das Grundstück und das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von 1.942.772 Euro (1.121.180 Euro für Einbauten sowie 821.592 Euro für Grundstück und Gebäude) bis 2006 und in Höhe von 1.917.207 Euro (für Grundstück und Gebäude) bis 2020 verpflichtet. Die Transaktion wurde als

Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen bilanziert werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Am 7. Juli 2000 hat die Gesellschaft eine Gebäudeerweiterung (einschließlich Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von 6.287.853 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von 7,5 Jahren sowie das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von 1.074.788 Euro bis 2007 und in Höhe von 60.872 Euro bis 2022 (für Gebäude) verpflichtet. Die Transaktion wurde als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen bilanziert werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Am 8. November 2001 hat die Gesellschaft ein weiteres Geschäftsgebäude und das dazugehörige Parkhaus (einschließlich Grundstück und Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von 11.643.000 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten sowie das Grundstück, die Gebäude und das Parkhaus für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen, degressiv fallenden Gesamtmietzahlungen, beginnend mit einer Höhe von 1.016.125 Euro bis 2021 verpflichtet. Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2003 erfolgte die Fertigstellung der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 3.419.000 Euro. Die zu zahlenden Leasingraten betragen 279.000 Euro p.a. bis 2021. Die Transaktion wurde ebenfalls als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen bilanziert werden.

Der Buchwert der geleasteten Anlagegüter setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Geleaste Anlagegüter	48.013.030	48.363.030
Kumulierte Abschreibung	- 25.991.428	- 23.949.619
	22.021.602	24.413.411

Die Abschreibung erfolgt über die Vertragslaufzeit bzw. über die längere Nutzungsdauer gemäß IAS 17.28, ist im Abschreibungsaufwand enthalten und beträgt für das Jahr 2006 2.041.809 Euro (2005: 2.630.550 Euro). Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen werden von der Gesellschaft als kurz- bzw. langfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Kurzfristiger Anteil (Fälligkeit innerhalb 1 Jahr)	3.432.057	3.213.414
Langfristiger Anteil (Fälligkeit > 1 Jahr)	27.528.059	32.188.714
	30.960.116	35.402.128

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Summe der künftigen Mindestleasingzahlungen zum Bilanzstichtag zu deren Barwert:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Innerhalb eines Jahres	4.756.033	5.476.968
Zwischen einem Jahr und fünf Jahren	13.417.288	14.866.075
Später als fünf Jahre	21.068.127	33.487.355
	39.241.448	53.830.398
Zukünftige Zinsanteile der Finanzierungsleasingverträge	8.281.332	18.428.270
Barwert der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen	30.960.116	35.402.128

15 At-Equity bewertete Beteiligungen sowie Wertpapiere und Anteile

Die Gesellschaft ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
attoSensor	1	1
ELMOS Industries	1	0
MOS Limited	0	519.642
Exedra	26.434	26.434
Epigone	20.824	20.824
IndustrieAlpine	25.788	25.788
Advanced Appliances Chips	34.000	34.000
ELMOS USA Inc.	19.107	19.107
	126.156	645.796

attoSensor GmbH

Zum 31. Dezember 2004 hielt die Gesellschaft 30% der Anteile. Am 26. Januar 2005 hat die Gesellschaft weitere 15% bzw. einen Anteil von 10.200 Euro am gezeichneten Kapital zu einem Kaufpreis von 10.403 Euro erworben. Das Stammkapital dieser Gesellschaft ist auf 40.000 Euro erhöht worden. ELMOS hält zum 31. Dezember 2006 45% der Anteile.

ELMOS Industries GmbH

Zum 31. Dezember 2006 hielt die Gesellschaft 49% der Anteile. ELMOS Industries erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 einen Jahresfehlbetrag von 161.912,02 Euro. Daher wurde der Beteiligungsansatz auf einen Erinnerungswert von 1,00 Euro abgewertet. Somit verbleibt ein anteiliger, bislang nicht erfasster Verlust von 30.336,89 Euro.

Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria, Südafrika

Die Gesellschaft hat einen Anteil in Höhe von 67,6% an MOS. MOS wurde in 2006 erstmalig in den Konsolidierungskreis einbezogen. Im Rahmen des Übergangs auf die Vollkonsolidierung nach IFRS 3 erfolgte eine Anpassung des Bilanzgewinnes in Höhe von 516 Tausend Euro.

Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co.

Vermietungs KG, Mainz und Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

Die beiden Tochterunternehmen wurden nicht mit in den Konsolidierungskreis aufgenommen, weil ELMOS nicht die Mehrheit der Stimmrechte gehören.

Es handelt sich bei beiden Unternehmen um Einheiten, die lediglich für Zwecke der Abwicklung zweier Sale-and-Lease-back Konstruktionen gegründet worden sind und die Vermietung der von der ELMOS veräußerten Verwaltungsgebäude und dazugehörigen Grundstücke (inkl. Parkhaus) an ELMOS übernehmen. Die entsprechenden Vermögenswerte und Finanzierungsverbindlichkeiten sind in der Konzernbilanz bilanziert.

IndustrieAlpineBausträger GmbH, München

Das vorstehend aufgeführte Unternehmen wurde aus Wesentlichkeitsgründen nicht mit in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Der wesentliche Teil des Vermögens, betreffend die operative Tätigkeit der Gesellschaft, wird von der ELMOS Semiconductor AG bereits im Konzernabschluss bilanziert.

Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt

Die Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt, (33,3% Beteiligungsquote) wird wegen untergeordneter Bedeutung nicht nach der Equity-Methode bilanziert.

Elmos USA Inc., Farmington Hills, USA

Bei dieser Gesellschaft handelt es sich um die Holdinggesellschaft für die US-amerikanischen Tochtergesellschaften. Sie übt keine eigene selbstständige Geschäftstätigkeit aus.

Zusammengefasste Finanzinformationen:

Assoziierte Unternehmen	Bilanzsumme TEuro	Gesamt- betrag der Schulden TEuro	Erträge TEuro	Perioden- ergebnis TEuro
attoSensor*	211	158	579	4
ELMOS Industries*	90	152	0	-162
Exedra*	13.856	13.854	1.945	18
Epigone*	13.040	13.011	515	-3
IndustrieAlpine**	—	—	—	—
Advanced Appliances Chips*	326	135	1.178	148
ELMOS USA Inc.**	—	—	—	—

* Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2006.

** Es liegen derzeit keine Abschlüsse der Gesellschaften vor.

16 Latente Steueransprüche

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Aktive latente Steuern		
Geschäfts- oder Firmenwert	6.234.495	8.141.809
Finanzierungsleasing	3.051.795	2.955.242
Wertberichtigung Finanzinstrumente	0	836.211
Pensionsrückstellungen	303.602	281.226
Verlustvortrag	1.785.878	2.379.384
Sonstige/Währungsdifferenzen	670.322	10.789
	12.046.092	14.604.661
Passive latente Steuern		
Sachanlagevermögen	2.007.019	1.925.011
Immaterielle Vermögenswerte	5.313.373	3.577.811
	7.320.392	5.502.822
Aktive latente Steuern, netto	4.725.700	9.101.839

Die Summe der temporären Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen an Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen, für die keine latenten Steuerschulden bilanziert wurden, beträgt 486.000 Euro.

Die Aktivierung latenter Steueransprüche auf Verlustvorträge erfolgte auf Basis der mittelfristigen Unternehmensplanungen der betroffenen Gesellschaften.

17 Vorratsvermögen

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Rohstoffe	9.477.183	7.020.874
Unfertige Erzeugnisse	17.735.397	15.311.787
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.929.655	5.371.929
	31.142.235	27.704.590

Die Wertminderung von Vorräten, die als Aufwand erfasst worden ist, beläuft sich auf 0 Euro (2005: 136.692 Euro). Dieser Aufwand wird unter Umsatzkosten ausgewiesen.

18 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.006.064	29.401.902
Wertberichtigungen	-231.663	-337.862
	27.774.401	29.064.040

Die Gesellschaft bewertet laufend die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden und verlangt in der Regel keine Sicherheiten. Die Gesellschaft hat Wertberichtigungen auf mögliche Forderungsausfälle vorgenommen. Derartige Forderungsausfälle entsprachen den Schätzungen und Annahmen des Vorstandes und bewegen sich im geschäftsüblichen Umfang.

19 Wertpapiere

Die Wertpapiere setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Anteilsbriefe	0	5.350.375

Nachfolgend erfolgt eine Aufgliederung der Wertpapiere des Umlaufvermögens:

	Anschaffungskosten Euro	Marktwert Euro
Anteilsbriefe – 31.12.2005	19.060.318	5.350.375
Anteilsbriefe – 31.12.2006	0	0

Die in 2005 erfasste Zuschreibung betrug 1.720.513 Euro und wurde erfolgsneutral erfasst.

Die Anteilspapiere wurden im März 2006 zu einem Preis von 5.046.137 Euro verkauft. Unter Berücksichtigung der im Vorjahr erfolgsneutral innerhalb des übrigen Eigenkapitals erfassten Zuschreibung in Höhe von 1.720.513 Euro ergab sich in 2006 ein Buchgewinn von 1.416.275 Euro der erfolgswirksam erfasst wurde.

20 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Gesellschaft behandelt alle Kapitalanlagen mit hoher Fungibilität mit einer Fälligkeit von bis zu drei Monaten zum Zeitpunkt des Erwerbs als Barvermögen.

Für den Zweck des Konzernabschlusses umfassen die Zahlungsmittel Kassenbestände und Bankguthaben.

21 Sonstige Vermögenswerte

Die sonstigen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag belaufen sich auf 13.586.114 Euro (2005: 10.937.674 Euro) und umfassen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche, kurzfristige Ausleihungen und verschiedene kurzfristige Forderungen.

22 Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird

Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte setzen sich aus dem seit 2005 im Bau befindlichen und in 2006 neu errichteten Produktionsabschnitt am Standort Dortmund, einem weiteren parzellierten Grundstück in München und technischen Anlagen und Maschinen zusammen. Die Vermögenswerte sind dem Segment Halbleiter zuzuordnen.

Der Produktionsabschnitt wird in 2007 im Rahmen einer Sale-and-Lease-back Transaktion veräußert. Der Plan zur Veräußerung wurde in 2006 gefasst, erste Gespräche mit Leasinggesellschaften wurden bereits geführt. Hinsichtlich des weiteren in München befindlichen Grundstücks befindet sich die Gesellschaft in konkreten Verkaufsverhandlungen. Mit einer Veräußerung beider Vermögenswerte wird in 2007 gerechnet.

Der Ausweis unter „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ hat in 2006 keinen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

23 Eigenkapital

Grundkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 (2005: 19.412.424) auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.413.805,00 Euro (2005: 19.412.424 Euro) ist voll eingezahlt.

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2006 wie folgt dar:

	Euro	Prozent
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789	7,6
Hinrichs GmbH	3.236.584	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833	11,9
Streubesitz	9.148.015	47,1
	19.413.805	100,0

Mitarbeiter haben im Jahr 2006 vom Optionsrecht zum Aktienwerb Gebrauch gemacht, was zur Ausgabe von 1.381 nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, die auf den Inhaber lauten, geführt hat.

Genehmigtes und bedingtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 9.650.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 886.195 Euro eingeteilt in 886.195 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal 930.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der

ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden.

Kapitalrücklage

Die Zusammensetzung der Kapitalrücklage ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
Aufgelder	84.781.840	84.772.353
Aktioptionen	3.951.975	3.498.363
	88.733.815	88.270.716

Die Kapitalrücklage enthält Aufgelder aus Kapitalerhöhungen und der Ausgabe von Aktien der ELMOS Semiconductor AG. Darüber hinaus wird hier der Aufwand aus der Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiter gegen gebucht.

Übriges Eigenkapital

Nach IAS 39 sind zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Der Gewinn oder Verlust aus einem zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswert wird in der Aufstellung über die Veräußerung des Eigenkapitals direkt im Eigenkapital erfasst. Daneben werden Effekte aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften in dieser Position erfasst.

Die kumulierten erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
Fremdwährungsanpassungen	- 6.555.997	- 3.940.912
Latente Steuern (auf Fremdwährungsanpassungen gesondert)	1.564.579	- 213.389
Nicht realisierte Gewinne aus zur Veräußerung stehenden Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	1.720.513
Latente Steuern (auf nicht realisierte Wertpapiergewinne)	0	- 509.272
Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals	- 4.991.418	- 2.943.060

24 Aktienbasierte Vergütungsprogramme

Die Gesellschaft hat ein Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ziel dieses Programms ist es, den Erfolg des Unternehmens dadurch zu sichern, dass die Mitarbeiter Aktien der Gesellschaft erwerben können. Im Rahmen des Programms ist die Gesellschaft zur Gewährung von 1.000.000 neuen Stückaktien (bedingtes Kapital I), wovon bereits 113.805 Aktienoptionen ausgeübt worden sind, bzw. 930.000 neuen Stückaktien (bedingtes Kapital III) berechtigt.

Folgende Tranchen an Aktienoptionen existieren:

Nr.	Beschluss-jahr	Ausgabe-jahr	Ausübungs-kurs in Euro	Sperrfrist ab Ausgabe (Jahre)	Ausübungs-zeitraum nach Sperrfrist (Jahre)	Ausstehende Optionen per 31.12.2005 (Anzahl)	2006 ausgeübt (Anzahl)	2006 verfallen (Anzahl)	Ausstehende Optionen per 31.12.2006 (Anzahl)
1	1999	2000	34,89	3	3	99.447	0	99.447	0
2	2000	2001	35,14	3	3	126.450	0	2.350	124.100
3	2002	2003	7,87	2	3	166.967	1.381	750	164.836
4	2003	2004	11,59	2	3	289.822	0	15.200	274.622
5	2004	2005	13,98	2	3	160.673	0	9.030	151.643
						843.359	1.381	126.777	715.201

Der Ausübungspreis entspricht für die erste bis vierte Tranche 120% und für die fünfte Tranche 110% des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an den zehn Handelstagen vor dem Vorstandsbeschluss über die Ausgabe und die Festlegung der Einzelheiten der jeweiligen Tranche. Die Optionen können nur ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. Die Bezugsrechte können gegen Zahlung des Ausgabepreises ausgeübt werden.

Die Optionen können bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit drei Jahre bzw. zwei Jahre nach ihrer Gewährung ausgeübt werden und erlöschen nach sechs bzw. fünf Jahren.

In 2005 wurden erstmals Optionen aus der dritten Tranche, insgesamt 112.424 Stück, ausgeübt. In 2006 wurden aus der gleichen Tranche weitere 1.381 Optionen ausgeübt.

Die Bewertung der Aktienoptionen erfolgte entsprechend den Bestimmungen des IFRS 2 für „equity-settled share-based payment transactions“ zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2006 unter Zuhilfenahme der Black-Scholes-Methode:

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug 14,23 Euro für die erste und zweite Tranche, 4,40 Euro für die dritte Tranche, 5,07 Euro für die vierte Tranche und 6,06 Euro für die fünfte Tranche. Der beizulegende Wert am Tag der Gewährung wurde unter Anwendung der Black-Scholes-Methode zur Optionspreisberechnung auf Grundlage der folgenden Annahmen ermittelt:

Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Werts

	Tranche 1+2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
Dividendenertrag	1,4%	2,0%	2,0%	1,5%
Erwartete Volatilität	61,7	59,1	59,1	85,0
Risikoloser Zinssatz zum Gewährungszeitpunkt	6,0%	5,5%	5,5%	2,76%
Erwartete Laufzeit in Jahren	5	5	5	5

Im Berichtsjahr sind der Gesellschaft Aufwendungen in Höhe von 453.611 Euro (2005: 1.289.725 Euro) für das Aktienoptionsprogramm entstanden.

25 Rückstellungen

Kurzfristige Rückstellungen

	1.1.2006 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	31.12.2006 Euro
Urlaubsrückstellung	1.197.150	1.197.150	0	1.157.339	1.157.339
Tantiemerückstellung	611.478	573.546	11.933	746.513	772.512
Berufsgenossenschaft	218.900	218.495	405	267.200	267.200
Garantieleistung	1.108.800	810.949	0	1.262.123	1.559.974
Lizenzen	472.910	470.107	0	459.764	462.567
Sonstige Rückstellungen	783.387	543.695	47.444	711.141	903.389
	4.392.625	3.813.942	59.782	4.604.080	5.122.981

Langfristige Rückstellungen

Die Entwicklung der bilanzierten Nettoschuld stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Barwert der Verpflichtung	3.229.159	3.006.721
Aktivwert Rückdeckungsversicherung	- 1.923.742	- 1.749.405
Nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 162.780	- 135.612
In der Bilanz erfasste Schuld	1.142.637	1.121.704

Die Gesellschaft unterhält eine betriebliche Altersversorgung für Mitglieder des Vorstandes der ELMOS Semiconductor AG und für Mitglieder der Vorstände der Tochtergesellschaften. Die Vergütung richtet sich gemäß den Pensionsplänen nach dem Arbeitsentgelt während der aktiven Tätigkeit.

Von der Gesellschaft wurden Rückdeckungsversicherungen für die Pensionszusagen abgeschlossen, deren Ansprüche an die Anspruchsberechtigten abgetreten wurden.

Während der Laufzeit der Renten werden diese mit 1,5% p.a. angepasst. Die erwarteten Gehaltssteigerungen werden mit 0,0% angesetzt.

Die Ermittlung der Teilwerte erfolgt nach IAS 19. Der Rechnungszinsfuß beträgt im Berichtsjahr 4,25% p.a. Als versicherungsmathematische Annahmen für das Sterbe- und Berufsunfähigkeitsrisiko wurden die Heubeck-Richttafeln 2005 G verwendet.

Die Pensionsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Dienstzeitaufwand	84.068	150.876
Zinsen	123.263	130.368
Erfasste versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	3.263	0
Pensionsaufwand (netto)	210.594	281.244

Die Änderungen des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

	2006 Euro	2005 Euro
Pensionsverpflichtung zum 1.1.	3.006.721	2.607.573
Pensionsaufwand	210.594	281.244
Leistungen an Rentner	- 79.262	- 59.446
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	27.168	177.350
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand	63.938	0
Pensionsverpflichtung zum 31.12.	3.229.159	3.006.721

	2006 Euro	2005 Euro
Aktivwert Rückdeckungsversicherung	1.923.742	1.749.405

Die Erträge aus der Rückdeckungsversicherung betragen 174.337 Euro (2005: 638.686 Euro) inklusive der Leistungen aus der Auszahlung im Todesfall. Beiträge werden in Höhe von 290.681 Euro (2005: 233.611 Euro) gezahlt.

Des Weiteren bestehen für Mitglieder des Vorstandes der ELMOS Semiconductor AG mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung nach IAS 19.104D keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2006 betragen die Beiträge für diese Pensionspläne 341.048 Euro (2005: 176.995 Euro).

Die für Arbeitnehmer erfolgten Rentenbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung in 2006 betragen 3.339.327 Euro (2005: 3.336.841 Euro). Die Beiträge zu Direktversicherungen für Arbeitnehmer betragen in 2006 12.000 Euro.

Beträge der laufenden und der vorangegangenen zwei Berichtsperioden stellen sich wie folgt dar:

	2006 Euro	2005 Euro	2004 Euro
Pensionsverpflichtung	3.229.159	3.006.721	2.649.311
Aktivwert Rückdeckungsversicherung	- 1.923.742	- 1.749.405	- 1.110.719
Überdeckung/Unterdeckung (-)	- 1.305.417	- 1.257.316	- 1.538.592
Erfahrungsbedingte Anpassungen der Planschulden	124.078	173.540	41.738
Erfahrungsbedingte Anpassungen des Planvermögens	0	0	0

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der IFRS im Jahr 2004 wurde auf die gemäß IAS 19.120A (p) vorgesehene Angabe für die Berichtsperioden 2002 und 2003 verzichtet.

26 Finanzverbindlichkeiten

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember 2006 wie folgt zusammen:

		31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Sparkasse Frankfurt, Darlehen			
Jahreszinssatz	4,99%		
Effektiver Zinssatz	5,63%		
Zahlung	monatlich		
Zinsen	8.779 Euro		
Fälligkeit	Januar 2011	293.089	0
Nissan Bank, Darlehen			
Jahreszinssatz	0%		
Zahlung	monatlich		
Zinsen	0 Euro		
Fälligkeit	Oktober 2006	0	7.339
BMW Bank GmbH, Darlehen			
Jahreszinssatz	5,12%		
Effektiver Zinssatz	6,49%		
Zahlung	monatlich		
Zinsen	1.370 Euro		
Fälligkeit	Oktober 2007	34.844	46.747
Sparkasse Frankfurt, Darlehen			
Jahreszinssatz	5,65%		
Effektiver Zinssatz	5,80%		
Zahlung	monatlich		
Zinsen	37.171 Euro		
Fälligkeit	Dezember 2008	640.700	688.386
Finanzierungsleasing		30.960.116	35.402.128
Gesamt		31.928.749	36.144.600
Abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		3.643.766	3.280.341
		28.284.983	32.864.259

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2006 standen der Gesellschaft verschiedene kurzfristige Kreditrahmen in Höhe von 48.789.824 Euro zur Verfügung. Per 31. Dezember 2006 hat die Gesellschaft diese Kreditfazilitäten in Höhe von 33.068.990 Euro mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,55% in Anspruch genommen.

Des Weiteren wird unter den kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten der Anteil der langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ausgewiesen.

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	33.280.699	31.847.270
Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeiten	3.432.057	3.213.414
	36.712.756	35.060.684

27 Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten zum Stichtag:

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
Steuerverbindlichkeiten	280.169	1.245.929
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.428.490	5.993.007
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	354.307	1.488.110
	5.062.966	8.727.046

Bei den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer und aus rückständigen Sozialversicherungsbeiträgen.

28 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich den Bezug von Sachmitteln zum Unterhalt der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in voller Höhe innerhalb eines Jahres fällig.

29 Marktwert von Finanzierungsinstrumenten

Der Buchwert von Finanzierungsinstrumenten wie Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Finanzierungsinstrumente im Wesentlichen dem Marktwert.

Der Buchwert von Verbindlichkeiten gegenüber Banken entspricht im Wesentlichen dem Marktwert, basierend auf den für dieselben oder vergleichbare Begebungen angesetzten Marktpreisen, sowie auf den der Gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen.

Die Gesellschaft beobachtet die Wertentwicklung der Verbindlichkeiten mit festen und variablen Zinssätzen sowie der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Überprüfung der Geschäfts- und sonstigen Finanzrisiken.

Zur Absicherung gegen Zinssatzschwankungen aus kurzfristig revolvingierenden Verbindlichkeiten mit variablen Zinssätzen, hat die Gesellschaft eine Zinsswapsvereinbarung über einen Basisbetrag von 20.000.000 Euro abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 5 Jahren und endet in 2008.

Der Zinsswap wurde im Konzernabschluss nicht als Hedging Instrument gemäß IAS 39 behandelt. Die Marktwertveränderungen des Zinsswapschäftes, die in 2005 und 2006 nicht signifikant waren, werden sofort erfolgswirksam erfasst und unter Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Marktwert des Zinsswaps, der auf Basis von offiziellen Preisangeboten ermittelt wurde, beträgt zum 31. Dezember 2006 76 Euro (31. Dezember 2005: – 39.739 Euro).

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

Sonstige Angaben

30 Fördermittel

Die Gesellschaft erhält Fördermittel der öffentlichen Hand, die zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie für den Erwerb von Grundbesitz und Anlagegegenständen verwendet werden. Fördermittel werden bis zum Investitionszeitpunkt als sonstige Verbindlichkeiten erfasst. Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendete Fördermittel wurden als sonstige Erträge erfasst (362.586 Euro in 2006 und 290.744 Euro in 2005). Fördermittel für Investitionen in Höhe von 582.800 Euro in das Sachanlagevermögen wurden im aktuellen Jahr als Minderung der Anschaffungskosten erfasst.

31 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat unkündbare Miet- und Leasingverträge für ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude, ein Mitarbeiterzentrum, ein Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2008 und vereinzelt bis 2011 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat in 2005 einen Vertrag über die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015 abgeschlossen.

Am 16. Dezember 2005 hat ELMOS ebenfalls einen Immobilienvertrag über ein Servicegebäude mit Kantine und Sozialflächen mit der LABRUM Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Eins KG, Düsseldorf, für die Dauer von 9 Jahren abgeschlossen. Die jährliche Miete beträgt 518 Tausend Euro. Die Miete erhöht sich kalenderjährlich um 1,0% p.a., erstmals zum 16. Dezember 2006. Für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann ELMOS die Verlängerung des Mietvertrages um weitere 5 Jahre verlangen.

SMI hat am 26. Januar 2006 einen Immobilien-Leasingvertrag über ein Grundstück und dem darauf stehenden Betriebsgebäude mit McCarthy Manager LLC, Washington/USA abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die monatliche Miete beträgt USD 60.000, wobei eine jährliche Anpassung an den U.S. Consumer Price Index vorgesehen ist. Für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann SMI die Verlängerung des Mietvertrages um weitere 10 Jahre verlangen.

Die Gesamtaufwendungen für die Miet- und Leasingverträge betragen 14.200.331 Euro in 2006 und 12.084.571 Euro in 2005. Zukünftige Mindestzahlungen aus unkündbaren Verträgen mit ursprünglichen Laufzeiten oder Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sind zum 31. Dezember 2006 wie folgt:

	Miet- und Leasingzahlungen ohne Finanzierungsleasing Euro
2007	18.854.001
2008	12.190.083
2009	8.706.955
2010	7.073.045
2011	9.573.910
Folgejahre	20.228.932
	76.626.926

32 Akquisitionen

ELMOS Industries GmbH, Hanau

Diese Gesellschaft wurde im August 2006 mit einem weiteren Gesellschafter errichtet. Am Stammkapital von 100.000,00 Euro hält ELMOS einen Anteil von 49.000,00 Euro bzw. 49,0%. Die Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert.

33 Konzernunternehmen

Gemäß IAS 27 sind in den Konzernabschluss das Mutterunternehmen und die unter der rechtlichen und tatsächlichen Kontrolle des Mutterunternehmens stehenden Tochterunternehmen einzubeziehen.

In den vorliegenden Konzernabschluss sind somit folgende Unternehmen einbezogen worden:

	Kapitalanteil (mittel- und unmittelbar) in Prozent
Mutterunternehmen	
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund	
Tochterunternehmen	
ELMOS Advanced Packaging B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS California Inc., Milpitas/USA	100,0
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	100,0
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	100,0
ELMOS France S.A.S., Nanterre/Frankreich	100,0
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills/USA	100,0
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, München	100,0
ELMOS Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	73,9
Mechaless GmbH, Karlsruhe	51,0
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria/Südafrika	67,6
Silicon Microstructures Inc., Milpitas/USA	100,0

In den Konzernabschluss nicht einbezogene Unternehmen

	Kapitalanteil in Prozent
Tochterunternehmen	
IndustrieAlpineBausträger GmbH, München	51,0
ELMOS USA Inc., Farmington Hills/USA	100,0
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	100,0

Die vorstehend aufgeführten Unternehmen wurden aus Wesentlichkeitsgründen nicht mit in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Ihr Einfluss – auch kumulativ – ist für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur von untergeordneter Bedeutung. Die wesentlichen Vermögens- und Schuldspositionen der IndustrieAlpine Bausträger GmbH werden von der ELMOS Semiconductor AG bereits im Konzernabschluss bilanziert.

Tochterunternehmen	Kapitalanteil in Prozent
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	94,0
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	100,0

Die beiden vorstehend aufgeführten Tochterunternehmen wurden nicht mit in den Konsolidierungskreis aufgenommen, weil der ELMOS nicht die Mehrheit der Stimmrechte gehören.

Es handelt sich bei beiden Unternehmen um Einheiten, die lediglich für Zwecke der Abwicklung zweier Sale-and-Lease-back Konstruktionen gegründet worden sind und die Vermietung der von der ELMOS veräußerten Verwaltungsgebäude und dazugehörigen Grundstücke (inkl. Parkhaus) an die ELMOS übernehmen.

Aufgrund der Qualifizierung als Finanzierungsleasing, werden die zivilrechtlich übertragenen Vermögenswerte weiterhin in der Konzernbilanz der ELMOS ausgewiesen. Gleichzeitig wird der Barwert der zu zahlenden Leasingraten als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Materiell ergibt sich somit bei der Bilanzierung der Gebäude und Grundstücke kein Unterschied zur Bilanzierung im Rahmen einer möglichen Einbeziehung der Epigone und Exedra in den Konsolidierungskreis.

In den Konzernabschluss nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen

Die attoSENSOR GmbH, Penzberg, (45% Beteiligungsquote zum 31.12.2006) wird nach der Equity-Methode bilanziert.

In 2006 hat die Gesellschaft Verluste aus der Beteiligung, die gemäß IAS 28 at-equity bewertet wird, in Höhe von 0,00 Euro (2005: 67.636 Euro) verbucht. Der Beteiligungsansatz entspricht einem Erinnerungswert von 1,00 Euro.

Die Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt, (33,33% Beteiligungsquote) wird wegen untergeordneter Bedeutung nicht nach der Equity-Methode bilanziert.

Die ELMOS Industries GmbH, Hanau (49% Beteiligungsquote zum 31.12.2006) wird nach der Equity-Methode bilanziert. ELMOS Industries erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 einen Jahresfehlbetrag von 161.912,02 Euro. Daher wurde der Beteiligungsansatz auf einen Erinnerungswert von 1,00 Euro abgewertet. Somit verbleibt ein anteiliger, bislang nicht erfasster Verlust von 30.336,89 Euro.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen Prozent	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in TEUR/LW	
Inland					
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	Euro	33,33	191	148	1
attoSENSOR GmbH, Penzberg	Euro	45,00	54	4	
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	Euro	100,00	173	510	2
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	Euro	100,00	92	186	2
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, Unterschleißheim	Euro	100,00	174	8	2
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	Euro	100,00	29	- 3	1
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	Euro	94,00	2	18	1
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	Euro	73,90	718	204	
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	Euro	100,00	113	4	
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	Euro	51,00	—	—	3
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	Euro	51,00	730	- 136	
ELMOS Industries GmbH, Hanau	Euro	49,00	- 62	- 162	
Ausland					
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	52.145	2.772	
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	958	72	2
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	- 1.691	- 650	2
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	11.980	- 2.891	2
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	31.547	0	2
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	9	- 89	2
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)	Euro	100,00	2.537	1.165	
Elmos USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	—	—	3
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	- 272	- 506	2
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	- 3.917	183	2
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	4.503	122	2

1 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2006.

2 Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

3 Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

34 Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat

Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrates für 2006

	Fixe Bezüge Tausend Euro	Variable Bezüge Tausend Euro	Aktienoptionen Stück
Vorstand	1.522	565	0
Aufsichtsrat	126	0	0

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2006 132 Tausend Euro (2005: 112 Tausend Euro). Für sie wurde eine Pensionsrückstellung in Höhe von 1.494 Tausend Euro gebildet. Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 281 Tausend Euro (2005: 475 Tausend Euro).

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit der erforderlichen $\frac{3}{4}$ -Mehrheit beschlossen, die Angaben gem. §285 I Nr. 9a Satz 5-9 HGB für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

35 Aktien und Aktienoptionen des Vorstands und Aufsichtsrats

Am 31. Dezember 2006 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien und Aktienoptionen von ELMOS:

	Aktien	Optionen
Vorstand		
Dr. Klaus Weyer	10.000	25.000
Dr. Anton Mindl	7.250	0
Reinhard Senf	1.948	40.000
Dr. Frank Rottmann	0	9.200
Nicolaus Graf von Luckner	1.000	0

	Aktien	Optionen
Aufsichtsrat		
Prof. Dr. Günter Zimmer	0	0
Dr. Burkhard Dreher	1.900	0
Jörns Haberstroh	3.956	0
Herbert Sporea	4.165	0
Dr. Peter Thoma	9.200	40.000
Jutta Weber	200	0

36 Angaben zu Honoraren für Konzernabschlussprüfer

Die Gesellschaften des ELMOS-Konzerns haben im Geschäftsjahr 2006 folgende Dienstleistungen von der als Konzernabschlussprüfer bestellten Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Anspruch genommen:

	2006 Tausend Euro
Abschlussprüfung	113
Sonstige Bestätigungs- und Bewertungsleistungen	32
Steuerberatungsleistungen	186
Sonstige Leistungen	1
	332

37 Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn der ELMOS Semiconductor AG von 44.937.751,06 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

38 Angaben nach §160 AktG

Aufgeführt sind meldepflichtige Wertpapiergeschäfte im Jahr 2006 bezogen auf Aktien der ELMOS Semiconductor AG (ISIN DE0005677108). Emittent ist die ELMOS Semiconductor AG, Heinrich-Hertz-Str. 1, 44227 Dortmund.

Datum Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stück- zahl	Kurs/ Basispreis (Euro)	Gesamt- volumen (Euro)
30.3.2006 Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	9,55	9.550
23.5.2006 Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,97	7.970
24.5.2006 Xetra	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,95	7.950
6.6.2006 Frankfurt/Main	Felix Christian Mindl	Minderjähriger Sohn von Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	100	7,84	784

39 Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Nach IAS 24 „Related Party Disclosures“ müssen Personen bzw. Unternehmen, die den ELMOS-Konzern beherrschen oder von ihr beherrscht werden, angegeben werden, soweit sie nicht bereits als konsolidiertes Unternehmen in den Konzernabschluss des ELMOS-Konzerns einbezogen werden. Beherrschung liegt hierbei vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte an der ELMOS Semiconductor AG hält oder kraft Satzungsbestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik des Managements des ELMOS-Konzerns zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit assoziierten Unternehmen sowie Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des ELMOS-Konzerns ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des ELMOS-Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz am ELMOS-Konzern von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der ELMOS-Konzern ist im Geschäftsjahr 2006 von den Angabepflichten des IAS 24 ausschließlich in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu assoziierten Unternehmen, zu den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor AG sowie zu den übrigen Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen betroffen.

Der ELMOS-Konzern unterhält im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen. Diese Liefer- und Leistungsbeziehungen werden zu Marktpreisen abgewickelt. In 2006 hat der ELMOS-Konzern für nicht konsolidierte assoziierte Unternehmen (AAC) Lieferungen in Höhe von 739 Tausend Euro (2005: 283 Tausend Euro) erbracht. Von attoSensor hat der ELMOS-Konzern in 2006 Leistungen in Höhe von 200 Tausend Euro

(2005: 200 Tausend Euro) und von DMOS hat der ELMOS-Konzern in 2006 Leistungen in Höhe von 2.745 Tausend Euro (2005: 2.644 Tausend Euro) erhalten. Neben den unter Textziffer 34 Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat genannten Bezügen des Vorstandes und Aufsichtsrates existieren keine wesentlichen Beziehungen zu nahe stehenden Personen.

Darüber hinaus haben Unternehmen des ELMOS-Konzerns mit Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor AG sowie mit anderen Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen bzw. mit Gesellschaften, in deren Geschäftsführungs- oder Aufsichtsgremien diese Personen vertreten sind, keinerlei wesentlichen berichtspflichtigen Geschäfte vorgenommen. Dies gilt auch für nahe Familienangehörige dieses Personenkreises.

42 Entsprechenserklärung nach §161 AktG

Die ELMOS Semiconductor AG hat für 2006 die nach §161 AktG vorgeschriebene Erklärung im Dezember 2006 abgegeben und den Aktionären auf ihrer Internet-Seite zugänglich gemacht. Zudem ist sie im vorliegenden Geschäftsbericht im Kapitel „Corporate Governance“ abgedruckt. Sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden.

Dortmund, im März 2007

Dr. Anton Mindl
Reinhard Senf

Nicolaus Graf von Luckner
Dr. Frank Rottmann

40 Mitarbeiterzahlen

Im Geschäftsjahr 2006 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Konzern 1.102 (2005: 1.028).

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter verteilt sich wie folgt:

	2006 Anzahl	2005 Anzahl
Gruppe		
Angestellte	626	652
Gewerbliche Arbeitnehmer	476	376
Gesamt	1.102	1.028

41 Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Herbert Sporea hat mit Wirkung zum Ende Dezember 2006 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Dr. Klaus Weyer, Vorstandsmitglied bis Dezember 2006, wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Der Hauptversammlung im Mai 2007 soll vorgeschlagen werden, Dr. Klaus Weyer als Aufsichtsratsmitglied für die restliche Amtszeit von Herbert Sporea, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2010 zu wählen. Es sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Bestätigungsvermerk

Zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den von der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

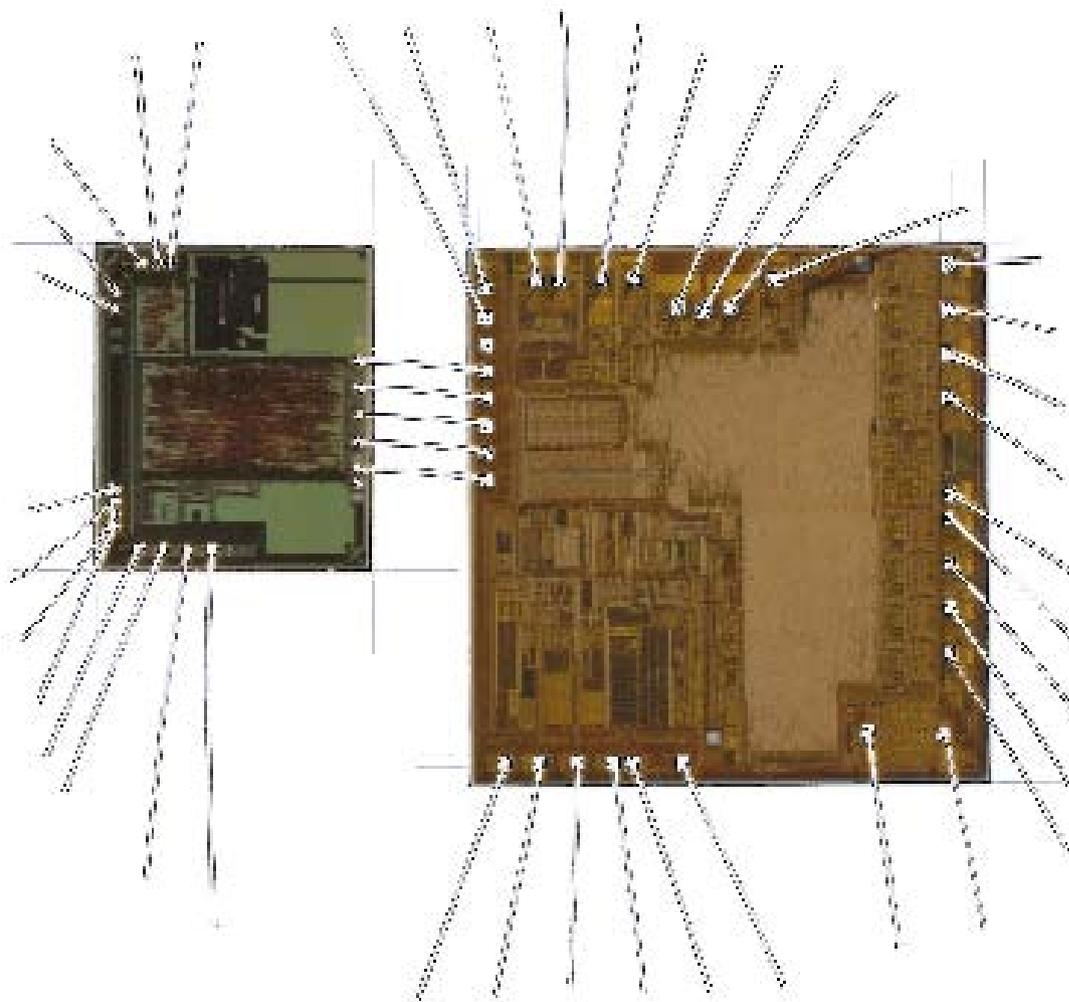
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 9. März 2007

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Muzzu
Wirtschaftsprüfer

Sultana
Wirtschaftsprüfer



WEITER WACHSEN

durch

Kooperationen

Was bedeuten für uns Kooperationen?

Eine Kooperation ist die enge Zusammenarbeit bei einem genau definierten Thema.

Dies umfasst Teamwork in Forschung und Entwicklung, beim Verpacken und Testen von Halbleiterbausteinen sowie bei speziellen Produkten, die das Wissen von verschiedenen Unternehmen vereinen.

Warum wachsen wir durch Kooperationen weiter?

Gezielte Zusammenarbeit macht flexibel, spart Kosten und erzeugt kreative Produkte. Wir verbinden z.B. zwei Halbleiter, einen Mikroprozessor vom amerikanischen Halbleiterhersteller Freescale Semiconductor mit einem hochvoltfähigen Baustein von uns.

Für unsere Kunden bedeutet dies, **ein komplettes Produkt mit Know-how von zwei Unternehmen.**

Bericht des Aufsichtsrats



Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2006 die Aufgaben, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, wahrgenommen. Wir haben uns im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit der Lage des Unternehmens befasst, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand hat uns in schriftlichen und mündlichen Berichten regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung, über alle wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung, über bedeutende Geschäftsvorfälle sowie die aktuelle Ertragsituation einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements unterrichtet.

In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung waren wir eingebunden; die strategische Ausrichtung hat der Vorstand mit uns abgestimmt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von

den Plänen und Zielen wurden uns im Einzelnen erläutert. Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir anhand der Berichte des Vorstands im Aufsichtsrat ausführlich erörtert. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats vom Vorstand und im Speziellen vom Vorsitzenden des Vorstands über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand mit ihm regelmäßig in Kontakt und hat mit ihm Strategie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten.

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf Sitzungen am 19. Mai 2006, am 26. Juli 2006, am 25. Oktober 2006, am 15. Dezember 2006 und am 13. März 2007 sowie aufgrund schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands eingehend über die Entwicklung des am 31. Dezember 2006 abgelaufenen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und aktuelle geschäftspolitische Entscheidungen unterrichten lassen, diese mit dem Vorstand beraten und den Vorstand überwacht. Auf Basis ausführlicher Informationen fasste der Aufsichtsrat in den Sitzungen die erforderlichen Beschlüsse. Im Rahmen der Sitzungen haben wir uns auch mit der Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats befasst und diese bewertet. Bei allen ordentlichen Sitzungen, bis auf die Sitzung vom 19. Mai 2006, war der Aufsichtsrat vollständig anwesend.

Bei den Sitzungen des Aufsichtsrats standen regelmäßig die Absatz-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung des ELMOS-Konzerns im Vordergrund. Schwerpunkte in den ersten Gesprächen des Aufsichtsrats war zudem die Suche und Berufung eines neuen Finanzvorstands. In den weiteren Sitzungen wurde detailliert über die Lage in verschiedenen Konzerngesellschaften und die Vertriebsaktivitäten beraten. Ein wesentlicher Punkt war die Beobachtung von Anlauf und Status der Kooperation mit dem IMS Duisburg hinsichtlich Waferfertigung und Technologieentwicklung. Außerdem standen im Fokus der Sitzungen in der zweiten Jahreshälfte die diversen Kooperationsprojekte mit internationalen Partnerfirmen. Darüber hinaus wurden das ELMOS-Risikomanagementsystem und die Entsprechung zu den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex durch die Gesellschaft im Aufsichtsrat behandelt. Schließlich wurde die Jahresplanung inklusive Investitionsplanung für 2007 und die langfristige Geschäftsentwicklung der ELMOS-Gruppe ausführlich mit dem Vorstand behandelt.

Aufsichtsratsausschüsse

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich in der Sitzung am 2. März 2007 intensiv mit dem vorläufigen Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG und des Konzerns beschäftigt. An dieser Beratung hat auch der Abschlussprüfer teilgenommen. Der Personalausschuss hat sich im Berichtsjahr mehrfach zusammengefunden und insbesondere über die Besetzung des Finanzressorts im Vorstand und das Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Dr. Klaus Weyer beraten. Dabei wurden die in Bezug auf die Anstellungsverträge dieser Vorstandsmitglieder erforderlichen Beschlüsse vorbereitet und gefasst.

Die Ausschussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzungen jeweils ausführlich über ihre Arbeit in den Ausschüssen berichtet.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und sind der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes verpflichtet. Am 15. Dezember 2006 wurde von der Gesellschaft eine aktualisierte Erklärung gemäß §161 AktG bezüglich der Erfüllung der Empfehlungen des Corporate Governance Kodexes in der Fassung vom 12. Juni 2006 abgegeben und den Aktionären auf der Website dauerhaft zugänglich gemacht. Sie ist außerdem Bestandteil des Kapitels „Corporate Governance“ in diesem Geschäftsbericht. Mit dieser Erklärung wurde bekannt gegeben, dass ELMOS nur in vier Punkten von den Empfehlungen abweicht: beim Selbstbehalt der D&O-Versicherung der Organmitglieder, beim individualisierten Ausweis der Vergütung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie der gesonderten Vergütung von Ausschusstätigkeiten.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

In seiner Sitzung am 13. März 2007 hat sich der Aufsichtsrat unter Hinzuziehung der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006 befasst. Der nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 und der Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 und der anschließenden Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt sowie um die nach §315a Abs. 1 HGB vorgesehenen Angaben ergänzt. Auch der Konzernabschluss nach IFRS und der Konzernlagebericht haben den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers erhalten.

Die Jahresabschlussunterlagen, der Geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet worden. Der Vorstand hat die Unterlagen in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 13. März 2007 zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Wirtschaftsprüfer, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, berichteten in dieser Sitzung zudem über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und standen darüber hinaus für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und in der Sitzung am 13. März 2007 den Jahres- und Konzernabschluss gebilligt.

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor zu beschließen, den Bilanzgewinn in Höhe von 44.937.751,06 Euro (nach HGB) vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

Bericht gemäß §312 AktG

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Bericht des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §312 AktG geprüft. Der Aufsichtsrat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Zudem hat der Abschlussprüfer den Bericht des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §312 AktG geprüft und mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats sind keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Ende des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben.

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Während des Geschäftsjahres 2006 gab es einige Veränderungen in der Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2006 wurde vom Aufsichtsrat Herr Nicolaus Graf von Luckner als Finanzvorstand für einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt.

Wie geplant schied Herr Dr. Klaus Weyer zum 31. Dezember 2006 aus dem Vorstand aus. Herr Dr. Weyer ist als Gründer vom ersten Tag an mit der ELMOS verbunden und hat das Unternehmen über mehr als 20 Jahre entscheidend beeinflusst. Wir danken Herrn Dr. Weyer für die Aufbauarbeit im Dienste der Gesellschaft und der Mitarbeiter.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Herbert Sporea legte zum 31. Dezember 2006 sein Mandat nieder. Herr Sporea war seit April 2000 als Mitglied des Aufsichtsrats für die Gesellschaft tätig. Er hat in dieser Zeit die Gesellschaft insbesondere bei der Erschließung neuer Märkte unterstützt. Wir danken Herrn Sporea für seinen Rat und sein Engagement.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund wurde Herr Dr. Klaus Weyer mit Wirkung vom 1. Januar 2007 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die ein neues Aufsichtsratsmitglied wählt, zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt und somit der Aufsichtsrat wieder vervollständigt. Herr Dr. Klaus Weyer wird sich auf der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 der Wahl stellen.

Dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit, den hohen Einsatz und erreichten Erfolg.

Dortmund, im März 2007



Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Organe des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer *Vorsitzender*

Diplom-Physiker | Duisburg

- Mandate:
- ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Siltronic AG
 - ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der active photonics AG
 - ▶ Mitglied im Board of Directors der Dolphin Intégration S.A.

Dr. Burkhard Dreher *Stellvertretender Vorsitzender*

Diplom-Volkswirt | Dortmund

- Mandate:
- ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der EKO Stahl GmbH
 - ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der GfV AG
 - ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Vattenfall Europe Mining AG

Jörns Haberstroh

Diplom-Ökonom | Kerken

- Mandate:
- ▶ Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ehlebracht AG
 - ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der 3M-Quante AG
 - ▶ Mitglied im Beirat der QSC AG
 - ▶ Mitglied im Beirat der MECHALESS Systems GmbH

Herbert Sporea *bis 31.12.2006*

Kaufmann | Altwittenbek

- Mandate:
- ▶ Mitglied im Beirat der MECHALESS Systems GmbH
 - ▶ Mitglied im Beirat der 4 g-systems GmbH

Dr. Klaus Weyer *ab 01.01.2007 (gerichtlich bestellt)*

Diplom-Physiker | Schwerte

- Mandate:
- ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Paragon AG
 - ▶ Mitglied im MST Projektbeirat Dortmund

Dr. rer. nat. Peter Thoma

Diplom-Physiker | Unterschleißheim

- Mandate:
- ▶ Mitglied im Technischen Beirat von Behr GmbH & Co. KG
 - ▶ Mitglied im Beirat von Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG

Jutta Weber

Diplom-Pädagogin | Tarrytown, New York, USA

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Prüfungsausschuss

Vorsitzender: Dr. Burkhard Dreher

Mitglieder: Prof. Dr. Günter Zimmer
Herbert Sporea *bis 31.12.2006*

Personalausschuss

Vorsitzender: Prof. Dr. Günter Zimmer

Mitglied: Dr. Burkhard Dreher

Glossar

ASSEMBLY

Bezeichnet die Weiterverarbeitung der Wafer zu einem verpackten Chip.

ASIC

Ein Application Specific Integrated Circuit (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ist ein individuell für eine spezifische Anwendung entwickelter Schaltkreis. Im Gegensatz zu Standardbauelementen, die nicht kundenspezifisch konfiguriert sind, zum Beispiel Spannungsregler, Speicher, Prozessoren.

ASSP

Ein ASSP (Application specific standard product) ist ein anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis, der individuell für eine spezifische Anwendung entwickelt wurde und nun an mehrere Kunden als Applikations-Standard vermarktet wird.

BACKEND-FERTIGUNG

Die Backend-Fertigung ist der Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der durchgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat. Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, Burn-in, Verpackung (Tape) und der funktionale Test der assemblierten Bausteine.

BIT

Eine Informationseinheit, welche entweder den Wert „0“ oder „1“ annehmen kann.

BURN-IN

Eine Methode zur künstlichen Alterung von elektronischen Schaltungen und Bauelementen, um Frühausfälle zu entdecken. Dabei werden die Chips über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt.

BUS

Ein Kommunikationssystem, welches den Austausch von elektronischen oder optischen Informationen ermöglicht.

BYTE

Das Byte ist ein Maß für Informationseinheiten. Ein Byte entspricht acht Bit.

CAN

Der CAN-BUS (Controller Area Network) ist ein ereignisgesteuertes Kommunikationssystem mit einer Übertragungsrate bis zu 1Mbit/s. Es ist das derzeit am meisten eingesetzte Fahrzeugnetzwerk.

CHIP

Ein elektronischer Schaltkreis, der in Halbleitermaterial realisierte elektrische Funktionen beinhaltet.

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter) ist die Basistechnologie zur Herstellung von Mikrochips mit hohem Integrationsgrad und geringem Energieverbrauch.

DC/DC (GLEICHSTROM ZU GLEICHSTROM)

Eine Baugruppe, ein Gerät oder eine Einrichtung zur Umwandlung elektrischer Ströme und Spannungen von einem Eingangsniveau in ein Ausgangsniveau.

DREHRATEN-SENSOR

Drehraten-Sensoren sind mechanisch oder mikromechanisch aufgebaute Sensoren, die unter Analyse der Corioliskraft Dreh- und Schlingerbewegungen erkennen können, beispielsweise von Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen.

ELEKTRONISCHER SCHALTKREIS

Ein Zusammenschluss verschiedener elektrischer Komponenten, die eine bestimmte Funktion in einem elektrischen System übernehmen.

FLASH

Flash-Speicher lassen sich frei adressierbar beschreiben. Der Flash-Speicher verliert bei Stromabschaltung nicht die Informationen.

FLEXRAY

FlexRay ist der zukünftige Vernetzungsstandard für Applikationen mit hohen Anforderungen. Es unterstützt aktive und passive Sicherheitssysteme sowie synchrone und asynchrone Datenübertragung mit Geschwindigkeiten bis zu 10Mbit/s.

FOUNDRY

Eine Halbleiterfertigung, deren primäres Geschäftsziel die Herstellung und der Verkauf von prozessierten Silizium-Wafern ist.

FRONTEND-FERTIGUNG

Herstellen der elektronischen Schaltungen auf Silizium-Wafern mittels physikalischer und chemischer Bearbeitungsverfahren unter Reinraumbedingungen.

HALBLEITER

Ein Festkörpermateriale (z.B. aus Silizium oder Germanium), das physikalisch modifiziert seine elektrischen Eigenschaften ändern kann. Durch gezieltes Dotieren des Materials, in der Regel mit Bor oder Phosphor, kann man die elektronischen Eigenschaften verändern.

HALIOS®

HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System) kennzeichnet sich aus durch die Erfassung von dreidimensionalen Bewegungen. Optische Fremdeinflüsse, wie z.B. starker Lichteinfall, beeinflussen die Leistung nicht. Die elektronische Kompensierung von Fremdlichteinflüssen ist die technisch ausschlaggebende Funktion.

INTEGRIERTE SCHALTUNG, IC

Eine elektronische Schaltung, die aus verschiedenen, miniaturisierten elektronischen Bauelementen besteht (z.B. Widerstände, Kondensatoren, Transistoren etc.), welche in einem Halbleitermaterial integriert wurden.

JEDEC

Joint Electron Devices Engineering Council ist das Standardisierungsgremium für elektronische Gehäusebauformen.

LAYOUT

Beschreibt mit einfachen geometrischen Formen die zur Herstellung von integrierten Schaltungen benötigten Informationen aus der Schaltungsentwicklung.

LED

Eine Light Emitting Diode (Leuchtdiode) ist eine Halbleiter-Diode, die aufgrund eines elektrischen Stroms Licht aussendet.

LIN

Der LIN-BUS (Local Interconnect Network) ist ein Kommunikationsnetzwerk in Fahrzeugen. Es verbindet insbesondere Komfortapplikationen mit einer Bandbreite bis zu 20kbit/s.

MEMS

Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme sind insbesondere Sensoren, welche auf Halbleitertechnologien basieren. Diese können beispielsweise Druck oder Neigungen erfassen.

MIKROMETER

Ein μm ist der einmillionste Teil eines Meters.

MIKROPROZESSOR/MIKROKONTROLLER

Eine integrierte, komplexe elektronische Einheit, die ein elektronisches System kontrolliert und betreibt. Mikroprozessoren sind die zentralen Gehirne eines elektronischen Systems, wie z.B. dem Computer.

MIXED-SIGNAL

Eine Kombination von analogen und digitalen Signalen, die gleichzeitig auf ein und demselben Chip generiert, kontrolliert oder modifiziert werden.

MOS

Metal-Oxide-Semiconductor (Metall-Oxid-Halbleiter) beschreibt den Aufbau des zentralen Kontrollelements für den Feldeffekt in einer speziellen Klasse von Halbleitertransistoren.

MOST-PROTOKOLL

Das MOST-Protokoll ist ein Vernetzungsstandard für Produkte, die eine hohe Daten-Bandbreite benötigen. Insbesondere verbindet MOST Infotainment- und Telematik-Applikationen.

OEM

Original Equipment Manufacturer ist ein Hersteller, der (Teil-) Systeme an einen Wiederverkäufer vertreibt. In der Automobilindustrie bezeichnet OEM die Fahrzeughersteller.

PPM

parts per million (eins aus einer Million)

REINRAUM

Ein abgeschlossener Gebäudebereich, in dem die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Verunreinigungen durch Staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrolliert werden.

SENSOR

Eine elektrische Baugruppe, die eine reale physikalische Größe, z.B. Bewegung, Hitze oder Licht misst oder erkennt und anschließend in ein analoges oder digitales elektrisches Signal umwandelt.

SILIZIUM, SI

Das am häufigsten benutzte Halbleitermaterial, welches für etwa 95 Prozent aller hergestellten Chips eingesetzt wird.

SOI

Silicon-on-Insulator (Silizium auf Isolator) ist ein spezielles Ausgangsmaterial für die Halbleiterherstellung, welches eine perfekte vertikale Isolierung mittels nichtleitender Zwischenschichten aufweist.

SYSTEM ON CHIP

Fortschritte in der Halbleiterfertigungstechnologie und Entwicklungsmethodik machen es heute möglich, ASICs mit mehreren Millionen Transistoren zu fertigen. Die Idee von System on Chip ist, möglichst viele komplexe Funktionen in einen Chip zu integrieren.

TPMS

Ein Tire Pressure Monitoring System (Reifendruckkontrollsystem) überwacht den Luftdruck im Autoreifen und weist den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

TRANSISTOR

Ein Transistor, auch Transfer Resistor (gesteuerter Übergangswiderstand), ist das Grundbauelement der Halbleiterschaltungstechnik für die Verstärkung beziehungsweise zum Schalten von elektronischen Signalen.

WAFER

Das Ausgangsmaterial in der Chipherstellung. Es handelt sich dabei um eine etwa 0,3 bis 1 mm dicke Scheibe, die aus einem Siliziumeinkristall gesägt und anschließend poliert worden ist. Typische Durchmesser betragen 150 (6-Zoll), 200 (8-Zoll) und 300 (12-Zoll) mm.

INFORMATIONSMATERIAL

Wenn Sie mehr über ELMOS erfahren möchten, senden wir Ihnen gerne folgende Dokumente zu:

- ▶ Geschäftsbericht
- ▶ Quartalsberichte
- ▶ Kodex des verantwortungsvollen Handelns
- ▶ Umweltbericht
- ▶ Unsere Technologie-Broschüre
- ▶ Unser Herstellungsprozess-Broschüre
- ▶ Unsere Kompetenzen-Broschüre
- ▶ Unser Unternehmen (Imagebroschüre/ Unternehmensdarstellung)
- ▶ Newsletter (quartalsweise)

Alle aufgeführten Dokumente befinden sich auch auf unserer Internetseite unter www.elmos.de

Wenn Sie regelmäßig unsere Ad hoc-Meldungen sowie Pressemitteilungen erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an invest@elmos.de

KONTAKT | IMPRESSUM

Herausgeber

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund | Deutschland
www.elmos.de

Ansprechpartner

Investor Relations
Telefon +49 (0) 231-75 49-287
Telefax +49 (0) 231-75 49-548
invest@elmos.de

Design

DianaDesign, Hamburg

Fotografie und Illustration

digi mice GmbH, Neu-Isenburg
Stefan Dintelmann, Groß-Gerau

Druck

Lonnemann GmbH, Selm

Dieser Geschäftsbericht liegt auch in englischer Sprache vor.

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund | Deutschland
Telefon +49(0)231-75 49-0
Fax +49(0)231-75 49-149
info@elmos.de | www.elmos.de